



Das erste Jahr

Inhaltsverzeichnis

Das erste Jahr

Marktüberblick
Bedeutende Entwicklungen

2

Brief an die Aktionäre

8

Infineon macht das Internet...

Drahtgebundene Kommunikation
Mobile Kommunikation
Sicherheits- und Chipkarten-ICs
Speicherprodukte
Automobil- und Industrieelektronik

11

One-on-one

Die Vorstände von Infineon
stehen Rede und Antwort

14

Die Infineon-Aktie

Entwicklung der Aktie
Geschäftswertbeitrag
Dividende

18

Unsere Mission

Das Management

20

High-Tech vom Feinsten

System-on-a-Chip,
300-Millimeter-Technologie,
Bluetooth™, UMTS,
Breitband, Sicherheit

22

Bericht des Aufsichtsrates

30

Lagebericht

Bitte Hinweis auf Seite 32 beachten

32

Finanzbericht

Konzern-Finanzdaten
Konzernabschluss
Konzerngesellschaften

60

Glossar

90

Aktionärsinformation

92

Aussagen in diesem Geschäftsbericht bezüglich der Pläne, Strategien und Annahmen von Infineon Technologies sowie weitere in die Zukunft gerichtete Aussagen können Risiken und Unsicherheiten bergen. Bedeutende Faktoren, die dazu führen können, dass die künftige Geschäftslage des Konzerns wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweicht, sind unter anderem die generellen wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten Asien-Pazifik inklusive Japan, Europa und USA sowie Wechselkurs-Schwankungen. Weiterhin gehören zu diesen Faktoren die generelle Nachfrage nach und der starke Wettbewerbsdruck bei Halbleiterprodukten und Dienstleistungen von Infineon sowie die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Marktumfeld auch weiterhin neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich einzuführen.

Einen detaillierteren Hinweis auf diese Risikofaktoren finden Sie in der rechten Spalte auf Seite 59 des Berichts.



* Originalgröße

Das ist unser **erster** Geschäftsbericht. Das **erste** volle Geschäftsjahr von Infineon Technologies ist abgeschlossen. Und es war ein ganz besonderes Jahr. Wir haben nicht nur einen der weltweit größten Börsengänge eines Hochtechnologie-Unternehmens gemeistert, sondern auch bei Umsatz und Ergebnis alle unsere Rekorde gebrochen: So stieg der Umsatz vergleichsweise um 72 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Das Ebit, also unser Ergebnis vor Zinsen, Ergebnisanteilen Dritter und Steuern, verbesserte sich sogar noch deutlicher von minus 13 Mio. Euro auf plus 1,67 Mrd. Euro. Infolgedessen stieg der Gewinn je Aktie von 0,10 auf 1,83 Euro. Auch das Umsatzwachstum von Infineon hat das des gesamten Halbleitermarktes bei weitem übertroffen. Und das, obwohl sich das globale Marktvolumen im Kalenderjahr 2000 in US-Dollar gerechnet etwa um 37 Prozent ausweitete. Allein diese Zahl beweist, dass das Halbleitergeschäft weiterhin unstrittig die am schnellsten expandierende Hochtechnologie-Industrie bildet.

Doch Infineon hat sich nicht zum **ersten** Mal schneller als der Markt entwickelt, sondern zurückgerechnet bereits zum fünften Mal in Folge. Genau diese Leistung hat uns zu einem der wachstumsstärksten Chiphersteller befördert - und unter die Top 10 der Welt. Wie wir das gemacht haben? Wir waren mit einer ganzen Reihe von bahnbrechenden und verkaufsstarken Innovationen die **ersten** am Markt. Hinter diesen technologischen Spitzenentwicklungen stecken natürlich nicht nur langfristige Strategien, sondern vor allem der Einsatz und die Innovationsstärke unserer Mitarbeiter. Mehr darüber und über einige unserer Zukunftspläne lesen Sie in diesem **ersten** Geschäftsbericht von Infineon Technologies.



Im Namen des Aufsichtsrates

Dr. Eng. h.c. Volker Jung
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Im Namen der Führungskräfte und Mitarbeiter

Dr. Ulrich Schumacher
Vorsitzender des Vorstandes

Welche Rolle spielen Chips im Kommunikations-Boom?

Im Kalenderjahr 2000 wird der Umsatz der Halbleiterindustrie gegenüber dem Vorjahr um etwa 37 Prozent steigen. Nicht ganz unabhängig davon wird erwartet, dass sich die Anzahl der Mobilfunknutzer, Festnetzverbindungen und Internet-Computer bis Ende des Jahres auf 678 Millionen, 956 Millionen und 230 Millionen erhöht.

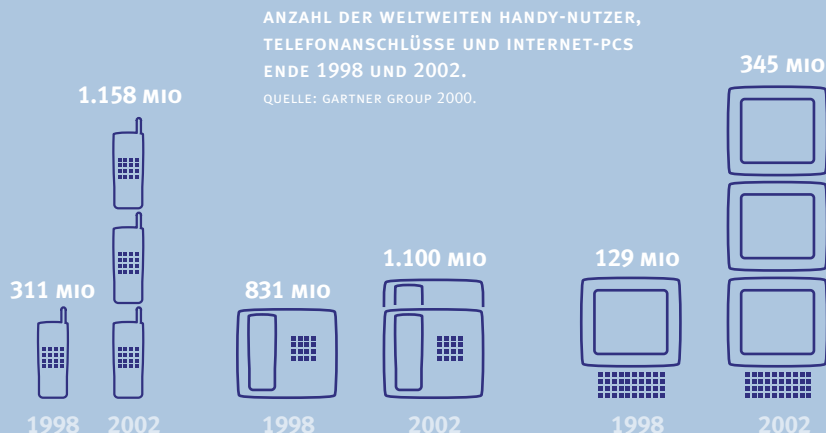
Mit jährlich rund 120 Prozent vergrößert sich das Sprach- und Datenaufkommen, das mittels Netzwerke zwischen diesen Endgeräten übertragen wird. Technologieunterschiede und räumliche Distanzen sind dabei heute kein Hindernis mehr – größtenteils auch dank der Ergebnisse der Halbleiterforschung. Die Elektronikchips ermöglichen das Verbinden von Computern, Telefonen und fast allen anderen elektronischen Geräten - und das weltweit.

Dass das Geschäft mit Kommunikationsgeräten so boomt, hat einen einfachen Grund: Jede neue Technologiegeneration kann so viel mehr und kostet oft viel weniger als ihre Vorgänger. Hinzu kommt, dass in den Weiterentwicklungen immer mehr Halbleiterfunktionen zum Einsatz kommen. So stecken im Innern der neuesten Mobiltelefone zwischen 50 und 200 Halbleiter-Komponenten.

Infolge des seit zehn Jahren anhaltenden Booms erwirtschaftet die Halbleiterbranche bereits heute mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit den Herstellern von Kommunikationsgeräten und den Systembetreibern. Und das ist erst der Anfang: Zunehmend werden mobile Endgeräte den herkömmlichen PC als Internet-Terminal ersetzen.

Gemäß aller Vorhersagen wird die Halbleiterindustrie auch in absehbarer Zukunft enorme Chancen zur Weiterentwicklung erhalten. So soll der Gesamtumsatz mit Kommunikationschips allein im Jahr 2001 um 17 Prozent auf 60,7 Milliarden US-Dollar wachsen.

‘Never stop thinking’ – immer weiterdenken lautet das Unternehmensmotto von Infineon. Vor allem denken wir an die Bedürfnisse der Märkte von morgen. Die Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und das vorhandene Know-how führen immer wieder zu neuen innovativen Produkten. Mit diesem Geschäftsprinzip wird Infineon auch künftig eine treibende Kraft sein in den wachstumsstärksten Segmenten des Halbleitermarktes.

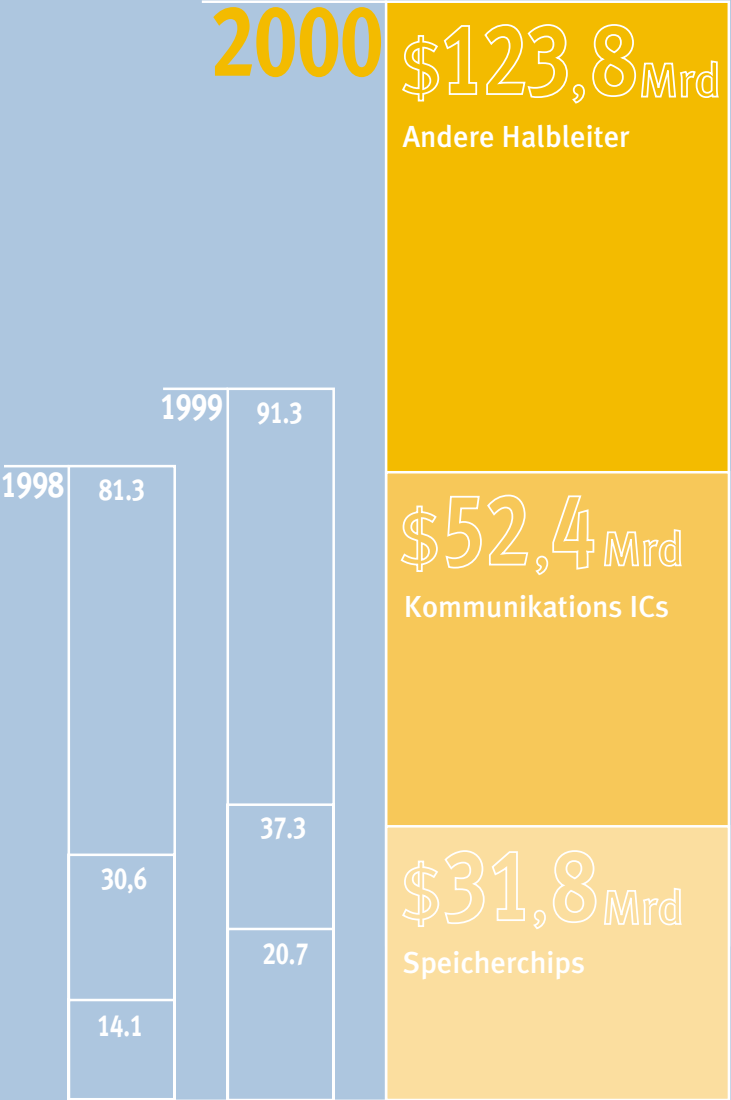


Entwicklung des Halbleitermarktes 1998–2000

DAS ERSTE JAHR

Marktvolumen in Milliarden US-Dollar

QUELLEN: DATAQUEST, AUGUST 2000, UND WSTS, OKTOBER 2000



Zunächst der Überblick

WIR ERREICHEN UNSERE ZIELE...

In den vergangenen zwei Jahren hat der aus Siemens ausgegründete Infineon-Konzern seinen Umsatz mehr als verdoppelt – von 3,2 auf 7,3 Milliarden Euro. Nach einem deutlichen Verlust im Jahr 1998 und einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis 1999 verzeichneten wir im Geschäftsjahr 2000 eine Steigerung des Ebit-Ergebnisses auf fast 1,7 Milliarden Euro. Damit lag die Ebit-Marge bei 23 Prozent. Diese Leistungen erzielten wir in hart umkämpften Marktsegmenten, trotz eines hohen Aufwands für die Restrukturierung des Konzerns, enormer Investitionen zum Ausbau der Produktionskapazitäten und der Einführung neuer Herstellungsprozesse.

...DENN WIR WISSEN, WAS WIR ZU TUN HABEN:

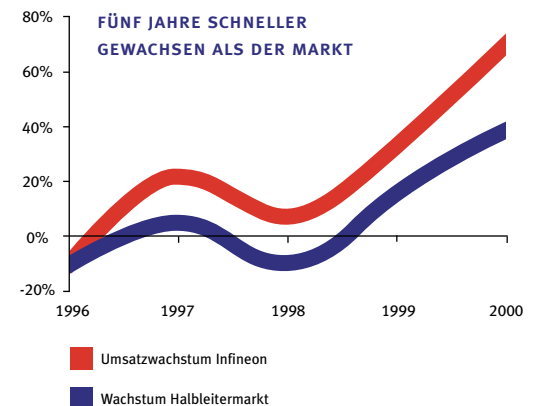
- Wir expandieren in allen Schlüsselbereichen der Halbleiterbranche.

Beim Umsatz mit Halbleiterchips für Kommunikationsanwendungen legten wir im Geschäftsjahr 2000 um 36 Prozent zu. Die Kommunikationsbereiche haben damit bereits mehr als ein Drittel zum Gesamtumsatz beigesteuert. Dabei steht der Boom der neuen Märkte erst noch bevor: Bluetooth-Anwendungen und Mobiltelefone der dritten Generation sowie andere Multimedia-Kommunikationsgeräte und schnellste Breitbandverbindungen. Diese bahnbrechenden Technologien halten die Branche auch in den nächsten Jahren auf starkem Wachstumskurs. Die Chips dafür hat Infineon bereits entwickelt.

Noch stärker sind wir im Geschäftsbereich Speicherprodukte gewachsen. Hier konnten wir allein den Umsatz um 147 Prozent erhöhen. Neben hohen Durchschnittspreisen erreichten wir diese Steigerungsrate mit der Einführung einer Vielzahl innovativer Produkte.

- Wir profitieren von den wachstumsstärksten Märkten und Firmen der Welt.

Unser Umsatz in der Region Asien-Pazifik (einschließlich Japan) stieg von 1998 bis 2000 von 649 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro – ein Plus von 224 Prozent. In den USA legten wir im gleichen Zeitraum von 626 Millionen Euro um 190 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig festigten wir unsere starke Position in Deutschland und im restlichen Europa. Hier verzeichneten wir innerhalb von zwei Jahren ein Umsatzwachstum von 50 bzw. 110 Prozent. Und natürlich wollen wir auch in diesen, unseren Heimatmärkten, weiter wachsen.

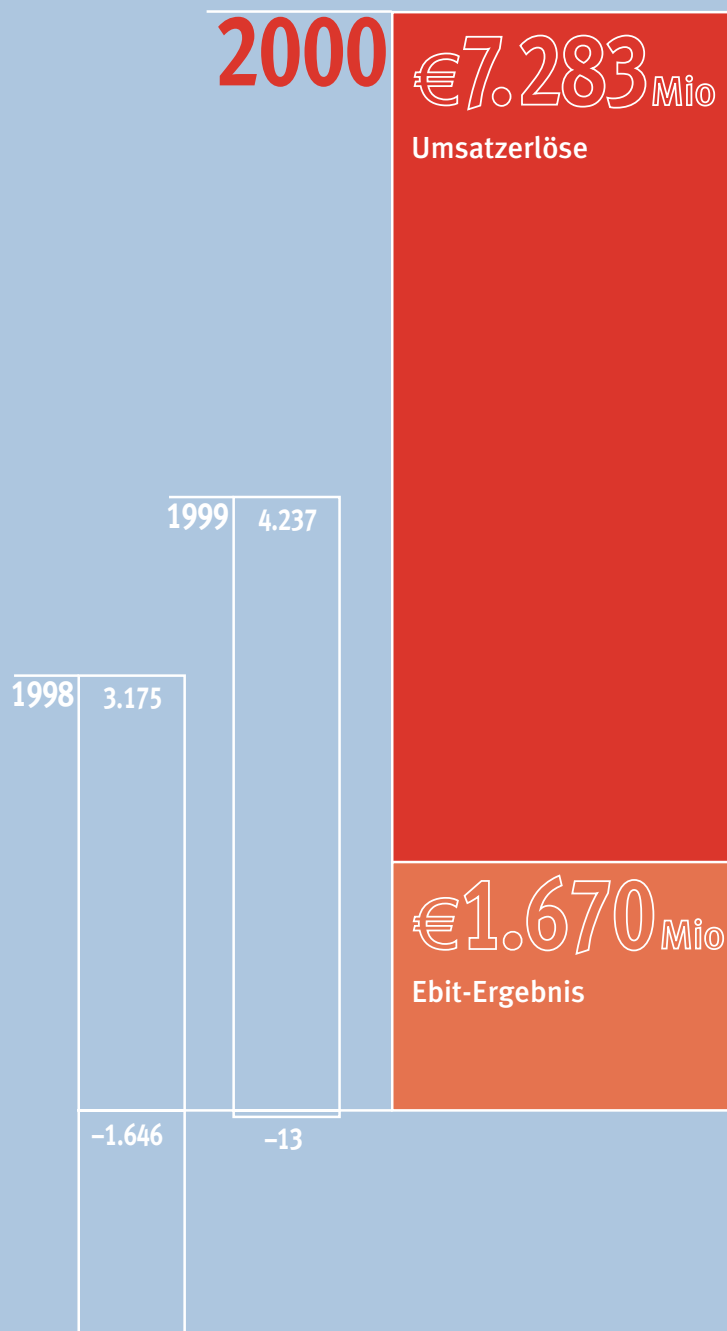


Entwicklung von Infineon 1998–2000

DAS ERSTE JAHR

Geschäftsjahr vom 1. Oktober des Vorjahres bis 30. September in Millionen Euro

EBIT = GEWINN (VERLUST) VOR ZINSEN, ERGEBNISANTEILEN DRITTER UND STEUERN



00000111=7

NEVER STOP THINKING



Es war ein ganz besonderes erstes Jahr

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRIN, SEHR GEEHRTER AKTIONÄR,
das Geschäftsjahr 2000 ist für Infineon in jeder Hinsicht ein Rekordjahr. Nach der Ausgründung aus der Siemens AG gelang uns im März 2000 ein sehr erfolgreicher Gang an die Börse – und die bis dahin größte Börseneinführung eines High-Tech-Unternehmens weltweit. Unsere Geschäftsergebnisse übertrafen die der Vorjahre erheblich. So stieg der Umsatz im Vergleich zu 1999 um 72 Prozent auf 7,28 Milliarden Euro. Dieses Wachstum war getrieben durch die starke Nachfrage in allen Geschäftsbereichen, insbesondere bei Kommunikations- und Speicherprodukten, und wurde von einer deutlichen Ausweitung unserer Produktionskapazitäten begleitet.

Das Ebit-Ergebnis – also der Gewinn vor Zinsen, Ergebnisanteilen Dritter und Steuern – verbesserte sich ebenfalls auf die Rekordhöhe von 1,67 Milliarden Euro. Grundlage für diesen Erfolg waren beträchtliche Produktivitätssteigerungen und höhere Margen in allen Bereichen.

Der Konzernüberschuss stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als 1 Milliarde Euro auf 1,13 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,83 Euro nach 0,10 Euro im Vorjahr.

Der herausragende Erfolg von Infineon ist für uns eine Bestätigung für unsere Strategie, die Unternehmenswerte weiter zu steigern und auch in Zukunft das Vertrauen unserer mehr als 700000 Aktionärinnen und Aktionäre weiter auszubauen.

Zum Zeitpunkt unseres Börsengangs erreichten wir eine Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden Euro, die zum Ende des Geschäftsjahres auf über 34 Milliarden Euro anstieg.

Durch unsere Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern können wir heute schneller und flexibler auf den Markt reagieren und damit Chancen im immer härteren Wettbewerb besser und offensiver nutzen. Darüber hinaus erlaubt uns die

Unabhängigkeit von Siemens eine stärkere Marktdurchdringung bei unseren Schlüsselkunden und damit eine weitere Wertschöpfung im Interesse unserer Kunden und Aktionäre.

Zum fünften Mal in Folge wuchsen wir schneller als der Halbleitermarkt und übertrafen mit unseren Ergebnissen selbst die Ziele, die wir uns zum Zeitpunkt unseres Börsengangs gesteckt hatten. Die Bruttomarge verbesserte sich von 29 Prozent im Vorjahr auf 44 Prozent im Geschäftsjahr 2000, die Ebit-Marge stieg auf 23 Prozent. Zudem konnten wir unsere Globalisierungsstrategie weiter erfolgreich umsetzen und unsere Wettbewerbsposition in einigen wichtigen Regionen deutlich verbessern.

Seit dem Börsengang haben wir weiter stark in den Ausbau unseres Portfolios an geistigen Eigentumsrechten - dem Intellectual Property - investiert. Sieben neue Forschungs- und Entwicklungszentren wurden eingerichtet. Insgesamt verfügt Infineon nun über 27 große F+E-Standorte weltweit. Mehr als 5000 hochqualifizierte Entwickler, Ingenieure und Spezialisten bilden den innovativen, kreativen und dynamischen Kern unseres Unternehmens. Sie spielen eine bedeutende Rolle beim Ausbau unserer strategischen Stärken sowie unseres herausragenden technologischen Portfolios und sind damit der wesentliche Antrieb für unseren Erfolg.

DAS ZIEL: EIN WELTMARKTFÜHRER IN DER KOMMUNIKATION

Durch den Gewinn zusätzlicher Marktanteile in schnell wachsenden Segmenten mit hohen Margen wollen wir den 'Shareholder Value' weiter steigern. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Ausbau unserer Führungsrolle bei Kommunikationschips. Hier wollen wir unsere Marktdurchdringung vor allem bei drahtgebundenen und bei mobilen Kommunikationslösungen sowie im Bereich der Internet-Infrastrukturmärkte erhöhen.



Entsprechend dieser Strategie haben wir erfolgreich unseren Geschäftsbereich drahtgebundene Kommunikation restrukturiert, um die Halbleitermärkte für Glasfaseroptik, Hochgeschwindigkeits-Kommunikation, Internet-Zugangssysteme, Weitverkehrsnetze (WAN) und lokale Netzwerke (LAN) besser bedienen zu können. Durch die Übernahme der Firma Savan Communications und den - noch nicht abgeschlossenen - Kauf von Ardent Technologies konnten wir unsere Spitzenstellung in den schnell wachsenden Bereichen der Breitbandnetze und optischen Netze ausbauen.

Zudem haben wir unsere Produktpalette durch den Verkauf unseres 'Image & Video'-Geschäfts optimiert. Weitere geplante Schritte sind die Veräußerung unserer Aktivitäten bei Infrarot-Komponenten sowie der Verkauf unserer Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Osram Opto Semiconductor.

Mit dieser Konzentration auf unsere Kernkompetenzen werden wir unsere starke Position in den Wachstumsmärkten der Breitbandkommunikation ausbauen, einschließlich der besonders dynamischen Bereiche wie der Technologie zur Überbrückung der 'letzten Meile' bis zum Büro- oder Hausanschluss sowie bei superschnellen optischen Netzwerken für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

Neben unseren Stärken bei der drahtgebundenen Kommunikation verfügen wir über eine hervorragende Marktposition in der mobilen Kommunikation. Wir sind weltweit die Nummer eins bei Hochfrequenz-Chips und die Nummer zwei bei Basisband-Chips für Mobiltelefone. Zudem sind wir führend im immer noch stark wachsenden Bereich des GSM/GPRS-Mobilfunks. Ein Technologieführer ist Infineon auch beim zukünftigen Übertragungsstandard Bluetooth, der faszinierende Möglichkeiten für die drahtlose Datenübertragung im Nahbereich eröffnen wird, sowie bei UMTS, der fortschrittlichen Technologie für den Mobilfunk der

dritten Generation. In diesen dynamischen Marktsegmenten wollen wir besonders schnell wachsen.

Wir wollen aber auch unsere Weltmarktführerschaft bei Sicherheitsanwendungen und Sicherheitssystemen in den schnell expandierenden Märkten M-Commerce - dem mobilen elektronischen Handel im Internet, mobile Kommunikation und Zugangskontrolle weiter ausbauen. Die explosionsartige Entwicklung von Online-Geschäftsprozessen und Online-Dienstleistungen im Internet-Zeitalter generiert eine enorme Nachfrage nach innovativen Sicherheits- und Authentifizierungstechnologien wie zum Beispiel unseren elektronischen FingerTIP-Sensor. Wir glauben, dass die Internet- und Onlinesicherheit einer der größten Wachstumsmärkte der Zukunft ist, und wir wollen auch hier die Marktanteile ausbauen.

VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT UND KOSTENFÜHRERSCHAFT BEI SPEICHERCHIPS

Unser Geschäftsbereich Speicherbauelemente konnte seinen Umsatz um 147 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro und sein Ebit-Ergebnis auf 1,3 Milliarden Euro erhöhen. Diese Rekordergebnisse erreichten wir durch deutliche Produktivitätssteigerungen dank der konsequenten Umsetzung weiterer Strukturverkleinerungen und dank weiterer Kapazitätsausweitungen. Als erster Halbleiterhersteller hat Infineon die Umstellung seiner Speicherchip-Produktion auf Strukturgrößen von 0,17-Mikrometern abgeschlossen.

Ebenso wichtig ist der Ausbau unserer weltweit führenden Position in der 300-Millimeter-Technologie. An unserem modernsten Standort in Dresden entsteht derzeit die erste 300-Millimeter-Speicherchipfabrik der Welt; die Produktion soll Ende 2001 hochgefahren werden. Durch die auf den größeren Siliziumscheiben vervielfachte produzierte Chipmenge je Scheibe, können wir die Stückkosten erheblich vermindern.

Infineon ist in der einzigartigen Marktposition, eine Vielzahl der Halbleitertechnologien anzubieten, die die Internet-Welt zusammenführen.

Infineon macht das Internet...

SOFORT VERFÜGBAR

SPEICHERKAPAZITÄT FÜR SCHNELLEN DATENABRUF

- von der Welt der PCs hin zur vernetzten Welt
- wachsender Marktanteil bei Servern und High-end Grafik
- eine der ersten Firmen mit neuen DRAM-Chips mit höchsten Kapazitäten (512 Megabit bzw. 1 Gigabit)
- führende Position beim Verkleinern der Strukturbreiten sowie in der 300nm-Technologie

SCHNELLER

VOM INTERNETZUGRIFF BIS ZUM SURFEN IM WEB - DIE MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT WIRD WEITER ERHÖHT

- starke, technologiebasierte Marktposition bei VDSL
- ADSL (Einführung Ende 2000)
- führende Position bei SHDSL (Einführung begonnen)
- 60 % Marktanteil bei Netzzugangsgeräten (IAD)
- verbesserte Position bei LAN-Schaltern
- Investitionen in schnelle 10/40 Gigabit CMOS-Technologien für den 10-Gigabit-Ethernet und SDH/SONET-Markt

MOBIL

ZUGANG ZUM INTERNET ÜBER MOBILE KOMMUNIKATIONSGERÄTE

- weltweit erste Chipsets für Dual-Mode-GSM/UMTS
- Integration auf Systemebene für Basisstationen der dritten Generation (3G)
- Produkte für die wachsende Nachfrage nach Mehrfach-Modus-Geräten inklusive GSM und GPRS
- Vorstellung des ersten zertifizierten und zugleich kleinsten Bluetooth-Chipsets der Welt

SICHER

INTERNETZUGRIFF UND E-TRANSAKTIONEN: SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT

- weltweit führend bei Chips für Chipkarten
- Unterstützung globaler Standards wie Java und Windows
- weltweit führender Spezialist für Verschlüsselung
- gut positioniert, um künftige Sicherheitsstandards zu setzen für Bankgeschäfte, den elektronischen Handel und den Internetzugriff (z.B. biometrische Systeme und Identifizierungssysteme)

IM AUTO ZUGÄNGLICH

- erforderliches Know-how für eine führende Position bei Informations- und Navigationssystemen
- Nutzung des Trends hin zu mehr Chips im Auto
- einzigartige Technologieposition bei Leistungs- und CoolMOS-Transistoren
- hocheffiziente Schalt-Netzteile für Computer und Mobiltelefone



Speicherprodukte

Drahtgebundene Kommunikation

Mobile Kommunikation

Sicherheits- und Chipkarten-ICs

Automobil- und Industrieelektronik

...Wie? Mit...

Speicherprodukte

- 64-, 128- und 256-Megabit DRAMs
- embedded DRAMs und ASICs
- SGRAMs für höchste Grafikanforderungen
- Spezialcontroller für Massenspeicher

Drahtgebundene Kommunikation

- optischen Modulen, Switches und Lasern
- Mappers und Framers
- Bauelementen für den direkten Zugriff auf physikalische Medien
- Schnittstellen-ICs für Telekommunikationsanschlüsse und SLICs
- embedded DSPs und embedded DRAMs

Mobile Kommunikation

- diskreten Hochfrequenz-Bauelementen, -ICs und - Modulen
- Basisband-Systemen wie digitalen Signalprozessoren (DSPs)
- Bluetooth™-Chips
- Hochleistungsverstärkern aus Galliumarsenid (GaAs)

Sicherheits- und Chipkarten-ICs

- Chipkarten-Chips für SIM- sowie Geldkarten
- Sicherheits-ICs für PCs, Notebooks, Server, Mobiltelefone und Digitalfernsehen
- sichere Speicherchips (MultiMediaCard) für tragbare Geräte
- biometrische Identifizierungs-Systeme
- Beratung in Sicherheitsfragen

Automobil- und Industrieelektronik

- 16-/32-Bit-Mikrocontroller
- Smart Power
- Diskrete Power (CoolMOS, OptiMOS, CoolSET)
- IGBT-Module

12=00001100

NEVER STOP THINKING

Als weltweit erstes Halbleiterunternehmen werden wir damit in den kommenden Jahren noch größere Kostensenkungen bei der Produktion von Speicherbauelementen erzielen.

Wir konzentrieren unsere Aktivitäten jetzt verstärkt auf die weniger volatilen, aber schnell wachsenden Bereiche der Server- und Netzwerk-Speicheranwendungen. Dies wird uns unabhängiger von der Dynamik des traditionellen PC-Marktes machen. Gleichzeitig können wir unsere Marktanteile in Speichersegmenten mit höheren Margen weiter steigern.

Im Bereich Automobil- und Industrieelektronik - dabei sind Autoradios nicht einberechnet - behaupteten wir unsere Stellung als Nummer zwei weltweit und Nummer eins in Europa. Diese Position werden wir 2001 ebenfalls festigen können. Der Trend hin zu immer mehr Halbleiterkomponenten in Fahrzeugen – allein im letzten Jahr stieg ihre Anzahl um 20 Prozent – wird sich für uns weiterhin auszahlen. Wir sind führend bei Stromversorgungs-Komponenten für die Automobil- und Industrieelektronik und werden darüber hinaus auch bei Fahrerinformations- und Navigationssystemen von unserem System-Know-how profitieren.

INNOVATIVER TECHNOLOGIETREIBER FÜR DAS INTERNET

In den kommenden Jahren wird das Internet nicht nur immer schneller, mobiler und sicherer werden. Mit den schnell wachsenden Datenmengen wird die Nachfrage insbesondere nach solchen Speicherkapazitäten gewaltig zunehmen, die Daten wieder schnell verfügbar machen. Und da das Internet eine stark zunehmende Rolle in unserem Leben einnimmt, werden dessen Nutzer vermehrt kombinierte Lösungen verlangen, die bisher alleinstehende Technologien zusammenführen; dazu gehören zum Beispiel sichere mobile Kommunikationslösungen, genauso wie Systeme, die mobile und drahtgebundene Komponenten nahtlos verbinden oder immer größere Speicherkapazitäten integrieren.

Mit unseren auf Kommunikations- und Speicheranwendungen fokussierten Kernkompetenzen, unserem umfassenden Technologie-Know-how und unserer überragenden Systemkompetenz, sind wir in der einzigartigen Marktposition, eine Vielzahl der Halbleitertechnologien und Chip-Lösungen anzubieten, die das Internet der Zukunft ausmachen. Und damit ist und bleibt eines unserer wesentlichen Wertschöpfungspotentiale die spannende Herausforderung, den Fortschritt des Internets mit einzigartigen Halbleiter- und Systemlösungen voranzutreiben.

AUSBLICK

Unser Ausblick für das Geschäftsjahr 2001 ist weiterhin positiv. Infineon will wiederum stärker als der Branchendurchschnitt wachsen. Vor allem bei unseren Kommunikationsprodukten rechnen wir mit einer besonders großen Nachfrage. Wir werden unser weltweites Forschungs- und Entwicklungsnetz weiter ausbauen und in schnell expandierenden Märkte mit hohen Margen investieren. Mit einer schnellen Umstellung der Speicherchip-Produktion von 200- auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben und der Nutzung externer Auftragsfertigungen werden wir die Produktionskapazität für unsere Kommunikationskomponenten deutlich erhöhen.

Infineon will die Ergebnis-Margen der Kommunikationsbereiche weiter erhöhen und da Produktportfolio aller Geschäftsbereiche weiter optimieren. Bei den Speicherchips werden wir uns auf Marktsegmente konzentrieren, die weniger den zyklischen Marktschwankungen unterliegen und höhere Margen bieten, wie beispielsweise Produkte für Server- und Netzwerkcomputer.

Abschließend möchte ich mich bei unseren mehr als 29000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihre Motivation, ihren Einsatz und ihre herausragenden Leistungen bedanken. Unseren Erfolg verdanken wir ihrer Kreativität, ihrem Engagement und ihrem Teamgeist. Und ihrem Vertrauen: denn fast alle sind nun ebenfalls Aktionäre ihres Arbeitgebers. Deshalb freut es mich besonders, dass der Vorstand in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat von Infineon der Hauptversammlung eine einmalige Dividendenauszahlung von 0,65 Euro je Stückaktie vorschlagen wird. Im Fall einer Zustimmung wird die Gesellschaft insgesamt 407 Millionen Euro an ihre Aktionäre ausschütten.

Das gesamte Infineon-Team hat dieses Geschäftsjahr für alle von uns zu einem Rekordjahr gemacht. Dabei haben wir unser Unternehmensmotto 'Never stop thinking' als Herausforderung erfolgreich angenommen - zum Vorteil des Unternehmens, unserer Kunden und Mitarbeiter sowie natürlich zum Vorteil unserer Aktionäre. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns so auch in Zukunft in einem sehr dynamischen und erfolversprechenden Markt behaupten werden.

Ich danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

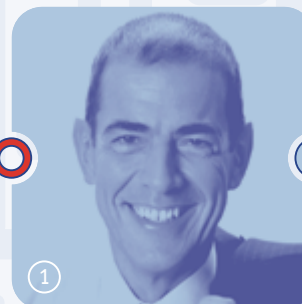
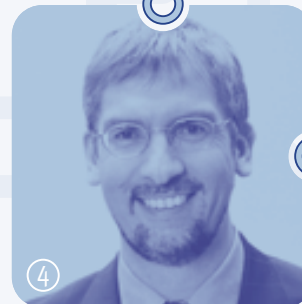
Dr. Ulrich Schumacher



one on one

Die Vorstände von Infineon
stehen Rede und Antwort.

- 1 Dr. Ulrich Schumacher
- 2 Peter Bauer
- 3 Peter J. Fischl
- 4 Dr. Sönke Mehrgardt
- 5 Dr. Andreas von Zitzewitz



F: Sind Sie einverstanden damit, wie die Finanzwelt den Halbleitermarkt beurteilt?

A: Wir finden es gut, dass die Investoren und Analysten weltweit den derzeitigen Wandel im Halbleitersektor erkannt haben. Unsere Branche steht und fällt nicht mehr nur mit dem PC-Markt: Tatsächlich entfällt darauf nur noch rund 40 Prozent des Chipabsatzes. Und dieser Anteil sinkt weiter.

Als überall auf der Welt die Informationstechnologie Einzug hielt waren allerdings PC-Hersteller der Rückhalt der Halbleiterindustrie. Durch den beinahe grenzenlosen Chipbedarf der Computerhersteller expandierte unsere Branche in den letzten vier Jahrzehnten im Jahresdurchschnitt um 14 Prozent – und damit schneller als alle anderen Industriezweige. Mittlerweile wurden weltweit über eine Milliarde PCs produziert. Einer der Hauptfaktoren dafür, dass in unserer Branche im Jahr 2000 bereits über 200 Milliarden Dollar Umsatz erzielt wurden. Dieser Boom endet jetzt aber nicht, im Gegenteil. In den kommenden Jahren wird der Halbleitermarkt sicherlich weiter wachsen. Zum Teil wird der PC-Absatz dafür verantwortlich sein. Aber eine noch bedeutendere Rolle werden die Kommunikationstechnologien einnehmen. Diese werden all die PCs mit der geradezu explodierenden Anzahl von intelligenten Geräten wie Mobiltelefonen, PDAs, Set-Top Boxen und den kommunikationstechnisch mit der Außenwelt verbundenen Autos zu einem einzigen, weltweiten Netzwerk verbinden.

F: Der Halbleitermarkt richtet sich also neu aus. Welche Rolle spielt Infineon dabei?

A: Wir waren und sind aufgrund unserer Aktivitäten in den Wachstumssegmenten des Kommunikationsbereichs eine treibende Kraft für diesen Wandel. Bei Halbleiterkomponenten für den Zugang zum Internet sowie für WAN-, LAN-, BLUETOOTH-, GSM-, GPRS-, UMTS- und Hochsicherheits-Anwendungen gehören wir zu den wichtigsten Anbietern. Infineon erreichte seine Führungspositionen in diesen Teilmärkten, indem wir unsere Strategie konsequent darauf ausgerichtet haben, als Schlüssellieferant für M-Business und E-Business-Technologien sowie für entsprechende Mobilfunk- und Breitband-Netzwerke aufzutreten.

Q. In den Augen vieler Analysten ist Infineon allerdings immer noch stark abhängig vom Speichermarkt.

A: Das hat schon seinen Grund. Unser Ebit-Jahresergebnis belief sich ja auf 1,67 Milliarden Euro. Davon stammen 80 Prozent aus dem Speichergeschäft, obwohl dieser Bereich 'nur' 48 Prozent des Gesamtumsatzes erzielte.

Doch unsere anderen beiden Geschäftszweige - Chips für Kommunikationssysteme sowie für die Automobil- und Industrieelektronik - haben das Geschäftsjahr 2000 schließlich auch sehr erfolgreich abgeschlossen. So verzeichneten wir Umsatz- und Ebit-Steigerungen von 36 bzw. 57 Prozent in der Kommunikation sowie 32 bzw. 204 Prozent bei Automotive. Im Vergleich dazu hat der Bereich Speicherprodukte einfach noch besser abgeschnitten.

Q: Also liegen die Analysten doch richtig.

A: Ja und nein! Denn unsere Speicherchips sind oft nicht mehr einfach nur DRAMs. Lassen Sie uns das erklären: Einen wichtigen Teilsegment des Speicherchip-Marktes bilden heute die 'embedded DRAMs'. Hierbei werden zusätzliche Funktionen wie das Erfassen, Verarbeiten und Übertragen von Daten in den Speicherchipsätzen integriert. Und dadurch werden diese zu sehr kleinen eigenständigen Kommunikations- und Rechensystemen.

Q: Was ist denn der Vorteil, wenn mehrere Funktionen auf einem Chip kombiniert werden?

A: Indem wir die Aufgaben, die bisher von mehreren Halbleiterkomponenten wahrgenommen wurden, auf einem einzigen Stück Silizium zusammenfassen - dem sogenannten 'System-on-a-Chip' oder kurz 'SoC', kann der Platzbedarf und gleichzeitig der Stromverbrauch der winzigen Systeme reduziert werden. Deshalb kommen solche SoCs zum Beispiel in Mobiltelefonen zum Einsatz, die ja immer kleiner und handlicher geworden sind.

Wie Sie sicher bemerkt haben, müssen die Akkus neuer Mobiltelefone auch seltener aufgeladen werden. Außerdem haben moderne Handys viel mehr Zusatzfunktionen. Manche davon sind ziemlich erstaunlich, andere einfach amüsant: Wir können nicht mehr nur telefonieren, wir lassen uns informieren und unterhalten, können per Handy einkaufen und sogar Notrufe absetzen - und das rund um den Globus.

Q: Aber was haben SoCs mit diesen neuen Möglichkeiten zu tun?

A: Es gibt Vorteile die über den geringeren Platzbedarf und Stromverbrauch hinausgehen. Wenn wir eine Menge von Rechenabläufen nebeneinander auf einem sehr kleinen Chip unterbringen, entsteht zwischen diesen Rechenoperationen ein viel intensiveres Zusammenspiel. Und allein daraus erhalten die Geräte neue Fähigkeiten.

Die Systemchips sind übrigens auch dafür verantwortlich, dass die Kommunikationssysteme weltweit – einschließlich Telefonnetze, Internet sowie Unternehmensnetzwerke – nicht mehr nur kompatibel sind sondern auch auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer eingehen können.

Q: Welche Bedeutung kommt Infineon dabei zu?

A: Sehen Sie sich unsere Produkte an: Infineon ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hightech-Chips. Und unser fundiertes Halbleiter-Know-how wird belegt durch weltweit über 28.200 angemeldete Patente und Schutzrechte.

Damit verfügen wir über den riesigen Erfahrungsschatz, der benötigt wird, um unterschiedlichste Funktionen in ein Einzelsystem zu integrieren. Wie unser Produktspektrum belegt, liegen unsere Stärken aber nicht nur darin, neue Technologien zu entwickeln. Es gelingt uns auch, sie besonders schnell zur Marktreife zu bringen sowie mit ihnen neue Märkte zu erschließen.

Q: Gilt das auch für die 300-Millimeter-Technologie, die ja die Halbleiterindustrie revolutionieren soll?

A: Im Jahr 2002 werden wir an unserem hochmodernen Standort in Dresden als weltweit erster Speicherchip-Hersteller die DRAM-Massenproduktion auf 300-Millimeter-Scheiben starten.

Das wird uns einen beträchtlichen Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern sichern, die dann immer noch auf 200-Millimeter-Wafer produzieren. Und in dieser Branche können ein paar Prozentpunkte den Aufstieg oder den Untergang eines Unternehmens besiegeln.

Unter Einsatz dieser neuen Technologie und einer Reihe anderer Innovationen schließt Infineon einen Änderungsprozess ab. Nun sind wir ein Unternehmen, das für die Industrie Maßstäbe setzt, und das von seinen sehr kostenbewussten Kunden respektvoll beachtet wird. Beispielsweise liegen wir heute bei den Produktionskosten für DRAMs unter denen der meisten Wettbewerber - das war vor Jahren noch undenkbar.

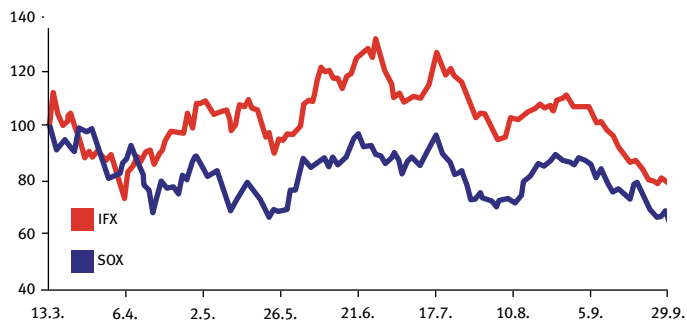
“Ein Unternehmen zu schaffen, in das die Anleger investieren...”

...wollen, ist erst der Anfang. Jetzt geht es uns vor allem darum,
langfristig den Unternehmenswert zu steigern. Nur so bleibt
die Infineon-Aktie ein attraktives Investment.”

Dr. Ulrich Schumacher

DIE INFINEON-AKTIE (IFX) IM GESCHÄFTSJAHR 2000

ENTWICKLUNG IM VERGLEICH ZUM PHILADELPHIA
HALBLEITER-AKTIENINDEX SOX - INDIZIERT AB 13.3.2000



Kursentwicklung (Xetra)

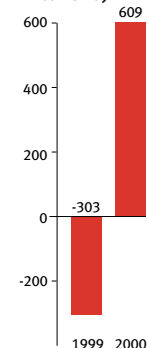
Ausgabe (13.3.)	€35,00
Höchst (27.6.)	€93,60
Tiefst (5.4.)	€49,50
Schluss (29.9.)	€54,88

Anzahl Aktien im Jahresdurchschnitt	614 Mio.
Anzahl Aktien am 29.9.	625,5 Mio.
Börsenkapitalisierung am 29.9.	€34.327 Mio.

Konzernjahresüberschuss (je Aktie)	€1,83
Dividendenvorschlag (je Aktie)	€0,65

Infineon verbesserte seinen Geschäftswertbeitrag (GWB) von minus 303 Millionen Euro im Vorjahr auf 609 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2000. Der GWB ist definiert als der operative Nettogewinn nach Steuern (NOPAT) abzüglich der Kapitalkosten, also abzüglich der angenommenen Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals.

GESCHÄFTSWERTBEITRAG INFINEON WELTWEIT (IN MIO. EURO)



LAGEBERICHT

VORSTAND WILL DIVIDENDE AUSSCHÜTTEN

Obwohl die Gesellschaft im Börsenzulassungsprospekt/Verkaufsprospekt vom März 2000 eine Dividendenausschüttung nicht in Aussicht gestellt hat, möchte der Vorstand die Aktionäre von Infineon an der ausgezeichneten Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2000 beteiligen. Aufgrund der noch gültigen Spreizung von Ausschüttungs- und höherem Einbehaltungssteuersatz ist es außerdem günstiger, die Aktionäre an der positiven Ergebnisentwicklung teilhaben zu lassen und bei Bedarf eine Kapitalerhöhung durchzuführen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende von 0,65 Euro je auf den Namen lautende Stückaktie zu zahlen. Sofern die Hauptversammlung dem Vorschlag zustimmt, wird insgesamt ein Betrag von 407 Millionen Euro ausgeschüttet. Anrechnungsberechtigte Aktionäre erhalten zusätzlich eine Steuergutschrift von rund 0,28 Euro je Aktie und damit insgesamt rund 0,93 Euro je auf den Namen lautende Stückaktie.



Infineon
technologies

Unsere Mission

Wir schaffen und maximieren Werte für unsere Kunden, unsere Aktionäre und unsere Mitarbeiter, indem wir:

- die fortschrittlichsten Halbleiterlösungen und Dienstleistungen entwickeln, herstellen und vermarkten
- auf unsere Kernkompetenzen und unsere technologischen Stärken bauen. So streben wir danach, unseren Kunden eine übergreifende Palette an Zukunftsprodukten anzubieten, die Kommunikations-, Internet- und Automobilanwendungen zusammenführen. Unser Fokus liegt auf den Bereichen Breitband und Netzzugang, mobile Kommunikation sowie Sicherheitsanwendungen und genauso auf Speicherprodukten und Elektronikkomponenten
- weltweit die besten und fähigsten Talente gewinnen und an uns binden, indem wir ihnen herausfordernde Tätigkeiten, ein kreatives Arbeitsumfeld sowie erstklassige Vergütungen bieten
- immer weiter denken - getreu unserem Motto: Never stop thinking.

Das Management Team



Dr. Ulrich Schumacher
Vorsitzender
des Vorstands (CEO)



Peter Bauer
Vorstand Vertrieb
und Marketing (CMO)



Peter J. Fischl
Vorstand Finanzen (CFO)



Dr. Sönke Mehrgardt
Vorstand Technologie (CTO)



Dr. Andreas von Zitzewitz
Vorstand Operations (COO)



Harald Eggers
Leiter Geschäftsbereich
Speicherprodukte



Awa Garlinska
Leiterin Bereich
Vertrieb



Gerhard Geiger
Leiter Geschäftsbereich
Drahtgebundene Kommunikation



Ulrich Hamann
Leiter Geschäftsbereich
Sicherheits- & Chipkarten-ICs



Loh Kin Wah
Geschäftsführer
Infineon Asien-Pazifik



Dr. Werner Mohr
Leiter Bereich
Frontend-Produktion



Yasuaki Mori
Direktor
Infineon Japan



Dr. Karl Platzoeder
Leiter Bereich
Backend-Produktion



Dr. Reinhard Ploss
Leiter Geschäftsbereich
Automobil- & Industrieelektronik



Jan du Preez
Geschäftsführer
Infineon Nordamerika



Tony Webster
Leiter Bereich
Cores & Modules



Günter Weinberger
Leiter Geschäftsbereich
Mobile Kommunikation

High-Tech vom Feinsten

SYSTEM-ON-A-CHIP: KLEIN ABER OHO

DIE HERAUSFORDERUNG

Früher wurden die verschiedensten Kommunikations- und Rechengänge meist von mehreren Halbleiter-Bauelementen parallel ausgeführt. Mittlerweile werden viele Funktionen auf einem einzigen Chip vereint, so dass...

- sowohl Platzbedarf als auch Energieverbrauch der Halbleiter- Bauelemente massiv reduziert werden konnten: Die Voraussetzung für kleinere mobile Geräte, deren Akkus länger ohne Steckdosen-Stop auskommen.
- der interaktive Datenaustausch immer schneller abläuft und damit völlig neue Einsatzmöglichkeiten geschaffen werden.



DER MARKT

Die zunehmende Mobilität ist einer der Wachstumstreiber des globalen Halbleitermarktes. Bereits ein Großteil der weit über 200 Milliarden US-Dollar, die die Halbleiterindustrie im Jahr 2000 erwirtschaftet hat, wurde mit System-on-a-Chip (kurz SoCs) erzielt.

Diese System-ICs stecken heute in allem was mobil macht: in Handys, Notebooks, digitalen Terminplanern (PDAs) – und, nicht zu vergessen, auch im Auto. Denn dass die heutigen Kraftfahrzeuge um ein Vielfaches umweltfreundlicher und sicherer sind, ist vor allem auch ein Verdienst von SoC-Anwendungen.

DIE POSITION VON INFINEON

Ungefähr die Hälfte unseres gesamten Umsatzes stammt bereits aus dem SoC-Geschäft – das ist auf alle Fälle mehr als bei den meisten Wettbewerbern.

Ermöglicht wird dies zum einen durch eine umfangreiche Konstruktionsbibliothek, die die verschiedensten Chipdesigns beinhaltet. Aufgrund des Umfangs und der Vielfalt dieser Bibliothek kann Infineon auch äußerst komplexe Chipstrukturen besonders schnell und zuverlässig konstruieren.

Darüber hinaus arbeiten bei Infineon Software-Spezialisten, die das automatische elektronische Entwickeln und Testen von Chips (Electronic Design Automation) ermöglichen. Weiterhin verfügt Infineon über das gesamte Technologie-Know-how, das zum Entwurf von SoCs erforderlich ist. Dazu gehören die Produktionsprozesse zur Fertigung von embedded DRAMs, embedded Controller bzw. digitalen Signalprozessoren (DSP) sowie für Chips mit analogen und digitalen (mixed-signal) Funktionen.

Dadurch dass wir den gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess für SoCs beherrschen, hat Infineon also einen Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern, deren Know-how sich auf einen oder zwei dieser Kompetenzen beschränkt.

DIE 300MM-GESCHICHTE: GRÖßERE WAFER, GERINGERE KOSTEN

DIE HERAUSFORDERUNG

Wer als erster Chips auf 300-Millimeter-Wafer fertigt, wird im Vergleich zur Produktion auf Siliziumscheiben mit 200 Millimetern Durchmesser...

- seine Produktionsleistung um das Zweieinhalbfache steigern
- und seine Stückkosten erheblich vermindern können.

DIE MARKENTWICKLUNG

Die allermeisten Fertigungsstätten, die die Halbleiterindustrie in Zukunft baut, werden mit der 300-Millimeter-Technologie ausgerüstet.

DIE POSITION VON INFINEON

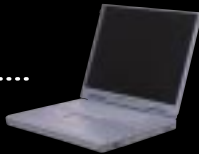
Infineon steht bei der Umstellung auf diese Technologie klar mit an der Spitze der Industrie. Zunächst waren wir das erste Unternehmen, das auf 300-Millimeter-Wafer produzierte 64-Megabit-Speicherchips liefern konnte. Spätestens Mitte 2002 werden wir in Dresden mit der Serienfertigung von 256-Megabit-DRAMs beginnen. Schon bald folgen 512-Megabit-Chips.

Es ist geplant, dass im Jahr 2003 die gesamte Speicherchip-Produktion von Infineon auf die 300-Millimeter-Technologie umgestellt ist. Dabei werden allerdings keine zusätzlichen Produktionskapazitäten geschaffen, denn die 200-Millimeter-Fabriken werden parallel auf die Fertigung von Logik-Chips umgerüstet.

Dank der Bluetooth-Technologie wird...



Ihr Handy kabellos mit Ihrem Computer kommunizieren,



Ihr Notebook Termine mit Ihrem persönlichen digitalen Assistenten (PDA) automatisch koordinieren, und



Ihr PDA Notizen direkt ausdrucken können.



BLUETOOTH™: DAS KABEL-WIRRWARR HAT EIN ENDE

DIE HERAUSFORDERUNG

Bluetooth-Lösungen sollen den drahtlosen Datenaustausch zwischen Computern, Telefonen, Druckern sowie mobilen und anderen elektronischen Geräten revolutionieren.

DER MARKT

Die Zahl verkaufter Bluetooth-Chips soll bereits im Jahr 2001 eine zweistellige Millionenhöhe erreichen. 2002 soll diese Zahl sogar auf Hunderte Millionen ansteigen.

DIE POSITION VON INFINEON

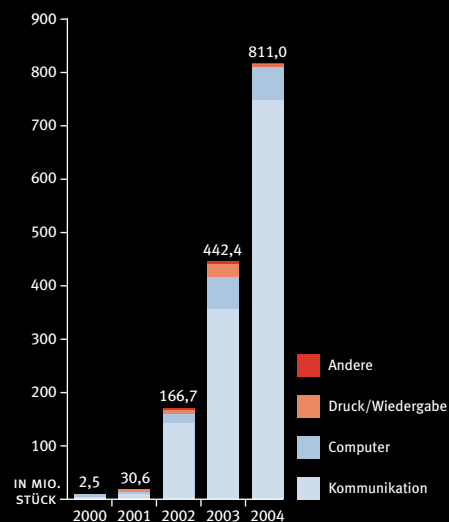
Infineon belegt bereits einen Spitzenplatz im globalen Chipmarkt für drahtlose Anwendungen im Büro und Haushalt. Bis heute hat das Unternehmen weit über 30 Millionen Komponenten für DECT-Telefone, WDCT-Systeme und andere schnurlose Geräte hergestellt.

Mit Hilfe der Bluetooth-Technologie werden in naher Zukunft die Möglichkeiten innerhalb dieser kleinen Netzwerke um zahlreiche zusätzliche Anwendungen erhöht.

Im Rennen um die Belieferung der weltweiten Bluetooth-Gerätehersteller hat Infineon dank des vorhandenen Know-hows die Nase vorn. So haben wir Ende 2000 das Chipset 'BlueMoon 1' vorgestellt, die erste qualifizierte Bluetooth-Halbleiterlösung zur drahtlosen Verbindung von Mobiltelefonen, Notebooks, PDAs, Set-Top-Boxen und anderen Geräten.

BLUETOOTH-FÄHIGE GERÄTE WELTWEIT

QUELLE: CAHNER'S IN-STAT GROUP, 2000



UMTS: DAS INTERNET IM WESTENTASCHENFORMAT

DIE HERAUSFORDERUNG

Mobiltelefone sollen sich zu vollwertigen Internet-Terminals entwickeln.

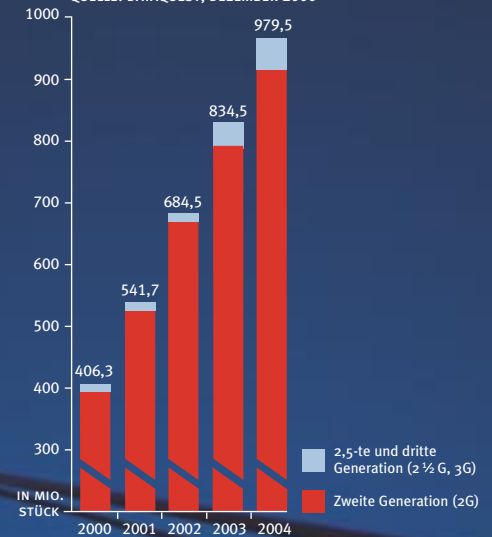
DER MARKT

Bis heute wurden weltweit rund 900 Millionen Handys produziert. Bis Ende 2003 werden es etwa zwei Milliarden sein. Demnach werden Mobiltelefone bei weitem das Kommunikationsmittel Nummer Eins werden. Zusammen mit Fernsehern und anderen, nicht computer-basierten Geräten werden Handys sogar mehr als die Hälfte der Internet-Terminals repräsentieren.

Die Anzahl der Mobiltelefone, die GPRS, UMTS und andere Kommunikationstechnologien der nächsten Generation nutzen können, soll noch schneller wachsen. So wird erwartet, dass im Jahr 2010 weltweit circa zwei Milliarden Teilnehmer die UMTS-Netzwerke nutzen.

DER WELTMARKT FÜR DIGITALE UND BREITBAND-MOBILTELEFONE

QUELLE: DATAQUEST, DEZEMBER 2000



DIE POSITION VON INFINEON

Zwei neue Produkte des Unternehmens, ein Basisband-Chip und ein Hochfrequenz-Transceiver, sorgen bereits für noch handlichere und im Unterhalt günstigere Mobiltelefone mit Internet-Funktion. Diese Chips werden in den neuen GPRS- und EDGE-fähigen Handys der 2½ Generation eingesetzt. Hierbei ermöglichen sie Datenübertragungsraten von bis zu 107 Kilobits pro Sekunde – also zehnmal schnellere Anwendungen als bisher.

Für noch mehr Furore sorgt allerdings unser neuer Chip namens M-GOLD. Mit ihm kann der Einsatz der ersten mobilen Geräte der dritten Generation dauerhaft gesichert werden – sowohl in aktuellen GSM- als auch in künftigen UMTS-Netzwerken. Mit ihm wollen wir natürlich vor allem neue Kunden gewinnen...

BREITBAND: WER WILL SCHON WELT-WEIT-WARTEN

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Übertragungsgeschwindigkeit, die mit vorhandenen Kupferleitungen erreicht wird, lässt sich mit Hilfe von xDSL-Technologien um das bis zu 120-fache erhöhen. Oder der Kupferdraht wird gleich ersetzt: durch bis zu 40.000-mal schnellere Glasfaserverbindungen.

Damit sollten Wartezeiten beim Herunterladen von Dateien aus dem World Wide Web sowie Störungen beim Verfolgen von Live-Sendungen im Internet bald der Vergangenheit angehören.

DER MARKT

Obwohl sich ISDN-Anlagen heute noch extrem gut verkaufen lassen, wird dieser Markt schon in wenigen Jahren dominiert werden von xDSL- und anderen Technologien zur Überbrückung der letzten Anschlussmeile. Noch viel schnellere, optische Netzwerke werden folgen.

DIE POSITION VON INFINEON

Bei ISDN-Chips ist und bleibt Infineon weltweit die Nummer 1. Bereits jetzt nehmen wir auch eine führende Position im VDSL-Markt ein, für den wir das Chipset '10BaseS' (gesprochen: 'Ten-Base-S') entwickelt haben.

10BaseS übermittelt Datenpakete mit bis zu 26 Megabit pro Sekunde über einen einzigen Kupferdraht – eine einmalige Voraussetzung für

interaktives Fernsehen, Videospiele auf Abruf und gestochen scharfe Bilder von Telekonferenzen.

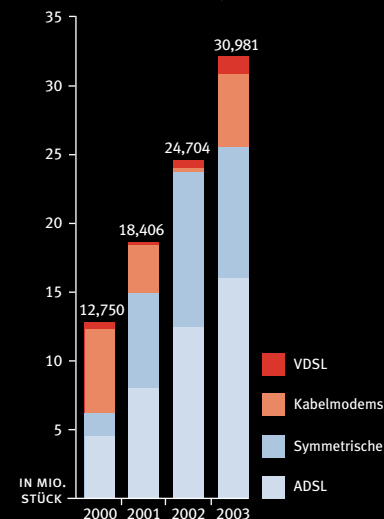
Außerdem unterstützt 10BaseS Ethernet-Datenübertragungen, die über Distanzen von 1,2 Kilometern 100-mal schneller sind als ISDN-Leitungen. Damit können auf allen Liegenschaften, die bereits über eine Telefonanlage verfügen, schnell und kostengünstig höchst zuverlässige Kommunikationsnetze eingerichtet werden.

Dank 'Sokrates' steht Infineon auch im SHDSL-Markt in der ersten Reihe. Unser Einkanal-SHDSL-Transceiver bringt die Leistung vorhandener Kupferleitungen fast auf das Niveau einer Standleitung.

Ebenso gut ist Infineon's Position bei optischen Netzwerken.

Unsere Produktfamilie 'PAROLI' ermöglicht schnellste Breitband-Datenübertragung über Glasfaserkabel in lokalen Netzwerken.

EINSATZBEREICHE DER WELTWEIT VERKAUFTEN CHIPSETS FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITS-VERBINDUNGEN
QUELLE: DATAQUEST, AUGUST 2000



SICHERHEIT: WIE WIR HACKERN DIE GESCHÄFTSGRUNDLAGE ENTZIEHEN

DIE HERAUSFORDERUNG

Sich von Viren, Online-Betrügereien oder anderen Sicherheitsproblemen im Umgang mit Computern nicht mehr den Schlaf rauben lassen zu müssen. Und dabei jederzeit und überall online Zugang zu Dienstleistungen oder Informationen zu haben.

DER MARKT

Der Markt für Sicherheits- und Chipkarten-ICs – inklusive Chips zur sicheren Datenspeicherung und Identifizierung sowie Beratungsdienstleistungen – hatte im Jahr 2000 ein Volumen von 5,5 Mrd. Euro und wird bis 2005 auf 22 Mrd. Euro ansteigen.



DER MARKT FÜR CHIPKARTEN (IN MRD. STÜCK)

QUELLE: SCHÄTZUNGEN VON
INFINEON, DEZEMBER 2000

1,9
MRD.

2000

21-35 MRD.*

*d.h. jeder Mensch
hätte mindestens
drei Karten

2010

DIE POSITION VON INFINEON

Den aktuellsten Zahlen zufolge ist Infineon weltweiter Marktführer bei Chips für Chipkarten, also den Sicherheits-schleusen an den Toren zur Kommunikationswelt. Aber das ist erst der Anfang, wie folgende Entwicklungen zeigen:

DAS ENDE DES DATEN-DIEBSTAHL

Brauchen Sie noch PINs und Passwörter? Sie selbst haben etwas viel Besseres zu bieten als diese oft einfach zu knackenden Schlüssel zur E-Welt, die man zudem leicht vergisst: Ihre Fingerspitzen. Der FingerTIP-Sensor von Infineon liest Ihren Fingerabdruck auf der PC-Maus, der Computertastatur, dem Armaturenbrett Ihres Wagens und vergleicht diesen mit dem zuvor gespeicherten Muster. Stimmen beide überein, erhalten Sie den gewünschten Zugang. Diese biometrischen Chips, die als erste ihrer Art in Serie gefertigt werden, erlauben auch eine Kontrolle über Grad und Umfang des Zugangs.

DER BEGINN DER WIRKLICH SICHEREN ONLINE-WELT

Bei elektronisch abgewickelten Bank- und Handelsgeschäften werden künftig digitale Unterschriften das Eintippen von Transaktions- oder Kreditkartennummern ersetzen. Dabei werden unter anderem Chips von Infineon dafür sorgen, dass die notwendigen elektronischen Codierungsvorgänge sicher und benutzerfreundlich sind, beides Eigenschaften, die bei bisherigen Methoden der Online-Identifikation vermisst werden.

Ein Beispiel: im Jahr 2000 wurde dem neuesten Chipkarten-Controller von Infineon bescheinigt, dass er die weltweit strengsten Sicherheitsstandards für Chipkarten-ICs erfüllt. Das ist das dritte Produkt, für das wir diese Zertifizierung erhielten – Konkurrenzprodukte haben dieses Zertifikat nicht. Unser Controller-Chip hat also die besten Chancen, zu einem entscheidenden Faktor beim Aufbau der Verarbeitungssysteme für digitale Unterschriften zu werden.

Unsere Partner. Und warum

Frage:

Der Halbleitersektor gilt allgemein als stark wettbewerbsorientiert. Wieso also kooperiert Infineon dann mit 20 anderen führenden Unternehmen – darunter harte Wettbewerber?

Antwort:

Weil die technologische Entwicklung in diesem Bereich so schnell ist, so viel kostet und so weitreichende Auswirkungen hat, dass wir ohne unsere Partner ernsthafte Nachteile hätten. Und zusammen können wir auch besser einschätzen, was der Markt in Zukunft nachfragen wird.

Milliardenrisiken auf eine vertretbare Größe reduzieren. Entwicklungszeiten von Jahren auf Monate verkürzen und die erforderliche Anzahl von Unternehmen dazu bringen, neue Technologien auch einzusetzen. Das sind einige der Überlegungen, die Halbleiterhersteller weltweit dazu bringen, an übergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten mitzuarbeiten - in vielen Fällen unter der Schirmherrschaft von internationalen Organisationen wie Sematech und MEDEA.

Infineon ist unter anderem wegen seiner umfangreichen (Daten-)Bibliothek an patentierten Chipdesigns ein begehrter Partner bei solchen Projekten. Seit diesem Geschäftsjahr gehört dazu die Forschungsgemeinschaft Advanced DRAM Technology (ADT): hier sind unsere Partner Intel - selbst Aktionär von Infineon, NEC - auch Partner bei der Entwicklung von Speicherchips mit 'virtuellen Kanälen', sowie Hyundai, Micron und Samsung - alles erst zu nehmende Konkurrenten von Infineon.

Eine unserer produktivsten Partnerschaften ist die mit IBM - gleichzeitig einer unserer größten Kunden. Im Jahr 1990 haben wir zusammen eine DRAM-Entwicklungsgemeinschaft ins Leben gerufen, die derzeit den 1-Gigabit-Chip entwickelt. Gemeinsam gehört uns auch der französische Logikchip-Hersteller ALTIS. Weiterhin arbeiten beide Firmen mit UMC zusammen, einem Chiphersteller mit Sitz in Taiwan. Die Dreier-Allianz entwickelt zusammen Technologien zur Herstellung von Logik-ICs mit Strukturen zwischen 0,13 und 0,10 Mikrometern.

Es ist allgemein bekannt, dass der Weltmarkt für Datenübertragungen via Glasfaser förmlich explodieren kann - vorausgesetzt die richtige Infrastruktur wird errichtet. Und um dabei kräftig mitzumischen, wurde eine Allianz geschmiedet, der neben Infineon auch die Netzwerk-Ausrüster JDS Uniphase, LightLogic und Nortel Networks angehören.

Und die Liste unserer Partner wächst und wächst... beispielsweise entwickeln wir jetzt auch zusammen mit unserem Kunden Nokia neue mobile Einsatzfelder.

AMD

Cisco Systems

Hitachi

Hyundai

IBM

IMEC

Intel

JDS Uniphase

Micron

Mosel Vitelic

Motorola

NEC

Nokia

Nortel Networks

Samsung

Siemens

Toshiba

UMC

Erfolge mit Schlüsselkunden

‘Wir unterstützen unsere Schlüsselkunden weltweit dabei, ihre dominierenden Marktpositionen noch weiter auszubauen. Denn der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg.’ Das beharrliche Verfolgen dieser Strategie führte dazu, dass im Geschäftsjahr 2000 bereits 55 Prozent unseres Umsatzes mit Schlüsselkunden erzielt wurde.

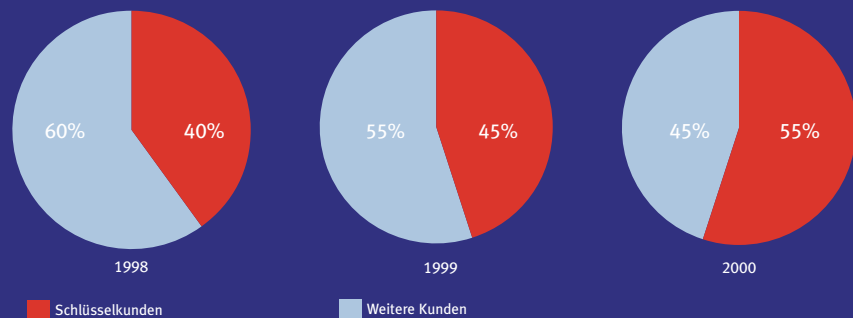
Auf dieses Ergebnis sind wir stolz – und besonders auch darauf, dass wir seit dem Start in die Unabhängigkeit unsere Stellung als Lieferant bei einigen der wichtigsten Kunden deutlich gestärkt haben. Diese kommen aus unseren Hauptzielmärkten in der Kommunikationsindustrie, der Computerbranche und der Automobilindustrie.

Im Bereich Breitbandkommunikation haben wir unsere Geschäftsbeziehungen mit führenden Unternehmen wie Alcatel, Cisco und Nortel Networks gefestigt und ausgedehnt. Weiterhin konnten wir die Umsätze mit Topherstellern von Mobiltelefonen weiter steigern. Und wir haben unsere fortschrittlichsten Produkte auf dem US-Automobilmarkt eingeführt: zu unseren Neukunden zählen dort Delphi und Visteon.

Außerdem ist uns der Durchbruch in Japan gelungen: Seitdem wir uns bei Fujitsu und NEC, zwei führenden japanischen Elektronikherstellern, einen bedeutenden Lieferanteil im DRAM-Geschäft sichern konnten, haben sich unsere Umsätze dort mehr als verdoppelt.

Ein anderer aktueller Eckpfeiler der Infineon-Strategie ist der Ausbau unserer Produktionskapazitäten. Damit wollen im Jahr 2001 die Lieferzeiten wieder auf ein normales Maß zurückführen.

VERTEILUNG DES UMSATZES



Bericht des Aufsichtsrates

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE,

die am 30. März 1999 errichtete und am 14. Juli 1999 in das Handelsregister eingetragene Infineon Technologies AG führt seit dem 1. April 1999 die Geschäfte des ehemaligen Halbleiterbereiches der Siemens AG fort. Mit dem erfolgreichen Börsengang am 13. März 2000 wurde die Infineon Technologies AG zu einer Publikumsgesellschaft. Die Aktien sind seitdem im amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und an der New York Stock Exchange notiert.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung sowie in den jeweiligen Sitzungen umfassend über den Gang der Geschäfte und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche informiert. Über besondere Vorgänge wurde zusätzlich schriftlich berichtet. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand unterrichten lassen.

SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS UND DER AUSSCHÜSSE

Im Berichtsjahr haben fünf Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden. Zwischen diesen Sitzungen stand der Aufsichtsratsvorsitzende laufend in engem Kontakt mit dem Vorstand.

Der gemäß Paragraph 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Ausschuss (sogenannter Vermittlungsausschuss) musste nicht einberufen werden. Auch der Präsidialausschuss musste nicht zusammentreten, hat aber Beschlüsse zu Satzungsänderungen im Rahmen der ihm gemäss Geschäftsordnung des Aufsichtsrats eingeräumten Ermächtigung im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst. Der in der Aufsichtsratssitzung am 20. Januar 2000 gebildete

Investitions- und Finanzausschuss hat im Berichtsjahr zweimal getagt; weitere Beschlüsse zu zustimmungspflichtigen Geschäften wurden schriftlich im Umlaufverfahren gefasst.

BESETZUNG VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Die Herren Charles Herlinger, Karl Heinz Midunsky, Professor Dr. rer. pol. Michael Mirow und Dr. jur. Albrecht Schäfer haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zum 31. Oktober 1999 niedergelegt. In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 18. Oktober 1999 wurden die Herren Dr. Joachim Faber, Dr. h.c. Martin Kohlhaussen, Dr. Eberhard Rauch und Professor Dr.-Ing. Ingolf Ruge im Wege der Ergänzungswahl mit Wirkung ab 1. November 1999 für die restliche Amtszeit der Ausgeschiedenen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre gewählt.

In der Hauptversammlung am 19. Januar 2000 wurden die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner für fünf Jahre neu gewählt.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 20. Januar 2000 wurden die Herren Dr. Eng. h.c. Volker Jung zum Vorsitzenden, Alfred Eibl zum stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. h.c. Martin Kohlhaussen zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am 20. Januar 2000 wurden zusätzlich zu den kraft Amtes dem Vermittlungsausschuss (§27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz) angehörenden Aufsichtsratsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden die Herren Heinz-Joachim Neubürger als Anteilseignervertreter und Gerd Schmidt als Vertreter der Arbeitnehmer in den Vermittlungsausschuss gewählt.

Ferner hat der Aufsichtsrat einen Investitions- und Finanzausschuss bestellt, dem der Aufsichtsratsvorsitzende sowie ein Anteilseignervertreter und ein Vertreter der Arbeitnehmer angehören. Es wurden die Herren Heinz-Joachim Neubürger als Anteilseignervertreter und Alfred Eibl als Arbeitnehmervertreter gewählt.

JAHRESABSCHLUSS

Den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG zum 30. September 2000 sowie den Lagebericht der Infineon Technologies AG hat die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Wir haben diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Der Bericht der KPMG über die Prüfung des Jahresabschlusses lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurde in unserer Bilanzsitzung am 13. Dezember 2000 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. Wir hatten keine Einwendungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; dieser ist damit festgestellt.

Dem Vorschlag des Vorstands, eine Dividende von 0,65 Euro je auf den Namen lautende Stückaktie vorzusehen, stimmen wir zu. Der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG wurde auf der Grundlage dieses Dividendensatzes aufgestellt.

Dem vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß Paragraph 312 Aktiengesetz wurde vom Abschlussprüfer der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk

erteilt, wonach die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder eventuelle Nachteile ausgeglichen worden sind und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Wir haben den Bericht auch selbst geprüft. Wir erheben nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung keine Einwendungen gegen die Schlusserklärung des Vorstandes und stimmen dem Ergebnis der Prüfung durch die Abschlussprüfer zu.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und insbesondere auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Infineon Technologies AG für ihren Einsatz und ihre Leistung, vor allem bei der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen verbunden mit dem Börsengang und dem dynamischen Wachstum des Unternehmens. Darüber hinaus dankt der Aufsichtsrat den Betriebsräten für ihre konstruktive Mitwirkung.



München, im Dezember 2000
Für den Aufsichtsrat

Volker Jung
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Über unser **erstes** Jahr können wir Ihnen einiges berichten. Genauso erwarten uns in der Zukunft viele spannende Geschäftschancen. Deshalb wollen wir Sie natürlich auch über die hervorragenden mittel- und langfristigen Aussichten von Infineon informieren. Damit Sie sich ein möglichst vollständiges Bild davon machen können, wo das Unternehmen steht, haben wir auf den folgenden Seiten neben dem Lagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2000 weitere Beiträge mit vorausschauenden Ausführungen platziert. Einen Überblick über den Lagebericht erhalten Sie im nebenstehenden Inhaltsverzeichnis*.

* Falls Sie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht der Infineon Technologies AG in der ursprünglichen Reihenfolge lesen möchten, können Sie den 'Kurzbericht 2000' kostenlos anfordern im Internet unter www.infineon.com/boerse oder telefonisch bei Infineon Investor Relations, Telefon +49 (0)89 234-26655.

**LAGEBERICHT UND KONZERNLAGEBERICHT DER INFINEON
TECHNOLOGIES AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000
VOM 1. OKTOBER 1999 BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2000**

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Dividende	18
Einführung und Höhepunkte 2000	33
Aktuelle Entwicklungen	34
2001: Ausblick für Markt und Konzern	35
Vertrieb und Marketing	37
Forschung und Entwicklung	39
Berichte über die Geschäftsbereiche inklusive F+E-Aktivitäten und Ausblick:	
Drahtgebundene Kommunikation	41
Mobile Kommunikation	43
Sicherheits- und Chipkarten-ICs und Sonstige	45
Speicherprodukte	47
Automobil- und Industrieelektronik	49
Mitarbeiter	51
Technologie, Kooperationen, Investitionen	53
Beschaffung, Produktionskapazitäten	54
Ertragslage, Finanzlage, Vermögenslage	57
Ergebnis der Führungsgesellschaft	58
Hinweis auf Abhängigkeitsbericht	58
Risikobericht	58
Rechtlicher Hinweis	59

ERFOLGREICHER BÖRSENGANG UND REKORDERGEBNISSE

Das Geschäftsjahr 2000 war für Infineon geprägt durch eine weit über dem Marktwachstum liegende Ausweitung des Geschäftsvolumens und eine eindrucksvolle Steigerung der Rentabilität. Gleichzeitig stellte das Unternehmen weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Insbesondere wurden die Forschung und Entwicklung intensiviert, Produktionskapazitäten erweitert sowie die Vertriebsaktivitäten gestärkt. Im Mai 2000 wurde in Dresden der Grundstein gelegt für die weltweit erste Fabrik, in der ab dem Geschäftsjahr 2002 Chips auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben gefertigt werden sollen. Damit glaubt Infineon seine technologisch führende Position weiter ausbauen und sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern zu können.

Fast ein Jahr nach der Ausgliederung des Siemens-Halbleiterbereichs wurden die Aktien der Infineon Technologies AG am 13. März 2000 erstmals im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und als American Depositary Shares (ADS) an der New York Stock Exchange notiert. Die Kursentwicklung der ersten Monate trug dazu bei, dass Infineon am 19. Juni 2000 in den Kreis der DAX 30-Unternehmen, in den Index FTSE Eurotop 300 sowie in Einzelsegmente der Index-Familie DJ (Euro) STOXX aufgenommen wurde. Durch den Börsengang verfügt die Gesellschaft über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine Akquisitionswährung insbesondere auch in den USA.

Als alleiniger Altaktionär platzierte Siemens 156,8 Millionen Aktien. Infineon flossen infolge einer Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von 16,7 Millionen Aktien sowie einer Privatplatzierung von 7,6 Millionen Aktien bei Intel insgesamt 821 Millionen Euro zu. Der Anteil von Siemens am Grundkapital verringerte sich damit auf 71 Prozent. Siemens hat ferner eine garantierte Umtauschanleihe (Exchangeable Note) auf vier Prozent der Infineon-Aktien ausgegeben und im August 2000 an der Luxemburger Börse platziert. Die fest verzinslichen Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum August 2005. Die Inhaber der Anleihe können diese erstmals im August 2001 in insgesamt 25.000.000 Infineon-Aktien umtauschen.

Der Halbleitermarkt zeigte im Geschäftsjahr 2000 in allen wichtigen Segmenten ein starkes Wachstum. Insgesamt überstieg die Nachfrage nach Chipwendungen in nahezu allen Marktsegmenten die weltweit vorhandenen Fertigungskapazitäten der Halbleiterhersteller.

Für das Kalenderjahr 2000 erwartet das Marktforschungsinstitut *Gartner Dataquest* ein Gesamtwachstum der Halbleiterumsätze von 37 Prozent auf 232 Mrd. US-Dollar (Stand: Oktober 2000). Der Markt bei Nicht-Speicherchips - Logikchips, analogen, diskreten und optischen Komponenten - soll demnach um 30 Prozent wachsen. Die Gesamtumsätze im Speicherchip-Markt, welcher DRAMs und Flash Memories (nichtflüchtige Speicher) umfasst und etwa einem Viertel des Gesamtmarktes entspricht, sollen demzufolge sogar um 60 Prozent steigen.

Geografisch gesehen erwartet *Gartner Dataquest* das größte Wachstum mit mehr als 40 Prozent in der Region Asien/Pazifik. Der amerikanische Chipmarkt wächst im Jahr 2000 voraussichtlich um 38 Prozent, der japanische um 35 Prozent. Für Europa wird ein Gesamtwachstum von 34 Prozent erwartet.

IM GÜNSTIGEN MARKTUMFELD HAT INFINEON SEINE POSITIVE UMSATZ- UND AUFTRAGSENTWICKLUNG ERREICHT DURCH:

- eine verstärkte Fokussierung auf die weniger volatilen Wachstumssegmente Kommunikationssysteme und high-end DRAMs,
- den Ausbau der weltweiten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten,
- das Verkürzen der Zeitspannen von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung,
- die weitere Erhöhung der Fertigungskapazitäten und die nochmalige Steigerung der Produktivität sowie
- die Einstellung neuer Mitarbeiter in allen Bereichen und Regionen.

ERFOLGREICHES JAHR FÜR ALLE GESCHÄFTSBEREICHE

Infineon überprüft ständig seine strategische Positionierung und die daraus abgeleitete Organisation der Geschäftsbereiche, um die seit der Ausgründung aus der Siemens AG positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung fortzuführen.

Neben Investitionen ins wachstumsstarke Kerngeschäft gehört dazu, dass Produktfamilien, die nicht mehr zum Kerngeschäft eines Geschäftsbereiches gehören, verkauft bzw. einem Geschäftsbereich zugeordnet werden, der der Produktfamilie bezüglich Markt- und Kundenprofil sowie Technologiebasis näher steht. Seit dem Berichtsjahr konzentriert sich der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation verstärkt auf Produkte für die Internet-Infrastruktur.

Daher wurde das Geschäftsfeld Computerperipherie, das im Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz von 334 Mio. Euro (Vorjahr: 122 Mio. Euro) erzielte, in den Geschäftsbereich Speicherprodukte übertragen.

Ferner wurde das Geschäftsfeld Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, das zuletzt einen Umsatz in Höhe von 35 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro) erwirtschaftete, aus dem Geschäftsbereich Mobile Kommunikation in den Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation übertragen.

Weiter wurden zu Beginn des neuen Geschäftsjahres folgende Änderungen in den Geschäftsbereichen vorgenommen:

Im Oktober 2000 verkaufte Infineon seine Entwicklungs- und Vertriebsaktivitäten für die Unterhaltungselektronik (Geschäftsfeld Image & Video) an die Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich. Dieses Geschäftsfeld erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 139 Mio. Euro (Vorjahr: 120 Mio. Euro).

Der Vorstand hat bereits entschieden, im Geschäftsjahr 2001 das Geschäftsfeld Infrarot-Bauelemente zu veräußern, das Hochgeschwindigkeits- und lineare Optokoppler anbietet und nicht den Kernaktivitäten des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation zuzuordnen ist. Dieses Geschäftsfeld erzielte im Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz in Höhe von 137 Mio. Euro (Vorjahr: 101 Mio. Euro).

HERVORRAGENDES UMSATZ- UND ERGEBNISWACHSTUM BEI CHIPS FÜR KOMMUNIKATIONSSYSTEME

In den Segmenten Mobile Kommunikation, Drahtgebundene Kommunikation sowie Sicherheits- und Chipkarten-ICs (ohne Opto) konnte Infineon seinen Umsatz um 36 Prozent auf 2.536 Mio. Euro (Vorjahr: 1.861 Mio. Euro) und das Ebit (Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern) um 57 Prozent auf 388 Mio. Euro (Vorjahr: 247 Mio. Euro) deutlich steigern. Und das trotz der begrenzten internen und externen Produktionskapazitäten.

NACH JAHRESABSCHLUSS GESCHÄFTS- UND BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITER OPTIMIERT

Infineon hat Anfang Oktober 2000 einen Vertrag für den Erwerb sämtlicher Anteile an der Firma Ardent Technologies mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, zu einem Kaufpreis von 42 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Ardent ist spezialisiert auf hochintegrierte Schaltungen in breitbandigen Switching-Systemen und verfügt über ein breites Produktportfolio für Fast- und Gigabit-Ethernets. Die Akquisition erweitert die Präsenz des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation von Infineon im schnell wachsenden Chipmarkt für lokale Unternehmensnetzwerke (LAN).

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres übernahm die Tochtergesellschaft Sci-worx GmbH in Hannover die wesentlichen Geschäftsaktivitäten der Sican GmbH, einem der größten unabhängigen Designhäuser Europas für Kommunikations-ICs. Mit rund 300 Mitarbeitern entwickelt und vermarktet Sci-worx System-on-Chip-Lösungen für die sichere mobile und drahtgebundene Kommunikation und ergänzt damit den Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs.

Infineon erwarb darüber hinaus im Oktober 2000 - vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde - den 50-prozentigen Anteil von Motorola Inc. an dem Gemeinschaftsunternehmen Semiconductor 300 GmbH & Co. KG mit Sitz in Dresden. Gleichzeitig haben sich der Freistaat Sachsen und die Jenoptik-Tochter M+W Zander an der Gesellschaft beteiligt, die die weltweit erste Chip-Volumenfertigung auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben errichtet.

AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2001

Industrieanalysten: langfristig starkes Marktwachstum

Organisationen wie die *WSTS (World Semiconductor Trade Statistics)* und unabhängige Marktforschungsinstitute wie *Gartner Dataquest*, *VLSI Research* und *Future Horizons* prognostizieren für den weltweiten Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2001 weiterhin kräftige Wachstumsraten. Das Marktwachstum soll demnach in allen Regionen anhalten und vor allem in den Regionen USA sowie Asien-Pazifik überdurchschnittlich ausfallen. Der Anstieg der Nachfrage wird den Industrieanalysten zufolge mit einem niedrigeren zweistelligen Prozentwachstum bis ins Jahr 2002 anhalten.

Seit August 2000 gingen die durchschnittlich erzielten Preise für DRAMs wieder kontinuierlich zurück. Dieser Rückgang wurde als Reaktion auf hohe Lagerhaltungsquoten bei den PC-Herstellern und Zwischenhändlern gewertet. Zu Beginn des Jahres 2001 erwarten einige Marktforschungsinstitute wie zum Beispiel *Gartner Dataquest* (Stand: Oktober 2000) wieder höhere Preise aufgrund abnehmender Lagerbestände, wieder zunehmender Auftragseingänge sowie einem Nachfrageüberhang bei einigen Speicherprodukten. Jedoch kann niemand versichern, dass die vorhergesagten Preiserhöhungen tatsächlich eintreten.

Auch in der längerfristigen Vorschau bis zum Jahr 2004 prognostizieren die Industrieanalysten wie *Gartner Dataquest* für den Halbleitermarkt nach wie vor zwar volatile aber dennoch durchschnittlich zweistellige jährliche Wachstumsraten. Auch wenn diese abfallen können, bleibt der Vorstand zuversichtlich, dass der Halbleitermarkt - wie schon in der Vergangenheit - langfristig höhere Wachstumsraten erreichen wird als viele andere Industriesparten wie Elektronik, Automobil und Chemie.

Infineon will vom Marktwachstum überproportional profitieren

Wegen der hervorragenden Kosten- und Wettbewerbsposition von Infineon bei Speicherchips und der weiteren Fokussierung der Nicht-Speicherbereiche auf wachstumsstarke Kommunikationssegmente strebt der Vorstand an, dass Infineon weiterhin überproportional von der Marktentwicklung profitiert. Dies wird durch einen weiter starken Ausbau der Fertigungskapazitäten an den bestehenden Standorten sowie durch zusätzliche Produktivitätsfortschritte wie die geplante Einführung der 300-Millimeter-Technologie im Geschäftsjahr 2002 unterstützt. Infolge des Hochlaufs der 300-Millimeter Speicherchip-Fertigung werden die in Dresden frei werdenden 200-Millimeter Produktionskapazitäten nach und nach ebenfalls auf Chips für Kommunikationssysteme umgestellt.

Günstigere steuerliche Bedingungen ab 2002

Die neuen Regelungen aus der jüngsten Unternehmens-Steuerreform der deutschen Bundesregierung gelten für Infineon überwiegend mit Beginn des Geschäftsjahres 2002 ab dem 1. Oktober 2001. Mit der Reform wird der Körperschaftsteuersatz auf 25 Prozent gesenkt und gilt einheitlich für ausgeschüttete und thesaurierte Gewinne. Ferner wird die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften im Inland unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr besteuert. Die Gegenfinanzierung der Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand wird im wesentlichen durch eine Absenkung der Abschreibungssätze erfolgen.

Insgesamt erwartet Infineon aufgrund dieser Änderungen in Deutschland eine leichte Senkung der Steuerquote im Geschäftsjahr 2002.

Entwicklung bei Kommunikationssysteme

Der Chipmarkt für Kommunikationssysteme wird weiter vorangetrieben durch den Auf- und Ausbau von hochmodernen Breitband- und optischen Infrastrukturen, die das Surfen und den elektronischen Handel im Internet beschleunigen. Die ständig wachsende Nachfrage nach mobilen Kommunikationsgeräten mit mehreren integrierten Funktionen ist Wegbereiter für neue Technologien wie UMTS und Bluetooth. Diese erfordern zunehmend in den Chipsystemen integrierte Softwarelösungen sowie leistungsfähigere Power Management-Anwendungen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Konzern

Um im Geschäftsjahr 2001 weiterhin eine hohe Umsatzrendite erzielen zu können, will Infineon im Speicherchip-Geschäft durch weitere produktivitätssteigernde Maßnahmen seine führende Kostenposition ausbauen. Im Geschäftsjahr 2002 wird dann das frühe Hochfahren der 300-Millimeter-Produktion entscheidend sein für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit im DRAM-Markt.

Insbesondere beabsichtigt der Vorstand, die Abhängigkeit der Konzernergebnisse vom Geschäftsbereich Speicherprodukte zu reduzieren. Neben den bereits hohen Umsatz- und Ebit-Zahlen des Geschäftsbereiches Mobile Kommunikation sollen dazu im neuen Geschäftsjahr überdurchschnittliche Wachstumsraten beim Umsatz und höhere Ebit-Margen der Geschäftsbereiche Drahtgebundene Kommunikation, Sicherheits- und Chipkarten-ICs sowie Automobil- und Industrieelektronik beitragen. Parallel dazu sollen die Marktanteile in einzelnen Kern-Zielmärkten ausgebaut werden.

Weiterhin will der Vorstand das Konzernergebnis im neuen Geschäftsjahr durch eine in absoluten Zahlen erhöhte aber im Verhältnis zum Umsatz prozentual niedrigere Investitionsquote für Forschung und Entwicklung positiv beeinflussen. Dafür sollen insbesondere mit Hilfe weiterer Benchmarking-Prozesse die Durchlaufzeiten und Kosten der Entwicklungsprojekte weiter verringert werden. Die Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten sollen auch in den Folgejahren auf dem bereits wettbewerbsfähigen Niveau gehalten werden.

Derzeit wird zur noch effizienteren Steuerung des gesamten Konzerns die bisher als Pilotprojekt im Bereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs erfolgreich eingeführte 'Balanced Scorecard' unternehmensweit eingeführt werden.

Der Vorstand erwartet im Geschäftsjahr 2001 für den Konzern einen deutlichen Umsatzzuwachs, der über der Wachstumsrate des Gesamtmarktes liegen soll. Die Entwicklung der Bruttomarge vom Umsatz wird stark abhängig sein von der Entwicklung des Speicherchip-Marktes und soll möglichst auf dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2000 gehalten werden.

Wir denken natürlich mit. Aber in erster Linie zählt die Meinung unserer Kunden

Sind unsere Kunden mit uns zufrieden? Wir wollen das ganz genau wissen. Deshalb bitten wir jedes Jahr einen Teil unserer Kunden und Vertriebspartner, unsere Leistungen im Vergleich zum Wettbewerb zu bewerten. Auf der Grundlage ihrer Antworten sowie auf Basis anderer Erkenntnisse arbeiten wir ständig daran, die Abläufe und Unternehmensstrukturen weiter zu verbessern.

Dabei nehmen wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Geschäftspartner sehr ernst, um auch unsere Produkte und Dienstleistungen immer weiter zu verbessern. Und das funktioniert ganz gut, so das Feedback der Kunden.

Bei der Umfrage im Jahr 2000 zur Kundenzufriedenheit erreichten wir insgesamt 70,9 von möglichen 100 Punkten - 3,5 Punkte mehr als im Vorjahr. Damit liegen wir weiterhin über dem Wettbewerbsdurchschnitt von 70,1. Das Gesamturteil setzt sich aus mehreren Einzelbewertungen zusammen. Beispielsweise erhielten wir 65,6 Punkte für unsere Preispolitik - der Wettbewerb lag bei 67,5 - sowie 72,9 Punkte für unser Technologie- und Produktportfolio, und damit einen Punkt mehr als der Wettbewerb. In der Kategorie Produktqualität gaben uns unsere Kunden 80,3 Punkte - 2,7 Punkte mehr als dem Durchschnitt.

Über dieses Ergebnis freuen wir uns ganz besonders. Denn es bestätigt uns in unserem Bestreben, immer nur die besten Produkte zu liefern. Im Bereich Logistik mussten wir allerdings den um 72 Prozent gestiegenen Umsatz bewältigen – das erklärt die niedrigere Punktzahl im Wettbewerbsvergleich. Doch wir verpflichten uns gerne, im kommenden Jahr auch hier wieder besser abzuschneiden.

UNSERE HAUPTKUNDEN* KOMMEN AUS DEN BEREICHEN

KOMMUNIKATION

Alcatel, Cisco, Ericsson, Giesecke & Devrient, Gemplus, Lucent, Matsushita, Motorola, Nokia, Nortel, Oberthur Card Systems, Sagem, Samsung, Schlumberger, Siemens, Sony, V-Tech

COMPUTER UND SERVER

Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, IBM, Seagate, Sun

AUTOMOBILZULIEFERER

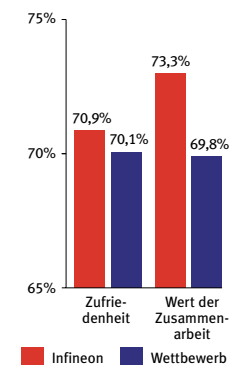
Bosch, Delphi, Denso, Siemens, TRW, Visteon, VDO

* Teilweise beliefert über OEM-Ausrüster

Wollen Sie mehr darüber erfahren, was unsere Kunden denken? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an:

customer.satisfaction@infineon.com

DAS GESAMTERGEBNIS UNSERER KUNDENUMFRAGE IM JAHR 2000:



DIREKTVERTRIEB AUF 300 KUNDEN FOKUSSIERT

Im Zuge der Ausgliederung aus der Siemens AG hat Infineon seinen Vertrieb reorganisiert. Der Direktvertrieb fokussiert sich auf rund 300 Kunden. Um die hohe Zahl weiterer Kunden ebenfalls individuell und effektiv zu bedienen, wickelt Infineon das Geschäft mit diesen Kunden über ein weltweites Netzwerk von Distributionspartnern ab. Derzeit wird außerdem eine elektronische Kundenbeziehungs-Plattform im Internet aufgebaut.

Im Rahmen des Aufbaus einer weltweiten Vertriebsorganisation übernahm Infineon eine große Zahl von Mitarbeitern von den Siemens-Landesgesellschaften. Damit verfügt Infineon jetzt in allen bedeutenden Märkten über eigene Vertriebsorganisationen, die bereits im Berichtsjahr 89 Prozent der Umsätze erzielten (Vorjahr: 79 Prozent). Insgesamt beschäftigte der Konzern am Ende des Geschäftsjahres rund 2000 Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing.

UMSATZ UM 72 PROZENT GESTEIGERT

Im Berichtsjahr konnte Infineon den Umsatz um rund 72 Prozent auf 7.283 Mio. Euro steigern (Vorjahr: 4.237 Mio. Euro). Auf Grund des schwachen Euro konnte Infineon positive Wechselkurseffekte realisieren. Ohne diese Effekte beläuft sich das Umsatzwachstum von Infineon auf 60 Prozent. Bereits nach Abschluss der ersten drei Quartale hatte Infineon den Umsatz des Vorjahres um 666 Mio. Euro übertroffen. Im letzten Quartal des Berichtsjahres wurde mit einem Quartalsumsatz von 2.380 Mio. Euro ein neuer Rekord erzielt.

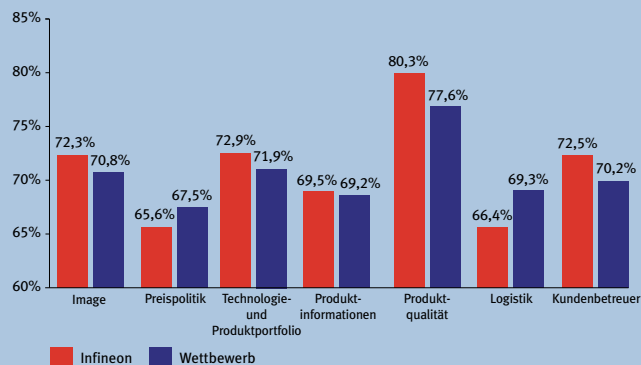
Insgesamt trugen alle Geschäftsbereiche zum starken Wachstum bei. Der Bereich Speicherprodukte dominierte mit einem Plus von 147 Prozent; hauptsächlicher Wachstumstreiber waren dabei die durch signifikante Produktivitätssteigerungen erhöhten Kapazitäten sowie die hervorragende Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise am Markt für Speicherchips.

Der Konzern hat seine Position als einer der zehn größten Halbleiterhersteller der Welt gefestigt. Vor allem in zwei Regionen wurden die Umsätze deutlich gesteigert: im Raum Asien/Pazifik um 134 Prozent auf 2.100 Mio. Euro (Vorjahr: 899 Mio. Euro) sowie in den USA um 119 Prozent auf 1.814 Mio. Euro (Vorjahr: 827 Mio. Euro).

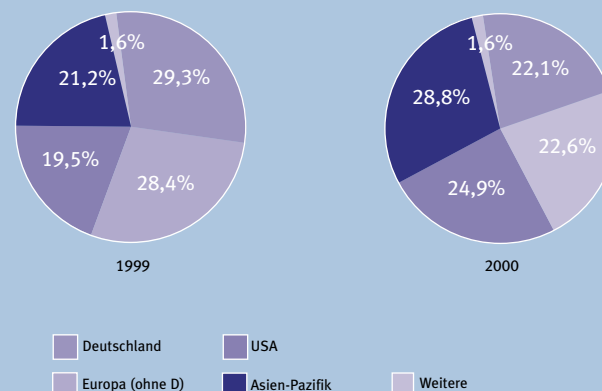
AUFTRAGSREICHWEITE ERREICHT REKORDNIVEAU

Die Halbleiterindustrie ist - im Gegensatz zum Anlagenbau - speziell im Massenmarkt geprägt von geringen Auftragsreichweiten, die sich derzeit insbesondere aufgrund der über dem Angebot liegenden Nachfrage erhöhen. Vor diesem Hintergrund zeigten im Geschäftsjahr 2000 nahezu alle Bereiche von Infineon bei Auftragseingang und Auftragsbestand einen deutlichen Anstieg. Ende September 2000 wurde eine Auftragsreichweite von durchschnittlich 3,6 Monaten ermittelt (Vorjahr: 2,9 Monate) und von 5 bis 6 Monaten bei einigen Kommunikationssegmenten.

WAS UNSERE KUNDEN VON UNS DENKEN WIE HOCH IST DIE DURCHSCHNITTLICHE ZUFRIEDENHEIT DER BEFRAGTEN IN DEN EINZELBEREICHEN?



UMSÄTZE NACH REGIONEN



Je weiter wir denken, desto schneller sind wir am Markt

Meistens legt unsere Forschung und Entwicklung (F+E) von Anfang an das Chipdesign und die dazugehörigen Fertigungsverfahren richtig fest. Das führt dazu, dass wir oftmals vor dem Wettbewerb neue Halbleiter-Lösungen auf den Markt bringen.



Unsere Schnelligkeit ist das Ergebnis hoher Investitionen in Mitarbeiter-Know-how und Anlagen, aber auch eines intensiven Benchmarking - dem Vergleich mit den Besten der Branche. Ein Beispiel dafür ist der Multi-Kanal ADSL-Chip namens AliDD – einer der komplexesten ICs, die Infineon je entwickelt hat.

Seine Komplexität ergibt sich aus den extrem hohen Anforderungen, die notwendig sind, um mit Hilfe der ADSL-Technologien die Datenübertragung über Kupferkabel um das 10- bis 100-fache gegenüber heutigen ISDN-Verbindungen zu beschleunigen. Und dieser Chip wurde in der Rekordzeit von nur fünf Monaten entwickelt!

Schnelligkeit war hier ein Muss. Denn der Markt für ADSL-Technologien breitet sich weltweit sprunghaft aus. ADSL-Leitungen bilden die sogenannte 'letzte Meile', also die direkte Verbindung zwischen den Anschlusssteckdosen für PCs und Telefone in Haushalten und Büros und den weltweiten Hauptleitungen für Internet und andere globale Kommunikationsnetzwerke.

Die Teammitglieder, die den AliDD entwickelt haben, sitzen in unseren F+E-Zentren in Singapur und in den USA. In dieser Zeit arbeitete das Team eng zusammen mit der Abteilung für Produktspezifikation in München sowie natürlich auch mit Kunden von Infineon überall auf der Welt.

Ein weiterer eindrucksvoller Beweis für die Gültigkeit unserer Philosophie 'Never stop thinking'.

EIN F+E- PROZESS

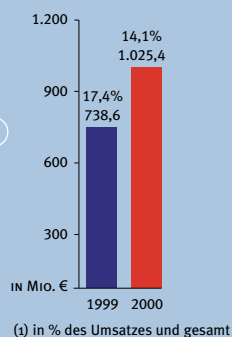
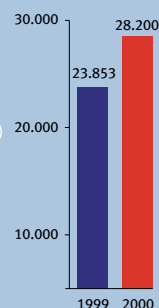
DIE SELBST GESTECKTEN ZIELE

Im März 1998 hatten wir uns verpflichtet, die Anzahl unserer Mitarbeiter in den reinen Entwicklungszentren innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln.

Anzahl der Mitarbeiter damals: 560, 80 Prozent davon Entwicklungsingenieure.

DIE ZAHLEN HEUTE

Bis März 2000 stieg die Zahl der Mitarbeiter in unseren Entwicklungszentren von 560 auf 1170. Inzwischen sind allein dort mehr als 1300 Mitarbeiter beschäftigt.

AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG ⁽¹⁾**ANZAHL DER PATENTE UND PATENTAPPLIKATIONEN****FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG WELTWEIT INTENSIVIERT**

Das Innovationstempo der Halbleiterbranche ist außerordentlich hoch. Durch seine verstärkte strategische Forschung sowie gezielte operative Entwicklungsaktivitäten in Zusammenarbeit mit Kunden, setzt Infineon Maßstäbe und bestimmt den Fortschritt der Elektronikindustrie entscheidend mit. Dabei werden insbesondere strategische Projekte kooperativ mit anderen Chipherstellern sowie mit Partnern aus anderen Technologiebereichen durchgeführt. Wesentliche Vorteile derartiger Partnerschaften sind das Teilen von Entwicklungskosten, das geringere Risiko von Fehlentwicklungen sowie die schnellere Verfügbarkeit neuer Technologien am Markt.

Von den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von 1.025 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2000 floss der größte Anteil in die Entwicklung profitabler Produkte. Daneben entwickelte Infineon seine Produktionstechnologien für Halbleiter und sein Portfolio an universell einsetzbaren Prozessormodulen weiter. Außerdem wurde die Montagetechnologie optimiert und der Automatisierungsgrad der Entwicklungsumgebung erhöht, die den Chip-Entwurfsprozess effizienter macht.

Sechs neue Entwicklungszentren aufgebaut

Infineon erweitert immer wieder sein internationales Netzwerk von aktuell 27 Entwicklungszentren an Standorten, an denen hervorragende Ingenieurteams mit Spezialkenntnissen verfügbar sind und für das Unternehmen gewonnen werden können. Im Berichtsjahr kamen sechs Standorte neu hinzu: Aalborg in Dänemark, Durham in den USA, Linz in Österreich, Nashua in den USA, Nürnberg in Deutschland und Tel Aviv in Israel. Ein weiteres wurde im November 2000 bei Grenoble in Frankreich eröffnet. Am 30. September 2000 arbeiteten im Konsolidierungskreis weltweit über 4.700 Spezialisten in der Forschung und Entwicklung.

Bestand an Patenten und sonstigen Schutzrechten wächst weiter

Im Zuge der Gründung erhielt Infineon von Siemens eine hohe Zahl von Schutzrechten und dabei insbesondere mehr als 25.000 Patente. Im Laufe des Berichtsjahres ist der Bestand an Schutzrechten stark angestiegen: Infineon verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2000 über mehr als 28.200 Patente und Patentanmeldungen in fast 100 Ländern. Sie bilden zusammen 5.250 Patentfamilien (Vorjahr: 4.210). Darüber hinaus haben Infineon und Siemens einen begrenzten gegenseitigen Zugriff auf ihr geistiges Eigentum vereinbart.

Weltmarktführerschaft bei System-on-Chip ausgebaut

Die Entwicklungsteams von Infineon konzentrierten sich im Berichtsjahr einerseits auf komplexe System-on-Chip-Lösungen und damit auf Produkte, die für weniger volatile Wachstumsmärkte wie Mobilfunk, Breitbandkommunikation, Sicherheits- und Automobiltechnik bestimmt sind. Andererseits wurde die high-end Produktpalette für den Speicherchip-Markt mit Produkten für anspruchsvolle PCs und Notebooks sowie für Internet-Server ausgebaut.

WIE HABEN WIR DAS GESCHAFFT?

Innerhalb dieser 24 Monate haben wir 12 neue Entwicklungszentren eingerichtet. Jedes dieser Zentren ist auf das eigene Feld spezialisiert. Dies gibt uns eine einmalig breite und erfolgreiche Basis für technologische Entwicklungen im Halbleiterbereich - und die zeigt sich in der Fülle revolutionärer Produkte, die aus den Zentren hervorgehen.

Wer surft nicht lieber extrem schnell im Internet?

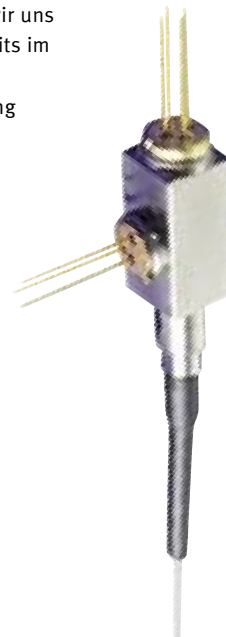
Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation hat im Juni 2000 das Projekt APON gestartet. APON, das 'ATM-fähige Passive Optical Network', ist die dritte Generation passiver Glasfaser-Netzwerke. Das Infineon-Projekt ist also Ausdruck unserer Konvergenzstrategie: denn APON ermöglicht das Übertragen von Sprache, Daten, Videofilmen und Fernsehprogrammen an Haushalte und innerhalb von Unternehmen gleichzeitig über ein einziges Netzwerk - und dass annähernd mit Lichtgeschwindigkeit.

Ein APON-Netz verbindet ein zentrales Büro über eine einzige Glasfaser mit einem Kunden. Die eingesetzte Technologie macht dabei zusätzliche Netzwerkausrüstung in diesem zentralen Büro überflüssig; und dieser Vorteil führt bei den Endkunden zu geringeren Ausgaben für Netzwerke und niedrigeren Betriebskosten.

Das Marktpotential für APON ist immens. So wächst derzeit allein in Nordamerika die Anzahl der Haushalte mit Glasfaseranschluss jährlich um zwei Millionen. Und da dort in den nächsten Jahren das Kupferkabelnetz in weiten Teilen ersetzt werden soll, wird erwartet, dass sich das Wachstum nochmals explosionsartig beschleunigt. Andere hoch lukrative Märkte sind die Länder China und Japan: dort spielen Glasfasernetze bereits heute eine wichtige Rolle.

Bereits zur aktuellen APON-Lösung von Infineon gehören Chips mit Fähigkeiten, die von anderen Herstellern noch nicht angeboten werden. Dazu kommen unsere hochentwickelten Glasfaserkomponenten und der leistungsstarke Home-Gateway-Prozessor für den hausinternen Netzzugang. Insgesamt können wir also bereits jetzt die erste durchgängige APON-Lösung anbieten. Damit steht Infineon an der Spitze der Anbieter im boomenden Markt für die Internet-Infrastruktur.

Auf diesen Lorbeeren werden wir uns sicherlich nicht ausruhen: Bereits im Sommer 2001 wollen wir eine umfassende Dreifach-Chiplösung auf den APON-Markt bringen.



BERICHT DES GESCHÄFTSBEREICHS DRAHTGEBUNDENE KOMMUNIKATION FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000

Bereich neu ausgerichtet

Die begonnene Restrukturierung des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation führte bereits im Berichtsjahr zu deutlichen Erfolgen. Mit neuen Produkten für die boomenden Märkte der Internet-Infrastruktur sowie verstärkten Beziehungen zu Schlüsselkunden baute der Bereich seinen Umsatz um 31 Prozent auf 940 Mio. Euro aus (Vorjahr: 720 Mio. Euro). Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten die Komponenten für Glasfaser- und lokale Ethernet-Netzwerke im Gigabit-Bereich.

Das Ebit stieg überproportional zum Umsatz um 90 Prozent auf 78 Mio. Euro (Vorjahr: 41 Mio. Euro). Die weitere Fokussierung auf die Wachstumsmärkte für drahtgebundene - lokale, Weitverkehrs-, Zugangs- und optische - Netzwerktechnologien (LAN, WAN, ACCESS und Optical Networks) trug dazu bei, dass die Sonderbelastung von 60 Mio. Euro aus dem Erwerb von Savan mehr als kompensiert wurde. Vor Berücksichtigung dieser Sonderbelastung errechnet sich ein Ergebnis von 138 Mio. Euro und damit ein deutlich überproportionaler Anstieg des Ebit um 237 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend stieg die Ebit-Marge des Geschäftsbereichs auf 15 Prozent nach 6 Prozent im Vorjahr.

Forschung und Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2000 konzentrierte sich der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation verstärkt auf Anwendungen für den schnell wachsenden Markt für Internet-Infrastruktur:

Mit der Akquisition der israelischen Firma Savan Communications wurde Infineon Marktführer in der VDSL-Technologie. Die VDSL-Zweichip-Lösung, die beide Unternehmen zusammen entwickelt hatten, ermöglicht Datenraten von bis zu 26 Megabit pro Sekunde über ein einziges Kupferkabel für Breitband-Dienste wie zum Beispiel interaktives Fernsehen, Video-Spiele und hochauflösende Video-Konferenzen.

Als Reaktion auf den explosionsartig steigenden Bedarf an höheren Bandbreiten stellte Infineon im Juni 2000 den kompakten Chipsatz '10BaseS' vor. Er unterstützt den Ethernet-Datentransfer über Entfernungen von mehr als 1,2 Kilometern mit hundertfacher ISDN-Geschwindigkeit. Der Chipsatz kann beispielsweise in Hotels, Universitäten sowie Geschäfts- und Industriegebäuden eingesetzt werden, die schnell und günstig zuverlässigere Kommunikationsnetzwerke über bestehende PBX- oder Telefonleitungen aufbauen wollen.

Ebenfalls für die Breitband-Kommunikation über Kupferkabel wurde im Berichtsjahr der Einkanal-SHDSL-Transceiver Sokrates entwickelt. Mit dieser Einchip-Lösung können Service-Provider auf existierenden Kupferdrähten nahezu das Leistungsniveau einer Standleitung anbieten. Sokrates unterstützt Bitraten von 160 bis 2360 Kilobit pro Sekunde und ist kompatibel zum konventionellen Telefondienst sowie zu ISDN- und xDSL-Diensten.

Für optische Netzwerke hat Infineon im Berichtsjahr die Produktfamilie PAROLI (Parallel Optical Link) eingeführt, eine Technologie für parallele optische Hochgeschwindigkeits-Verbindungen via Breitband-Datenübertragung.

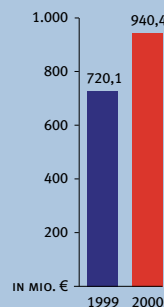
Die Produktfamilie umfasst eine Reihe von AC- und DC- Send- und Empfangsmodulen für die parallele Datenübertragung über Lichtwellenleiter. Im August 2000 wurde die PAROLI-Technologie an die Firma Molex, Inc. lizenziert, um im Markt für Glasfaserkabel noch schneller wachsen zu können.

Ausblick

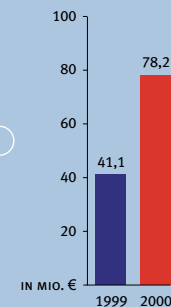
Mit dem Abschluss der Restrukturierung des Geschäftsbereiches Drahtgebundene Kommunikation will Infineon im neuen Geschäftsjahr die Rentabilität des Bereiches weiter verbessern. Nach der Eingliederung von Ardent wird die Akquisitions- und Investitionsstrategie fortgeführt, um den Bereich noch stärker in den Wachstumsmärkten LAN, WAN und ACCESS und Optical Networks zu positionieren.

Um die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des Geschäftsfeldes Fiber Optics zu erhöhen, wird das Management Logistikprozesse umorganisieren sowie neu installierte Produktionstechnologien hochfahren und weiter optimieren. Bei der Entwicklung neuer xDSL-Chipsets strebt Infineon an, Marktführer der nächsten ACCESS-Generation zu werden.

**DRAHTLOSE KOMMUNIKATION
UMSATZ**



**DRAHTLOSE KOMMUNIKATION
EBIT**



Vergessen Sie 'E': 'M' ist die neue Devise

M-Business, M-Commerce, M-Life: Die M-Revolution ist da. Wir haben sie vielleicht nicht gerade in Gang gesetzt, aber immerhin hat unser Geschäftsbereich Mobile Kommunikation vor kurzem das 100-millionste GSM-Basisband-Chipset hergestellt. Damit ist Infineon einer der weltweit größten Hersteller von Chips für Mobiltelefone der zweiten Generation.

Infineon begleitet natürlich auch die nächsten Schritte der M-Kommunikation. Und dabei geht es zunächst um Chip-Lösungen für GPRS und EDGE. Diese Technologien sollen für einen reibungslosen Übergang sorgen von den gegenwärtigen GSM-Systemen der zweiten Mobilfunk-Generation hin zur dritten Generation, besser bekannt als UMTS.

Ende letzten Jahres waren wir der erste Halbleiterhersteller der Welt, der eine vollständige Lösung für GPRS-Systeme mit echten Mehrfach-Steckplätzen anbieten konnte. Damit sind gegenüber den heutigen GSM-Netzen Datenübertragungen mit bis zu achtfacher Geschwindigkeit möglich.

Im Oktober 2000 gingen wir noch einen Schritt weiter. Wir stellten der Welt den ersten Chip vor, der sowohl in GSM- als auch in UMTS-Netzen funktionieren wird. Sein Name ist M-GOLD - der komplexeste Chip, den Infineon je entwickelt hat und dessen Eigenschaften jetzt intensiv getestet werden.

Aber damit noch nicht genug. Zusammen mit führenden Softwareherstellern entwickelt Infineon zur Zeit Halbleiterlösungen, die als Plattform für Multimedia-Betriebssysteme dienen werden.

Die Betriebssysteme werden aus einem einfachen Handy ein M-Gerät mit allen Schikanen machen. Das erste dieser neuen Chipsets wird in der zweiten Jahreshälfte 2001 vorgestellt: und dann wird es für M-dies-und-das kein Halten mehr geben.



BERICHT DES GESCHÄFTSBEREICHS MOBILE KOMMUNIKATION FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000

Systemlösungs-Kompetenz aufgebaut

Bei führenden Herstellern von Mobiltelefonen und mobiler Kommunikationsinfrastruktur baute Infineon seinen Lieferanteil im Berichtsjahr weiter aus. Damit verzeichnete der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation eine Umsatzsteigerung um 41 Prozent auf 1.221 Mio. Euro (Vorjahr: 865 Mio. Euro).

Trotz der enormen Aufwendungen für Zukunftstechnologien wie UMTS und Bluetooth sowie des Fertigungsanlaufs neuer Produkte stieg im Geschäftsjahr 2000 das Ebit um 43 Prozent auf 261 Mio. Euro (Vorjahr: 182 Mio. Euro). Damit konnte wiederum eine Ebit-Marge von über 21 Prozent erreicht werden.

Durch die Übernahme der GSM-Software-Aktivitäten von debis in die neue Gesellschaft Comneon und die Gründung des skandinavischen Unternehmens Danish Wireless Design (DWD) hat der Bereich sein Ziel, umfassendes System- und Implementierungs-Know-how aufzubauen, innerhalb eines Geschäftsjahres erreicht. Damit können von Infineon komplette Systemlösungen inklusive Hardwaredesign, Chipsets und Software angeboten werden.

Forschung und Entwicklung

Seine führende Rolle als Lieferant für die mobile Kommunikationswelt bestätigte Infineon im Berichtsjahr mit der Markteinführung mehrerer Produkte:

Als weltweit erster Hersteller brachte Infineon zwei Einchip-GSM-Lösungen für GPRS-Dienste auf den Markt, einen Basisband-Logikchip (E-GOLD+) und einen Hochfrequenz-Transceiver (SMARTi+). Die beiden Produkte wurden für den Einsatz in leistungsfähigen - kleineren, leichteren und kostengünstigeren - Internet-Mobiltelefonen entwickelt. Zusammen ermöglichen sie Datenraten von bis zu 107 Kilobit in der Sekunde, was etwa dem zehnfachen Datendurchsatz bisheriger Lösungen entspricht.

Mit dem M-GOLD-Chip stellte die Gesellschaft den weltweit ersten Basisband-Einzel-Chip für Dualmode-UMTS/GSM-Mobiltelefone vor. Er ermöglicht Herstellern und Nutzern, die gleichen Endgeräte sowohl in den aktuellen GSM-/GPRS-Netzen als auch in den späteren UMTS-Netzen einzusetzen. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Türöffner bei potenziellen Kunden, die jetzt neue UMTS-Mobiltelefone für die Zeit ab dem Jahr 2002 entwickeln. Eine komplette UMTS-Systemlösung inklusive Hochfrequenz-Chipset soll im neuen Geschäftsjahr vorgestellt werden. Der Hochfrequenz-Teil soll bereits im Jahr 2001 im japanischen W-CDMA-Markt zum Einsatz kommen.

'BlueMoon I' ist der Name des ersten Chipsatzes von Infineon für den Bluetooth-Standard, der künftig Mobiltelefone, Computer, Drucker, Kopfhörer, Persönliche Digitale Assistenten, Set-Top-Boxen und andere elektronische Geräte schnurlos miteinander verbinden soll. Diese erste am Markt verfügbare Zweichip-Systemlösung - bestehend aus einem Basisband-Chip und einem Hochfrequenz-Transceiver - wird von Infineon auch mit der Software für komplette Bluetooth-Module geliefert.

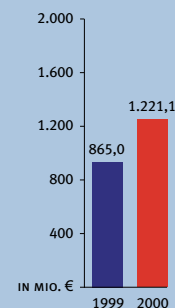
Damit baut Infineon seine technologische Spitzenstellung bei Chipssystemen für schnurlose Anwendungen im Haus- und Bürobereich weiter aus, die auf bisher mehr als 30 Millionen produzierten Transceivern für schnurlose DECT-Telefone und WDCT-Systeme beruht.

Ausblick

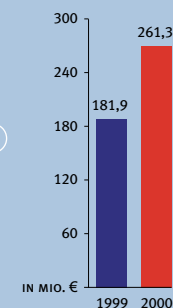
Mit dem vorhandenen kompletten Produktportfolio für mobile Kommunikationsgeräte will der Geschäftsbereich seinen Marktanteil weiter ausbauen, den Umsatz innerhalb von zwei Jahren stark erhöhen und damit seine führende Position langfristig festigen. Dafür wird die Eigenproduktion insbesondere auf Basis der Gallium-Arsenid- und Silizium-Germanium-Technologien ausgebaut. Zudem werden weitere Silicon Foundry-Kapazitäten genutzt.

Mit dem System-Know-how, das grundsätzlich allen Kunden angeboten wird, sollen vor allem in Asien expandierende OEM-Hersteller als neue Kunden gewonnen werden. Die OEM-Firmen produzieren zum Beispiel im Auftrag von Markenunternehmen Mobiltelefone für Marktsegmente mit niedrigem Preisniveau. Im neuen Geschäftsjahr werden vor allem die neu vorgestellten Chipsets für UMTS- und Bluetooth-Anwendungen weiterentwickelt. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Mobiltelefon-Herstellern in Europa und Japan will Infineon auch künftig als erster noch kompaktere und günstigere System-on-Chip-Lösungen anbieten.

MOBILE KOMMUNIKATION
UMSATZ



MOBILE KOMMUNIKATION
EBIT



Digitale Sicherheit – oder: Wie viel sicherer kann sicher sein?

Die erste Sicherheitslösung wurde von Julius Cäsar erfunden. Mit Hilfe ‘modernster’ Verschlüsselungstechniken stellte er seinerzeit sicher, dass bedeutende Nachrichten, die in seinem riesigen Reich verschickt wurden, nur von den gewünschten Adressaten richtig empfangen und verstanden werden konnten.

Auch zweitausend Jahre später ist die Verschlüsselung immer noch ein grundlegendes Instrument zur sicheren Kommunikation. Doch die Menge der zu übermittelnden vertraulichen Daten hat sich seit Cäsars Zeiten exponentiell vervielfacht. Ganz einfach aufgrund der wesentlich größeren Anzahl von Menschen, die heute elektronische Informationen verschicken oder empfangen.

Ebenso schnell ist die Zahl der Personen gestiegen, die sich unerlaubterweise Informationen verschaffen wollen.

Eine wichtige Methode dies zu verhindern und eine sichere Datenübermittlung zu garantieren, ist der Einsatz von Chipkarten. Damit kann der Nutzer dem Handy, Bankautomaten oder Türöffner seine Identität beweisen.

Bei den Chips in diesen Karten handelt es sich um höchst komplexe integrierte Schaltkreise wie sie zur gegenseitigen Identifizierung in Computern verwendet werden. Ein solches ‘vertrauenswürdige Händeschütteln’ bildet das Kernstück jeder sicheren Transaktion im E-Commerce und im M-Commerce.

Diese Chips findet man gekoppelt mit einer kontaktlosen Schnittstelle auch immer öfter in Maschinen, Autos und Stereoanlagen, die unterwegs sind. Damit kann man während Transport- oder Produktionsabläufen jederzeit überwachen, wo sich die Güter befinden.

Zusammen mit einer hohen Speicherkapazität und einer Reihe von Datenverarbeitungsfunktionen bilden die winzigen Chips die wohl sicherste Waffe, über die wir in der Welt des Internet verfügen: die Smart Cards.

Infineon kombiniert nun die Erfahrung in der Entwicklung von integrierten Schaltkreisen und den dazugehörigen Systemen mit neuen Anforderungen unserer Kunden. Daraus entstand eine sachkundige und bedarfsgerechte Beratungs-Dienstleistung in Sachen Sicherheit.

‘SMART CARDS’ WERDEN IMMER ...

... INTELLIGENTER

Infineon hat einige Technologien geschaffen, mit denen sich mehrere Funktionen - Anzeigen, FingerTIP-Sensoren und andere – auf einem einzigen Chipkarten-Controller zusammenbringen lassen.

... SICHERER

Bei vielen dieser Technologien werden Lagen aus extrem dünnen und extrem flexiblen Chips übereinander aufgebracht. Jede dieser Lagen bildet ein undurchdringliches Dickicht von Knotenpunkten, und begrenzt den Zugang zu diesen Daten.

... ALLTÄGLICHER

Ein neuer 32-Bit-Smartcontroller von Infineon, der 2001 auf den Markt kommen soll, wird in einer bislang unerreichten Form mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig erfüllen. Erst damit werden Mobiltelefone zu vollendeten Mobilterminals, einsetzbar für M-Commerce, M-Entertainment und natürlich M-Kommunikation. Und dann? Wir arbeiten an einem 64-Bit-Controller!



BERICHT DES GESCHÄFTSBEREICHS SICHERHEITS- UND CHIPKARTEN-ICs UND SONSTIGE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000

Weltmarktführerschaft behauptet

Die ungebremst hohe Nachfrage nach SIM-Karten für GSM-Mobiltelefone sowie der Lieferanteil von rund 70 Prozent aller Chips für EC-Geldkarten in Deutschland führten im Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs und Sonstige zu einem Umsatzanstieg von 33 Prozent auf 668 Mio. Euro (Vorjahr: 502 Mio. Euro). Davon entfielen 294 Mio. Euro auf das von Osram und Infineon gemeinsam geführte Unternehmen OSRAM Opto Semiconductors (Vorjahr: 226 Mio. Euro).

Bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs erreichte der Bereich ein Umsatzwachstum um 36 Prozent auf 375 Mio. Euro (Vorjahr: 276 Mio. Euro). Davon wurden rund 70 Prozent mit Schlüsselkunden erzielt. Auch deshalb konnte Infineon im Kalenderjahr 1999 seinen Marktanteil bei Smart Cards auf 43 Prozent erhöhen und die Marktführerschaft erfolgreich ausbauen (Quellen: *Gartner Dataquest, ZKA, Philips, Infineon*). Das absolut höchste Umsatzwachstum erreichte das Geschäftsfeld Chipkarten-Controller. Mit den Produkten MultiMediaCard sowie FingerTIP wurden erstmals Umsätze im Millionen-Euro-Bereich erzielt. Mit dem reinen Smart Card-Geschäft erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 ein Ebit von 49 Mio. Euro (Vorjahr: 24 Mio. Euro) und erhöhte damit die Ebit-Marge im Jahresvergleich von 9 Prozent auf 13 Prozent.

Der gesamte Geschäftsbereich - inklusive Opto - steigerte das Ebit um 54 Prozent auf 54 Mio. Euro (Vorjahr: 35 Mio. Euro). Trotz der infolge des höheren Anteils an Fremdfertigung in Silicon Foundries gestiegenen Produktionskosten sowie einmaliger Hochlaufkosten für neue Produkte, konnte der Bereich seine Ebit-Marge im Verhältnis zum Umsatz auf 8 Prozent leicht erhöhen (Vorjahr: 7 Prozent).

Forschung und Entwicklung

Der Geschäftsbereich hat im Berichtsjahr sein internationales Entwicklungsnetzwerk mit Softwareprojekten in Indien sowie Design-Projekten in Österreich weiter ausgebaut.

Insbesondere in punkto Sicherheit von Chipkarten-Controllern hat Infineon als Weltmarktführer für Chipkarten-Chips auch seine Technologieführerschaft verteidigt: Bereits zum dritten Mal hat ein Chip von Infineon die derzeit weltweit strengste Sicherheitsevaluierung für Bauelemente in Chipkarten erfolgreich bestanden.

Eine derartige Zertifizierung ist zum Beispiel nach dem deutschen Gesetz über die digitale Signatur (SigG) gefordert. Nach den vorliegenden Informationen hat bisher kein Wettbewerber seine Produkte auf einem vergleichbar hohen Niveau prüfen lassen.

Die 16-Bit-Chipkarten-Controller der 66Plus-Familie werden nun in der für Chipkarten-ICs modernsten 0,25-Mikrometer-Prozesstechnologie gefertigt. Dieser Technologievorsprung ermöglichte es Infineon, den ersten am Markt verfügbaren Chipkarten-Sicherheitscontroller mit einer Speichergröße von 64 Kilobyte EEPROM herzustellen. Aufgrund des größeren Speicherplatzes können bei modernsten Kartenanwendungen in GSM-Handys sowie im Banksektor von den Serviceanbietern neue Applikationen wie zum Beispiel WAP oder Zahlvorgänge über das Mobiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

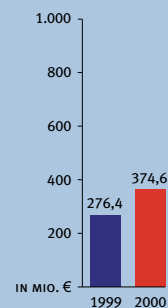
Ausblick

Der Geschäftsbereich Sicherheits- und Chipkarten-ICs (ohne OSRAM Opto Semiconductors) startete gemäß *Gartner Dataquest* als Marktführer bei Chipkarten-ICs in das neue Geschäftsjahr. Diese Position soll mittels weiter verkleinerter Chipstrukturen sowie der Umstellung auf noch leistungsfähigere Produkte verteidigt werden. Im Geschäftsjahr 2001 strebt Infineon an, dass auch im Segment Sicherheits-ICs der technische Vorsprung in ein signifikantes Umsatzwachstum mündet. Insgesamt erwartet der Geschäftsbereich im Geschäftsjahr 2001 ein signifikantes Umsatzwachstum.

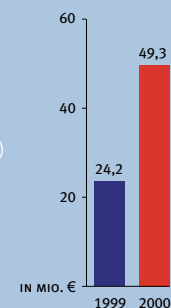
Dafür vergrößert Infineon das Produktportfolio um neue Verschlüsselungsbauelemente und weiterentwickelte biometrische Sensoren. Der Marktanteil der MultiMediaCard soll mit Hilfe strategischer Allianzen erhöht werden. Darüber hinaus will Infineon seine Sicherheitskompetenz und die hervorragenden Kundenbeziehungen nutzen, um ins Dienstleistungsgeschäft für Sicherheit im Bereich der Informationstechnologie einzusteigen.



SICHERHEITS- UND CHIPKARTEN-ICs
UMSATZ



SICHERHEITS- UND CHIPKARTEN-ICs
EBIT



Wir werden uns erinnern: Speicherchips sind ein lukratives Geschäft

Die Umsätze des Geschäftsbereichs Speicherprodukte sind in den letzten drei Jahren um 428 Prozent gestiegen. Und Infineon ist damit vom zwölften auf den vierten Rang unter den weltweit größten DRAM-Herstellern aufgestiegen. Noch rasanter gewachsen ist die Rentabilität des Bereichs: Das Ebit-Ergebnis – also der Gewinn vor Zinsen, Ergebnisanteilen Dritter und Steuern – kletterte 2000 auf 1,336 Milliarden Euro. Damit liegt der Bereich innerhalb von Infineon sowie im ganzen Siemens-Konzern an der Spitze und gewann einen Siemens- ‘top+ award 2000’ für den größten Beitrag zum Geschäftswert.

Durch das Steigern der Produktivität und das Einführen einer Vielzahl von marktbestimmenden Produkten, konnten wir in allen Produktgruppen spektakuläre Zuwächse erzielen. Das einzige, was in diesem Bereich gesunken ist, sind die Fertigungskosten, und zwar um satte 50 Prozent.

Zusammen mit Samsung stellten wir als erstes Unternehmen 256-Megabit-Chips her. Seither sind wir zum weltweit führenden Hersteller dieser Speicherchipart geworden, die in Internet- und anderen Servern eingesetzt werden. Und dieses Segment gehört zu den am schnellsten wachsenden des globalen Computermarktes.

Damit nicht genug. Vor allen anderen Firmen gelang es uns, zusammen mit Motorola DRAMs auf 300-Millimeter-Wafern herzustellen. Und im Jahr 2000 begannen wir mit der Massenfertigung des mit seinen 0,17-Mikrometer-Strukturen kompaktesten 128-Megabit-Chips der Welt. Anfang 2001 werden wird dann den ersten 128-Megabit-Chip für Grafikanwendungen auf Basis der Double Data Rate (DDR)-Architektur ausliefern.

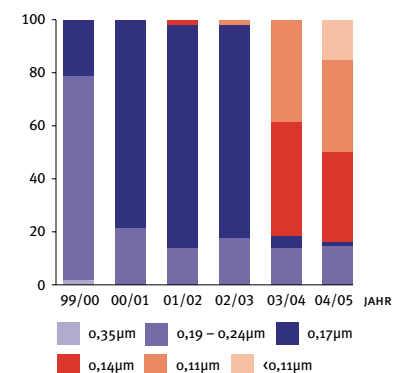
Ein Infineon-Produkt, das weltweit in vielen der leistungsstärksten 3D-Grafikkarten zu finden sein wird.

Infineon hat also eine starke Stellung sowohl im DRAM-Segment für den Massenmarkt als auch bei Grafikkchips. Das weiterhin rasante Bit-Wachstum der Speicherchip-Märkte wird nun jedoch besonders von sogenannten ‘embedded DRAMs’ stimuliert. Diese Chipart wird bei Netzwerk-Anwendungen, in digitaler Unterhaltungselektronik, raffinierten Telefonen und elektronischen Terminplanern (PDAs) eingesetzt. Diese ‘integrierten Speicher’ sind Ergebnis unserer Trenchzellen-Technologie, die das Aufbringen von DRAM-, Logik- und analogen Funktionen auf einem einzigen Chip erleichtert. Vorteile der gemeinsamen Silizium-Plattform sind ein niedrigerer Energieverbrauch plus zahlreiche neue Leistungsmöglichkeiten und zusätzlich nochmals geringere Fertigungskosten.

Erwähnt sei hier auch unser zukünftiger 512-Megabit-Chip, der ebenfalls alle Rekorde zu brechen verspricht.

Anfang 2000 hat der Geschäftsbereich die 0,17-Mikrometer-Prozesstechnologie qualifiziert. Ende September waren bereits alle Fertigungslinien von Infineon, auf denen 128- und 256-Megabit-Speicherchips produziert werden, auf die Technologie umgestellt.

TECHNOLOGIEPORTFOLIO 1999-2005
(SCHÄTZUNGEN VON INFINEON)



BERICHT DES GESCHÄFTSBEREICHS SPEICHERPRODUKTE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000

Herausragend bei Umsatz und Ergebnis

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte hat seinen Umsatz um 147 Prozent auf 3.473 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 1.406 Mio. Euro). Damit wuchs der Bereich doppelt so schnell als der gesamte DRAM-Markt. Hauptgründe dafür waren die durchschnittlich erzielten hohe Preise, signifikante Produktivitätssteigerungen unter Einsatz neuester Technologien sowie der Ausbau der Beziehungen zu den sieben größten Kunden, mit denen über 50 Prozent des Umsatzes erzielt werden. Dank der weiteren Optimierung der Herstellungsprozesse wurde die Technologie- und Kostenposition nochmals verbessert.

Zusammen mit den durchschnittlich gestiegenen Preisen für Speicherchips und Lizenzumsätzen in Höhe von 156 Mio. Euro führte die höhere Produktivität beim Ebit des Geschäftsbereiches zu einem Rekordwachstum um 1.574 Mio. Euro auf 1.336 Mio. Euro (Vorjahr: -238 Mio. Euro). Die Ebit-Marge dieses Geschäftsbereichs lag damit bei 38 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte hat im Berichtsjahr seine Technologieführerschaft bei der Entwicklung von DRAMs bestätigt. Dabei wurde in diesem Bereich das Intellectual Property mit einer stark erhöhten Anzahl von Patentanmeldungen erheblich ausgeweitet.

Anfang 2000 hat der Bereich seine 0,17-Mikrometer-Prozesstechnologie qualifiziert, die noch in 2000 an allen DRAM-Standorten zur Produktion modernster 128- und 256-Megabit-Speicherchips hochgefahren wurde. Der Infineon-Prozess gilt als fortschrittlichste Technologie weltweit und ermöglicht die Produktion kleinster und damit kostengünstigster Chipgrößen, die Wettbewerber erst mit ihren 0,15-Mikrometer-Technologien erreichen werden.

Bereits im April 2000 konnte Infineon als eines der ersten Unternehmen Muster seiner 256-Megabit-Double-Data-Rate (DDR)-Synchronous-DRAM (SDRAMs)-Chipserie ausliefern. Damit ist das Unternehmen bestens für den Schritt in Richtung DDR-Standard gerüstet, den die Industrie noch in 2000 vollzieht. Die DDR-Technologie bietet Preis-Leistungsvorteile bei Servern, Workstations und leistungsfähigen Desktop-PCs.

Um dauerhaft das hohe Tempo der Industrie beim Verkleinern der Chipstrukturen halten zu können, hat Infineon zusammen mit IBM eine zukunftsweisende Technologie entwickelt, die die bestehenden Grenzen des planaren Transistors in der Speicherzelle überwindet: die vertikale Transistorzelle.

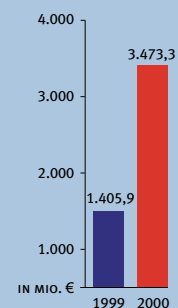
Ausblick

Infineon erwartet auch im neuen Geschäftsjahr eine in verkauften Megabit gerechnete starke Wachstumsrate des Speicherchip-Marktes von über 60 Prozent. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit der weltweiten PC-Märkte erwartet Infineon eine schwächere Nachfrage und daraus folgende niedrigere Preise für Speicherchips im ersten Quartal, das dem letzten Quartal des Kalenderjahres 2000 entspricht.

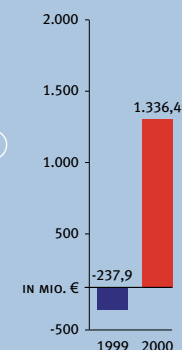
Insgesamt bleibt der Ausblick des Vorstands für den Geschäftsbereich positiv aufgrund der prognostizierten Markterholung, die spätestens in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres, die dem zweiten und dritten Quartal des Kalenderjahres 2001 entspricht, eintreten soll. Diese Prognose lässt weiterhin sehr zufriedenstellende Geschäftsergebnisse erwarten, die allerdings stark von der strukturell volatilen Preisentwicklung sowie vom Zeitpunkt neu hinzukommender Kapazitäten abhängig sind.

Bis Ende Dezember 2000 wird die Fertigung von DRAM-Standardprodukten komplett auf die kostengünstigere 0,17-Mikrometer-Technologie umgestellt sein, der schon 2001 teilweise die 0,14-Mikrometer-Technologie folgen wird, mit der die Produktivität der 200-Millimeter-Fabriken nochmals erhöht wird. Der Bedarf an Massenmarktprodukten für PCs und Notebooks wird 2001 im wesentlichen durch 128-Megabit Speicher gedeckt. Der Übergang in die weniger volatilen und schneller wachsenden Märkte für Server- und Netzwerkprodukte soll durch den erhöhten Produktionsausstoß von 256-Megabit-Speicherchips beschleunigt werden. Insgesamt streben wir bei DRAMs im Jahr 2001 weiterhin einen Marktanteil von gut 10 Prozent an. Nach Meinung des Vorstands ist damit ein wirtschaftliches Verhältnis zwischen den hohen Ertragschancen und dem Risiko der DRAM-typischen Marktschwankungen erreicht.

SPEICHERPRODUKTE
UMSATZ



SPEICHERPRODUKTE
EBIT



Infineon und die Automobilindustrie: Gemeinsam auf Tour

Chips in Autos? So was gab es früher nicht. Aber jetzt! Schon heute werden in den meisten Neuwagen rund 200 Halbleiterkomponenten eingesetzt. Vor wenigen Jahren waren es noch 90.

Nun können Sie raten, wer mit am meisten von diesem Anstieg profitiert hat. Richtig! Infineon. Denn wir sind der weltweit zweitgrößte Chiphersteller für die Automobilelektronik. Und allein im Geschäftsjahr 2000 hat der Geschäftsbereich sein Ebit-Ergebnis um 30 Prozent und seinen Umsatz um 32 Prozent hochgefahren.

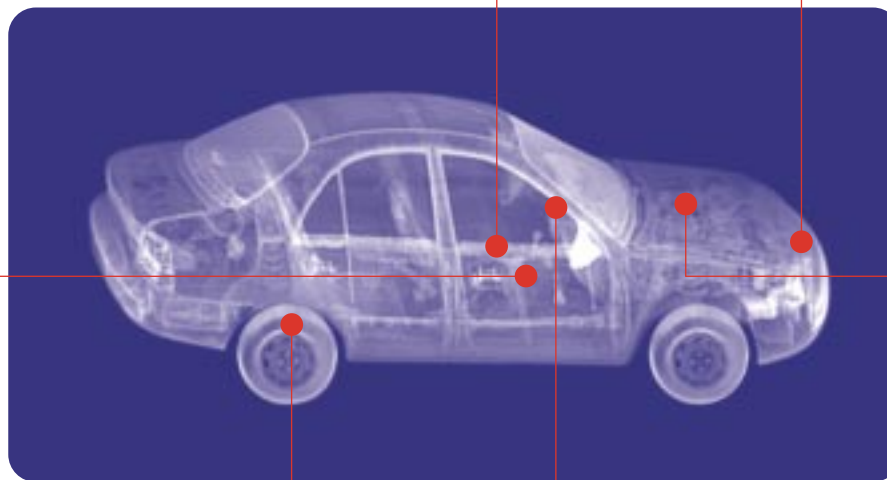
Mit einem breiten Spektrum neuer Produkte und noch engeren Beziehungen zu neu aufgebauten Schlüsselkunden in den USA und Asien soll der Umsatz des Bereichs im folgenden Geschäftsjahr nochmals deutlich gesteigert werden.

Wo sind denn nun diese Chips in Ihrem Auto?

Es geht schon los beim Türöffnen. Wer braucht da noch einen Schlüssel? Das kann ein Chip einfacher. Beim Fahren verringert das elektronische Gehirn des Motormanagements sowie der elektronischen Drosselung sowohl Benzinverbrauch als auch Schadstoffemissionen. Und wenn Sie aufs Gas treten wird ein Chip überwachen, wie gut die Straßenhaftung Ihres Wagens ist.

Sollte Ihr Wagen mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sein, so steuert sehr wahrscheinlich ein Chip die Antriebskraft, ein weiterer sorgt für ruckfreies Schalten - und alle beide ermöglichen das weitere Absenken des Benzinverbrauchs.

Sobald Sie kräftig auf die Bremse treten, reagiert das Antiblockiersystem. Und die von einem Chip gesteuerten ABS-Sensoren kontrollieren Millionen Mal in der Sekunde den Fahrbahnzustand und lösen entsprechend stabilisierende Reaktionen aus.



Ähnlich intelligent sind die radargesteuerten Sensoren in Telematiksystemen, die für den Sicherheitsabstand zu Ihrem Vordermann sorgen sollen. Chipgesteuerte Navigations- und Fahrer-Informationssysteme helfen Ihnen dabei, Staus zu meiden oder gestohlene Fahrzeuge ganz legal von der Polizei suchen zu lassen.

Ein weiterer Halbleiter-Einsatzort ist die Servolenkung. Hier werden hydraulische Systeme zunehmend durch elektrische ersetzt. Hätten Sie gedacht, dass sich allein dadurch der Benzinverbrauch um bis zu 0,4 Liter je 100 Kilometer senken lässt?

Wir drücken die Daumen, dass Sie weiterhin unfallfrei fahren. Doch wenn es passiert, dann wird ein Chipsystem kontrollieren, dass und wie weit die Airbags aufgeblasen werden - je nach Größe und Sitzposition der Insassen.

BERICHT DES GESCHÄFTSBEREICHS AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2000

Umsätze stark ausgeweitet

Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für Automobil- und Industrieanwendungen sowie neuer Aufträge bedeutender Kunden in den Regionen Asien/Pazifik und Japan steigerte der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik seinen Umsatz um 32 Prozent auf 880 Mio. Euro (Vorjahr: 665 Mio. Euro). Damit lag Infineon über dem Marktwachstum und will so die im Kalenderjahr 1999 im Segment Automobilindustrie (ohne Autoradios) erreichte Position als Nummer eins in Europa und Nummer zwei weltweit festigen. Das Ebit des Bereichs verdreifachte sich auf 69 Mio. Euro (Vorjahr: 23 Mio. Euro) und führte zu einer Ebit-Marge von 8 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent).

Mit einer erweiterten Kundenbasis, neuen Produkten und der Fokussierung auf Power Management ICs - Chips zum Steuern der Stromversorgung zum Beispiel bei Mobiltelefonen, Motherboards und IT-Infrastrukturen - wurde im Geschäftsfeld Power Management & Supply der Umsatz verdoppelt.

Die in der Industrieelektronik positionierte Tochtergesellschaft eupec hat im Berichtsjahr einige Großaufträge bei Anbietern für Energieübertragung und Antriebstechnik gewonnen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, wird der Standort Pretzfeld bis Anfang des Jahres 2002 geschlossen und die Fertigung bipolarer Hochleistungs-Bauelemente an den Standorten Warstein und Cegléd (Ungarn) konzentriert.

Forschung und Entwicklung

Mit den Produktlinien HITFET, PROFET und OptiMOS gelang es Infineon, die Technologieführerschaft bei Power Switches zu übernehmen und in den wichtigen japanischen Markt einzutreten. Die Komponenten schalten und schützen bei vielen Fahrzeugen Elektromotoren, Scheinwerfer und andere elektrische Komponenten. Darüber hinaus unterstützen sie das elektronische Motormanagement und Sicherheitsanwendungen wie ABS und Airbag. Für die Power Switch-Technologie wurde Infineon auf dem SAE Weltkongress in Detroit (USA) mit dem Tech 2000-Preis des Fachmagazins Automotive Engineering International für das innovativste Produkt ausgezeichnet.

Im Juni stellte Infineon bereits mit CoolMOS-C2 eine zweite Generation von Power-Transistoren vor, die sich neben sehr geringen Leistungsverlusten zusätzlich durch wesentlich reduzierte Schaltverluste auszeichnet.

Von der high-end 32-bit Mikrocontroller-Familie TriCore präsentierte Infineon als wesentliche Komponente einen neuen Chip, dessen Architektur konsequent auf zukünftige 'Automotive Embedded Control'-Systeme ausgerichtet ist. Erste Muster wurden bereits an führende Schlüsselkunden ausgeliefert, die nun ihre eigenen Produkte mit Systemchips von Infineon entwickeln. Weitere auf dem TriCore-Prozessor basierende Chips werden nun entwickelt.

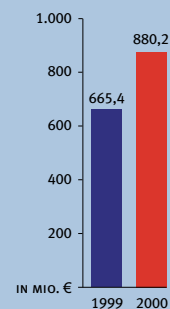
Ausblick

Infineon erwartet, dass das über dem Marktdurchschnitt liegende Umsatzwachstum im Bereich Automobil- und Industrieelektronik aufgrund höherer Kapazitäten und einer guten Preisentwicklung auch im neuen Geschäftsjahr anhalten wird. Um die Ergebnissituation nochmals zu verbessern, werden weitere margenschwache Produkte abgesetzt.

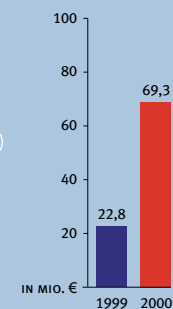
Mit einer noch stärkeren Kundenbindung und dem Ausbau der Technologiebasis will der Bereich seinen Marktanteil bei Power Management & Supply erhöhen. Da hier vorwiegend Kunden aus der Region Südostasien führende Positionen im Weltmarkt einnehmen, wird Infineon in Singapur ein spezielles Kompetenzzentrum einrichten. Mit einem angestrebten hohen Umsatzwachstum in den USA will der Konzern im Geschäftsjahr 2001 im amerikanischen Markt für Automobilelektronik eine führende Position einnehmen.

Unterstützt durch einen teilweisen Rückzug der japanischen Hersteller will die eupec ihre Marktposition im Segment der industriellen Antriebstechnik weiter ausbauen. Das Tochterunternehmen wird mit neuen Produkten in den rasch wachsenden Markt für Konsumer-Antriebe in Südostasien eintreten.

AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK UMSATZ



AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK EBIT



Unsere wertvollste Ressource: die Infineon-Mitarbeiter

Mit 3367 Neueinstellungen erhöhte Infineon im Geschäftsjahr 2000 die Zahl der Beschäftigten auf weltweit 29166. Hochqualifizierte Mitarbeiter, die zu den innovativsten und motiviertesten Spezialisten gehören, werden von uns auf ganz unterschiedliche Weise gesucht und mit möglichst innovativen Mitteln an Infineon gebunden. Denn ohne diese Topleute könnten wir unsere führenden Positionen in der Halbleiterbranche nicht behaupten.

Die ersten Kontakte zwischen uns und Studenten werden heute immer mehr auf unserer Internetplattform **www.meet-infineon.com** geknüpft. Mit 21 der weltweit führenden Universitäten arbeiten wir intensiv beim Entwickeln neuer Technologien zusammen. Darüber hinaus senden wir regelmäßig an rund 200 Ausbildungseinrichtungen Informationen über die Perspektiven in unserem Unternehmen.

Jährlich nehmen wir rund um den Globus an über 120 Firmenkontaktmessen teil und veranstalten Workshops für Absolventen. Zudem unterstützen wir an ausgewählten Universitäten Stiftungslehrstühle und Studiengänge, gewähren in zehn Ländern Stipendien und haben alleine im Berichtsjahr 3000 Praktikantenplätze angeboten.

Hochqualifizierten Absolventen bieten wir ein 18-monatiges berufsnahes Einstiegsprogramm an. Seit Oktober 2000 werden außerdem rund 350 junge Menschen an Infineon-Standorten sowie in Berufsschulen vor Ort ausgebildet.

Der Standort München als Beispiel: Hier kamen rund 25 Prozent unserer Neueinstellungen im Jahr 2000 allein durch Hochschulprogramme und Rekrutierungsveranstaltungen zustande. Über Jobbörsen im Internet oder infolge von Direktbewerbungen unter **www.infineon.com/careers** knüpften sogar 26 Prozent der neuen Mitarbeiter Kontakt – 1996 war es nur ein Prozent.

Mit 28 Prozent fanden jedoch die meisten neuen Arbeitskräfte über Mund-zu-Mund-Propaganda zu Infineon. Diese Zahl freut uns ganz besonders. Ist sie doch Zeichen für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter - und deren Bereitschaft, Infineon als Arbeitgeber an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen.

Jedoch ist nur ein Schwerpunkt der Personalarbeit, neue Mitarbeiter einzustellen. Ein weiterer liegt auf der Aufgabe, die Mitarbeiter an Bord zu halten. Damit sie auch in Zukunft gerne bei Infineon arbeiten, ebnen wir ihnen den Weg zum persönlichen Erfolg mit einem großen Angebot an Weiterbildungsprogrammen, um vor allem technologische Fähigkeiten sowie Führungsqualitäten voranzubringen. Ganz wichtig ist dabei natürlich eine angemessene Bezahlung, aber genauso kümmern wir uns um Möglichkeiten der Gesundheitsfürsorge, Erholungseinrichtungen, persönliche Beratung und andere Leistungen.

Für uns ist es selbstverständlich, die Mitarbeiter zu ermutigen, sich in die Handlungs- und Entscheidungsprozesse einzumischen, und so aktiv den Erfolg und der Entwicklung des Unternehmens zu beeinflussen. Nach dem umfassenden Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm und dem eingeschränkten Aktienoptionsplan zum Börsengang, wird Infineon schon bald einen neuen umfangreichen Aktienoptionsplan auflegen müssen. Nur so wird das Unternehmen auch in Zukunft im harten Kampf um die besten Mitarbeiter bestehen und mit den meist amerikanischen Wettbewerbern gleichziehen können.

MITARBEITER AM UNTERNEHMEN BETEILIGT

Der Konzern hat im Berichtsjahr die Belegschaft erneut ausgebaut und somit erheblich in sein wichtigstes Kapital investiert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg zum Ende des Berichtsjahres um 13 Prozent auf 29.166 (Vorjahr: 25.779). Gleichzeitig stieg der Umsatz pro Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt um 55 Prozent auf 267.644 Euro (Vorjahr: 172.662 Euro).

Um den großen Bedarf an Fachkräften mit Berufserfahrung und Hochschulabsolventen zu decken, erweiterte Infineon seine Rekrutierungsaktivitäten deutlich. Insbesondere in Deutschland leidet die Halbleiterindustrie unter einem generellen Fachkräftemangel. Dem begegnete der Konzern mit dem Abschluss eines Ergänzungstarifvertrages zum Ausweiten der 40-Stunden-Woche auf den größten Teil der über 6000 Angestellten in Bayern mit Wirkung zum 1. April 2000. Weiterhin werden von Infineon in Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen neue Berufsbilder entwickelt sowie intern die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter voran getrieben.

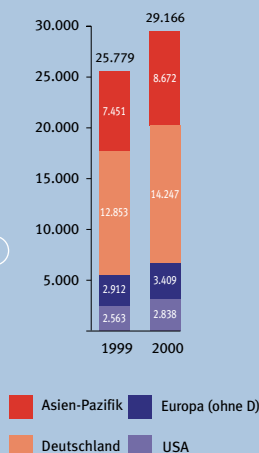
Um die Motivation der Mitarbeiter und deren Identifikation mit Infineon weiter zu erhöhen, wurde zum Börsengang ein Beteiligungsprogramm aufgelegt, das international Maßstäbe gesetzt hat: Etwa 97 Prozent der Infineon-Mitarbeiter weltweit wurden beim Börsengang bis zu 9,3 Millionen Aktien bevorrechtigt angeboten. 74 Prozent davon beteiligten sich an dem Programm, das je nach Angebot aufgrund verschiedener nationaler und internationaler Rechtsvorschriften eine Sperrfrist zum Verkauf der Aktien zwischen vier Monaten und sechs Jahren vorsieht.

Umfangreicher Aktienoptionsplan bindet Spitzenkräfte

Um insbesondere Spitzenkräfte stärker an Infineon zu binden sowie Unternehmen mit hochwertigen geistigen Eigentumsrechten sowie deren Mitarbeiter einfacher akquirieren zu können, hat die Gesellschaft vor dem Börsengang einen Aktienoptionsplan für bis zu 48 Millionen Aktien beschlossen: In den nächsten fünf Jahren können an Mitglieder des Vorstandes Optionen zum künftigen Erwerb von bis zu 2,25 Millionen Aktien, an Mitglieder der Geschäftsführungen von Tochtergesellschaften bis zu 6 Millionen Aktienoptionen und an Führungskräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen - insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung - bis zu 39,75 Millionen Aktienoptionen ausgegeben werden. Jährlich dürfen bis zu 30 Prozent von den im Plan vorgesehenen Optionen gewährt werden. Erstmals wurden beim Börsengang 5,54 Millionen Optionen ausgegeben.

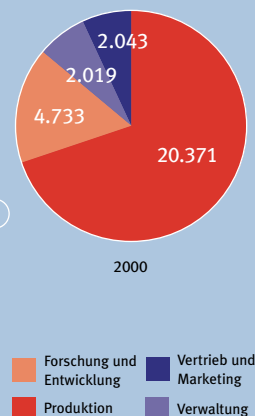
Der Ausübungspreis für eine Aktie entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Aktienpreises der letzten fünf Handelstage vor dem Ausgabebetag der Optionen; bei den zum Börsengang gewährten Optionen wurden dafür 42 Euro festgesetzt, also 120 Prozent des Emissionspreises von 35 Euro. Die Optionen können frühestens zwei Jahre und spätestens sieben Jahre nach ihrer Gewährung ausgeübt werden, wenn der Ausübungspreis an mindestens einem Handelstag der Laufzeit erreicht worden ist.

MITARBEITER
IN DEN REGIONEN*



*Stand 30. September

MITARBEITER
IN DEN BEREICHEN*



Dresden: Willkommen in der Silicon City

Im Herbst 1989 machte Dresden als ein wichtiges Epizentrum der politischen Wende in Ostdeutschland von sich reden. Schon zu jener Zeit war Dresden das Zentrum der ostdeutschen Elektronik- und Mikroelektronikindustrie: Es gab dort sehr viele gut ausgebildete und innovative Ingenieure. Doch noch war Marketing ein Fremdwort, und ein Großteil der Produktionsanlagen erwies sich als veraltet.

Nachdem die Stadt wieder die Hauptstadt des Freistaates Sachsen geworden war, wurde es höchste Zeit, dass die vielen hochbegabten und vor Ort ausgebildeten Ingenieure eine neue Herausforderung bekamen. Mit erheblicher Unterstützung der öffentlichen Hand entschied sich der Siemens-Halbleiterbereich, in Dresden für 1,4 Milliarden Euro ein neues Halbleiterwerk zu bauen und dort 16-Megabit-Chips zu produzieren.

Das war im Dezember 1993 und ein willkommener Anschlag für die Wirtschaft in Sachsen. Der Bau der 90.000 Quadratmeter großen Fabrik begann im Juni 1994, nur 15 Monate später lief die Produktion im ersten Fertigungsmodul hoch. Noch einmal 14 Monate später, im Oktober 1996, hatte der neue Standort schon zwei Millionen 16-Megabit-Chips produziert. Und als ein weiteres Jahr vergangen war, wurden daraus 50 Millionen Stück – weit mehr, als ursprünglich geplant. Deshalb war auch die Zahl der Mitarbeiter in Dresden von 1450 auf 3000 erhöht worden.

Dieser Erfolg ermutigte uns 1997, eines der bislang ehrgeizigsten Projekte der Halbleiterindustrie ebenfalls in Dresden zu starten: Die Errichtung einer Pilotlinie zur Herstellung von Chips auf Siliziumscheiben mit 300-Millimetern Durchmesser.



Dafür gründeten wir zusammen mit Motorola das Gemeinschaftsunternehmen 'Semiconductor300'. Aufgrund seiner geänderten Geschäftsstrategie stieg Motorola Ende 2000 aus dem Projekt aus. Anstelle dieses Partners traten der Freistaat Sachsen und die Jenoptik-Gruppe, ein Technologiekonzern, der bereits selbst in Ostdeutschland Geschichte geschrieben hat.

Das 230 Millionen Euro-Projekt wurde auf einer Pilotlinie im zweiten Modul des Dresdner Halbleiterwerkes realisiert, schuf 450 Arbeitsplätze und knüpfte nahtlos an den Erfolg der Vorjahre an: Im Dezember 1998 verließ der erste Testchip die neue Produktionslinie, ein 64-Megabit DRAM.

PROZESSTECHNOLOGIE: CHIPSTRUKTUREN VERKLEINERT

In der Halbleiter-Prozesstechnologie arbeitet Infineon intensiv an der weiteren Verkleinerung der Silizium-Chipstrukturen. Dadurch können einerseits mehr Transistoren auf der gleichen Chipfläche untergebracht werden, andererseits lässt sich ihre Schaltgeschwindigkeit erhöhen. Die größere Leistungsfähigkeit auf kleinerer Chipfläche erlaubt einen höheren Integrationsgrad und ermöglicht es den Kunden, günstigere Systemlösungen zu entwickeln.

KOOPERATIONEN: WETTBEWERBSPOSITION GESTÄRKT

Seit Januar 2000 entwickelt Infineon zusammen mit seinen Partnern IBM und UMC (United Microelectronics Corporation) die nächste Technologiegeneration für Strukturgrößen von 0,13- und später 0,10-Mikrometern. So lassen sich Chips mit höheren Schaltgeschwindigkeiten und besonders niedrigem Energieverbrauch herstellen, die vor allem in akkubetriebenen Geräten wie Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt werden können.

Im März 2000 vergab das Unternehmen weitere Lizenzen an das gemeinsam mit Mosel Vitelic geführte Gemeinschaftsunternehmen ProMOS Technologies. Auf Basis der von Infineon entwickelten 0,17-Mikrometer-Technologie bzw. den in der Entwicklung befindlichen 0,14-Mikrometer- und 0,12-Mikrometer-Technologien produziert ProMOS DRAMs, die über die Vertriebskanäle von Infineon und Mosel Vitelic verkauft werden. Darüber hinaus haben Infineon und ProMOS im April vereinbart, dass ProMOS die 300-Millimeter-Technologie ebenfalls ab dem Geschäftsjahr 2002 am bestehenden Standort Hsinchu einsetzen wird.

Um künftig mit Hilfe der sogenannten Next Generation Lithography (NGL) noch kleinere Chipstrukturen produzieren zu können, ist Infineon am europäischen MEDEA-Projekt 'Ion Projection Lithography' beteiligt. Im Mai 2000 verstärkte die Gesellschaft diese Aktivitäten mit dem Beitritt zum amerikanischen EUV-LLC-Konsortium (Extreme Ultraviolet Limited Liability Corporation), dem außerdem AMD (Advanced Micro Devices), Intel und Motorola angehören.

Darüber hinaus hat Infineon mit fünf weiteren führenden Halbleiterproduzenten - Hyundai Electronics, Intel Corporation, Micron Technologies, NEC Corporation und Samsung Electronics - die Zusammenarbeit bei Architektur, Design und Struktur der sogenannten 'Advanced DRAM'-Technologie vereinbart. Diese Technologie zielt auf potenzielle Anwendungen ab dem Jahr 2003.

INVESTITIONEN MEHR ALS VERDOPPELT

Mit insgesamt 1.571 Mio. Euro erhöhte Infineon die Investitionen in Sachanlagen um 141 Prozent (Vorjahr: 653 Mio. Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote vom Umsatz in Höhe von 22 Prozent. Die Mittel flossen vor allem in den Kapazitätsausbau für Logikprodukte der bestehenden Frontend-Fabriken in Dresden, Regensburg, Richmond und Villach.

Darüber hinaus investierte der Konzern 303 Mio. Euro in Beteiligungen (Vorjahr: 133 Mio. Euro). So erwarb Infineon vom bisherigen Partner Motorola dessen Anteile an White Oak Semiconductors in Richmond, den Geschäftsbetrieb von Savan Technologies in Tel Aviv sowie vom debis Systemhaus die Aktivitäten im Bereich Software für Mobilfunkgeräte in Nürnberg. Das Portfolio des Wagniskapital-Bereichs 'Infineon Ventures' wurde im Berichtsjahr mit einem Investitionsvolumen von 38 Mio. Euro um 11 auf 21 Beteiligungen erweitert.

Weiterhin nahm der Konzern an einer Kapitalerhöhung bei ALTIS Semiconductor S.N.C. teil. ALTIS - ein Gemeinschaftsunternehmen von IBM und Infineon - hat mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs seine Fertigungskapazität am Standort Essonnes ausgebaut.

INVESTITIONSVOLUMEN DER CHIPINDUSTRIE NIMMT ZU

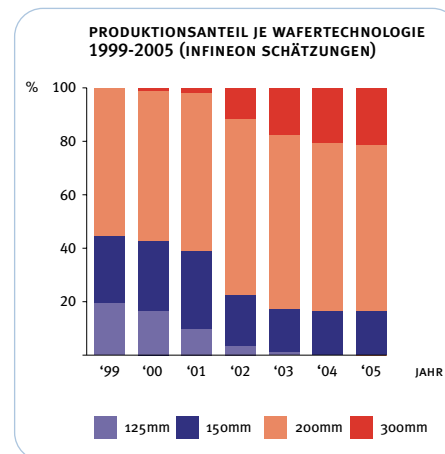
Die Unternehmen der Halbleiterindustrie planen nach Angaben von Gartner Dataquest (Stand: Oktober 2000) in den Jahren 2001 und 2002 ihr Investitionsvolumen voraussichtlich stark auszuweiten und insgesamt etwa 30 Prozent der Umsätze in neue Kapazitäten zu investieren. Trotz der angekündigten hohen Investitionen insbesondere in neue 300-Millimeter Fabriken erwartet Gartner Dataquest, dass die Investitionsquoten der reinen Speicherchip-Hersteller unter dem Durchschnitt der gesamten Industrie liegen werden. Die höchsten Quoten wurden von den taiwanesischen Silicon Foundries TSMC sowie UMC gemeldet. Infineon selbst plant im Geschäftsjahr 2001 mit einem Investitionsbudget von 30 Prozent des Umsatzes; direkte Wettbewerber von Infineon im Nicht-Speicherbereich planen mit etwas höheren Investitionsvolumina.

Die Pilotphase erwies sich als so erfolgreich, dass Infineon sich entschloss, für 1,1 Milliarden Euro ein neues 300-Millimeter-Fertigungsmodul direkt neben den zwei bestehenden zu bauen. Bereits Ende 2001 soll die Serienfertigung hochgefahren werden. Wenige Monate später wird die Produktion dann ihre volle Kapazität erreichen.

Die Grundsteinlegung dafür am 30. Mai 2000 betitelte die Zeitung International Herald Tribune als „Krönung von Dresdens Aufstieg zu einem neuen Entwicklungszentrum für Hochtechnologie.“ Für diesen Titel hätte es auch zuvor Anlässe gegeben: Beispielsweise der Produktionsstart in der Mikroprozessoren-Fabrik des amerikanischen Konzern AMD Ende 1998. Oder als Infineon im April 1999 als erster europäischer und als zweiter Hersteller weltweit einen funktionstüchtigen 256-Megabit-Speicherchip präsentieren konnte.

Den wahren Siegeszug wird jedoch die 300-Millimeter-Technologie antreten. Mit einer deutlich höheren Chipausbeute je Siliziumscheibe ermöglicht sie mit einem Schlag eine erhebliche Senkung der Stückkosten – und damit einen der schärfsten Kostenschnitte, der jemals in einem Industriebereich erreicht wurde.

Und nicht nur das: der Kostenschnitt wird zusammen mit dem weiteren Verkleinern der Chipstrukturen sowie der nochmals gesteigerten Rechenleistung weitere Vorteile bringen. Davon sollen natürlich auch unsere Kunden profitieren. Denn die noch kleineren und noch leistungsstärkeren Chips werden ganz neue und kompaktere Generationen von Elektronikprodukten möglich machen.



HOHE ANFORDERUNGEN AN DEN EINKAUF

Das gesamte Einkaufsvolumen von Infineon einschließlich Sachinvestitionen stieg im Berichtsjahr aufgrund der hervorragenden Auftragsentwicklung um 88 Prozent auf 3.413 Mio. Euro (Vorjahr: 1.820 Mio. Euro).

Aufgrund des weltweit starken Ausbaus der kapitalintensiven Fertigungen kommt insbesondere in einer Boomphase dem Einkauf eine herausragende Bedeutung zu. Die Vollausslastung der Halbleiterfabriken führte im Geschäftsjahr zu verlängerten Lieferzeiten, die insbesondere bei Anlagen für die Lithografie kritisch waren. Außerdem führte sie zu einer Verknappung und Verteuerung der Siliziumscheiben. Infineon löste die Situation weitgehend dank langfristiger Vereinbarungen und Kooperationen mit Schlüssellieferanten.

Um der Kundennachfrage und damit dem Bedarf an Fertigungskapazitäten stärker gerecht zu werden, wurde im Berichtsjahr das Einkaufsvolumen bei Auftragsfertigern (Silicon Foundries) um 140 Prozent auf 430 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 181 Mio. Euro).

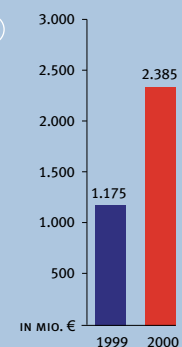
AUSBAU DER FERTIGUNGSKAPAZITÄTEN

Als Reaktion auf die außerordentlich gute Marktlage hat Infineon seine bestehenden Fertigungsstandorte ausgebaut und die Fertigungsprozesse weiter optimiert. Darüber hinaus wurde in Dresden der Grundstein zum Bau des weltweit ersten 300-Millimeter-Fertigungsmoduls gelegt. Diese Fertigung soll, verglichen mit der 200-Millimeter-Technologie, ab dem Geschäftsjahr 2002 bei DRAM-Produkten zu einem erheblichen Kostenvorteil führen. Die Technologieführerschaft von Infineon wurde von der Fachzeitschrift Semiconductor International mit der Verleihung des Titels 'Fabrik des Jahres 1999' für die bestehende 300-Millimeter-Pilotlinie in Dresden bestätigt.

Infineon rüstete im Geschäftsjahr 2000 einen Großteil der Speicherchip-Fertigung an den Standorten in Dresden, Richmond und Hsinchu (ProMOS) auf die neuen 0,19- und 0,17-Mikrometer-Technologien um. Außerdem fertigte ALTIS in Essonnes erstmals Hochleistungs-Logik-ICs mit 0,18-Mikrometern Strukturbreite für Anwendungen in der drahtlosen sowie der drahtgebundenen Kommunikation.

Um den hohen Bedarf an Produkten in Spezialtechnologien nachzukommen, wurde mit der Umstellung der Fertigungen in Regensburg und Villach auf die 200-Millimeter-Technologie begonnen. Entsprechend den höheren Frontend-Kapazitäten wurden auch die Backend-Fabriken für das Montieren und Testen von Chips in Malaysia, Singapur und Porto ausgebaut.

GESAMTES
INVESTITIONSVOLUMEN



Chips sind nicht alles

Infineon ist weltweit einer der Technologieführer wenn es darum geht, Millionen von Instruktionen und Vorgängen datentechnisch auf ein winziges Stück Silizium zu bannen. Gleichzeitig gehören wir zu den Vorreitern, die bereits frühzeitig Maßnahmen entwickelt haben, um mögliche Umweltverschmutzungen schon während Tausender von Arbeitsschritten in der Chipproduktion zu reduzieren.

Das große Weiterdenken in Sachen Umweltschutz hat Mitte der 90er Jahre begonnen. Bis dahin wurden umweltschädliche Abfälle, die während des Herstellungsprozesses aus übriggebliebenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe anfallen, erst am Ende wieder zu beseitigen. Dieser neue Denkansatz ermöglicht es uns, noch umweltverträglicher zu arbeiten, und die Gesundheitsrisiken für unsere Mitarbeiter weiter zu minimieren.

Der Ansatz setzt sich aus vielerlei Schritten zusammen. Am Ende führt er zu einem optimierten Einsatz von Ressourcen. Entscheidend dabei ist, dass einige Schadstoffe erst gar nicht mehr entstehen. Mögliche Probleme, die durch Anlagen verursacht werden könnten, sollen bereits im Vorfeld erkannt und verhindert oder zumindest verringert werden.

Ein erster Schritt war das Erstellen eines Handbuchs für Umweltmanagement in allen Fertigungsbereichen. Dieser und der folgende Schritt wurden von den Verantwortlichen der Fertigungsstätten selbst durchgeführt: In Zusammenarbeit mit Zentralabteilungen, die Maßnahmen zum Umweltschutz begleitet und überwacht haben, mussten sie sich bestätigen lassen, dass die im Handbuch dokumentierten Standards erfüllt werden.

Die Inhalte des Handbuchs werden ständig überprüft und aktualisiert, insbesondere seitdem Infineon 1999 eine Zentralabteilung für Sicherheit, Umweltschutz und Gesundheit eingerichtet hat. Ein weiterer wichtiger organisatorischer Schritt war das Zusammenführen dieser Abteilung mit der zentralen Qualitätssicherung. Das gute Zusammenspiel sollte dazu führen, dass Infineon alle Fertigungsstätten nach den Qualitätsmanagement-Normen ISO 9001 und QS 9000 sowie der Umweltschutz-Norm ISO 14001 zertifizieren lassen kann.

All dies geschah in Folge einer einfachen aber grundlegenden Einsicht: Bei allen Fertigungsabläufen ein höchstes Maß an Umweltverträglichkeit zu erreichen, ist nicht allein eine teure Notwendigkeit. Dieses Ziel zu erreichen, muss vielmehr Teil eines ganzheitlichen Ansatzes sein, an dessen Ende wir dem Unternehmen, seinen Produkten und Dienstleistungen einen maximalen Wert verleihen.



DARSTELLUNG DER ERTRAGSLAGE

Konzernüberschuss vervielfacht

Infineon steigerte im Geschäftsjahr 2000 seinen Umsatz um 72 Prozent auf 7.283 Mio. Euro (Vorjahr: 4.237 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis stieg dabei auf 3.172 Mio. Euro bzw. rund 44 Prozent des Umsatzes (Vorjahr: 1.227 Mio. Euro bzw. 29 Prozent). Entsprechend wurde die Bruttomarge vom Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozentpunkte erhöht. Gründe dafür waren die relativ stabilen Preise durch den Nachfrageüberhang und die Senkung der Stückkosten infolge kleinerer Chipstrukturen und einer höheren Ausbeute.

Der Konzern investierte weiter stark in die Entwicklung zukunftssträchtiger Produkte und Prozesstechnologien. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen absolut um 39 Prozent auf 1.025 Mio. Euro (Vorjahr: 739 Mio. Euro). Im Verhältnis zum Umsatz reduzierten sie sich auf 14 Prozent (Vorjahr: 17 Prozent).

Die Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten stiegen absolut um 22 Prozent auf 670 Mio. Euro (Vorjahr: 551 Mio. Euro). Hauptgrund dafür war der wachstumsbedingte Ausbau des Vertriebsnetzes und der Verwaltungsbereiche. Relativ zum Umsatz verringerte sich der Anteil dieser Kosten auf 9 Prozent (Vorjahr: 13 Prozent).

Das Zinsergebnis spiegelt die gute Finanzausstattung von Infineon wider und erhöhte sich um 72 Prozent auf 75 Mio. Euro (Vorjahr: 43 Mio. Euro).

Das Ergebnis von Beteiligungsgesellschaften, an denen Infineon zwischen 20 und 50 Prozent der Anteile hält, wird nach der Equity-Methode konsolidiert. Der Infineon zuzurechnende anteilige Überschuss dieser Gesellschaften hat sich auf 101 Mio. Euro nahezu verdreifacht (Vorjahr: 34 Mio. Euro). Dieser Zuwachs entfällt überwiegend auf die taiwanesischen Beteiligung ProMOS Technologies, die vom Boom bei Speicherchips profitierte.

Infineon realisierte im Geschäftsjahr 2000 einen Ertrag in Höhe von 53 Mio. Euro aus einer Wertsteigerung ihrer Aktien an ProMOS Technologies durch eine Kapitalerhöhung, an der Infineon nicht teilnahm.

Aufgrund des hohen Vorsteuerergebnisses von 1.738 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro) entstand im Geschäftsjahr 2000 eine Steuerbelastung von 612 Mio. Euro, was einer Konzern-Steuerquote von 35 Prozent entspricht. Im Vorjahr wies Infineon wegen der Verluste in Deutschland einen Steuerertrag von 30 Mio. Euro aus.

Der Konzernüberschuss vervielfachte sich von 61 Mio. Euro im Vorjahr auf 1.126 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2000. Diese hervorragende Ergebnisentwicklung führte zu einer Umsatzrendite von 15 Prozent (Vorjahr: 1 Prozent).

Basierend auf dem gewichteten Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien und unter Berücksichtigung des Verwässerungseffektes aus gewährten Aktienoptionen vervielfachte sich der Gewinn je Aktie bei 615.121.186 Aktien auf 1,83 Euro (Vorjahr: 0,10 Euro bei 600.000.000 Aktien).

DARSTELLUNG DER FINANZLAGE

Free Cash Flow erheblich verbessert

Der Free Cash Flow, also die Differenz von Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Mittelabflüssen für Investitionen, verbesserte sich im Geschäftsjahr um 203 Mio. Euro auf -247 Mio. Euro (Vorjahr: -450 Mio. Euro). Zu den Mittelabflüssen für Investitionen zählen dabei auch kurzfristig verfügbare Rentenpapiere in Höhe von 452 Mio. Euro. Rein betriebswirtschaftlich werden diese täglich veräußerbaren Wertpapiere jedoch als Zahlungsmittel betrachtet, so dass der betriebswirtschaftliche Free Cash Flow von Infineon im Berichtsjahr bei 205 Mio. Euro lag. Das entspricht einem Anstieg um 655 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit vervierfachten sich auf 2.080 Mio. Euro (Vorjahr: 469 Mio. Euro). Hauptgründe dafür sind der gewachsene Konzernüberschuss und die Verminderung des Nettoumlaufvermögens unter anderem durch verstärktes Asset Management sowie die Ausweitung der Lieferantenverbindlichkeiten und der Rückstellungen.

Die Mittelabflüsse für Investitionen haben sich mit dem Anstieg auf 2.327 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Vorjahr: 918 Mio. Euro). Neben Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.571 Mio. Euro investierte Infineon 303 Mio. Euro in Beteiligungen und 452 Mio. Euro in kurzfristig verfügbare Rentenpapiere.

Die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeiten summieren sich im Geschäftsjahr auf 719 Mio. Euro (Vorjahr: 465 Mio. Euro). Hier wirken insbesondere die Kapitalerhöhungen von 821 Mio. Euro, aus denen langfristige Darlehen in Höhe von rund 500 Mio. Euro - im wesentlichen für White Oak Semiconductors an Siemens - getilgt wurden. Zudem schloss Infineon im ersten Quartal des Berichtsjahres die Finanzierungskonten mit Siemens mit einer positiven Wirkung von 341 Mio. Euro. Der Bestand an Zahlungsmitteln stieg auf 511 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro).

Um die Finanzlage des Konzerns mittelfristig abzusichern, hat Infineon mit einem Bankenkonsortium zwei in gleiche Tranchen aufgeteilte Kreditlinien über insgesamt 750 Mio. Euro vereinbart. Die Laufzeiten betragen vier Jahre bzw. ein Jahr jeweils mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr. Bisher wurden diese Kreditlinien nicht in Anspruch genommen.

DARSTELLUNG DER VERMÖGENSLAGE

Kapitalstruktur und Kapitalrendite weiter stark verbessert

Das bilanzierte Gesamtvermögen von Infineon erhöhte sich zum 30. September 2000 um 37 Prozent auf 8.853 Mio. Euro (Vorjahr: 6.445 Mio. Euro).

Die Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens stiegen auf 1.009 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro). Das Anlagevermögen wuchs um 28 Prozent auf 5.018 Mio. Euro (Vorjahr: 3.922 Mio. Euro). Dies reflektiert insbesondere die Investitionen in Sachanlagevermögen und Beteiligungen.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vermögenswachstum unterproportional um 10 Prozent auf 3.046 Mio. Euro (Vorjahr: 2.790 Mio. Euro). Einerseits wuchsen die Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen durch die Geschäftsausweitung und die Investitionstätigkeit deutlich um 95 Prozent auf 849 Mio. Euro (Vorjahr: 435 Mio. Euro). Andererseits wurden die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute um 363 Mio. Euro auf 266 Mio. Euro zurückgeführt. Im September 2000 gründete die Infineon Technologies AG den Infineon Pension-Trust Verein und übertrug diesem zur treuhänderischen Verwaltung Anteile an einem Spezialfonds, der für diesen Zweck bereits im Geschäftsjahr 1999 aufgelegt wurde. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Konzerns verringerten sich hierdurch um jeweils rund 150 Mio. Euro.

Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich im Geschäftsjahr um 59 Prozent auf 5.806 Mio. Euro (Vorjahr: 3.655 Mio. Euro). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66 Prozent (Vorjahr: 57 Prozent). Die Eigenkapitalrentabilität wuchs - trotz Kapitalerhöhungen - durch den Ergebnisanstieg erheblich auf 19 Prozent (Vorjahr: 2 Prozent).

Besonders wesentlich zur Beurteilung der finanziellen Stabilität von Halbleiterunternehmen ist die Kennziffer Net cash - der Saldo aus den Finanzforderungen und Finanzverbindlichkeiten. Infineon verbesserte die Net Cash-Position um 1.178 Mio. Euro auf 1.123 Mio. Euro (Vorjahr: -55 Mio. Euro).

AUSGEZEICHNETE ERGEBNISENTWICKLUNG AUCH BEI DER INFINEON TECHNOLOGIES AG

Die Infineon Technologies AG, die Führungsgesellschaft des Konzerns, stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des HGB auf.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Infineon Technologies AG verbesserte sich im zwölf Monate umfassenden Berichtsjahr gegenüber dem Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis 30. September 1999 in allen wesentlichen Positionen: Die Umsatzerlöse stiegen auf 7.626 Mio. Euro (1. April bis 30. September 1999: 2.574 Mio. Euro), der Jahresüberschuss erreichte 520 Mio. Euro nach einem Fehlbetrag vom 1. April bis 30. September 1999 von -81 Mio. Euro). Aufgrund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der AG als Verrechnungs-Drehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze aus als der Konzern.

Die Vermögens- und Finanzlage ist einerseits geprägt durch den deutlichen Anstieg des Finanzanlagevermögens sowie durch die Lieferungs- und Leistungsforderungen infolge der starken Geschäftsausweitung. Andererseits ist das Eigenkapital durch Kapitalerhöhungen sowie den hohen Jahresüberschuss auf 6.276 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 4.885 Mio. Euro). Daraus ergibt sich die - für die Halbleiterindustrie nicht ungewöhnlich - hohe Eigenkapitalquote von 75 Prozent (Vorjahr: 74 Prozent).

BERICHT ÜBER DIE BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Da Siemens gegenwärtig 71 Prozent des Grundkapitals der Infineon Technologies AG hält und ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen Infineon und Siemens nicht besteht, hat der Vorstand der Infineon Technologies AG gemäß § 312 Aktiengesetz einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erstellen, den sogenannten Abhängigkeitsbericht.

Im Abhängigkeitsbericht wird erklärt, dass die Infineon Technologies AG bei allen Rechtsgeschäften und allen Maßnahmen mit verbundenen Unternehmen nach den Umständen, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt worden ist.

Der Abhängigkeitsbericht ist vom Abschlussprüfer geprüft und ohne Einschränkung mit einem Bestätigungsvermerk versehen worden.

RISIKOBERICHT

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Halbleitergeschäft ist mit großen Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken verbunden, die sich vor allem in den wirtschaftlichen Ergebnissen und damit auch in der Kursentwicklung von Chip-Aktien widerspiegeln. Grund dafür ist der außerordentlich schnelle technologische Wandel. Er erfordert hohe Investitionen in Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung, die mit keiner anderen Branche vergleichbar sind. Nur wenn Infineon mit diesem Wandel Schritt hält wie bei der Verkleinerung der Chipstrukturen oder ihn sogar entscheidend mitbestimmt, zum Beispiel bei der Einführung der 300-Millimeter-Technologie, wird die Gesellschaft ihre starke Position in der Halbleiterindustrie festigen oder sogar ausbauen können.

Die Halbleiterbranche ist seit Jahrzehnten der entscheidende Fortschrittstreiber der Elektronikindustrie. Entsprechend ist für eine ertragreiche Zukunft von Infineon eine

mit hohen Kosten verbundene rechtzeitige Markteinführung neuer Halbleiterprodukte unerlässlich. Aktuelle Beispiele dafür sind die neuen Chips für Bluetooth- und UMTS-Anwendungen. Eine wesentliche Chancen- und Risikokomponente beinhaltet aber auch die äußerst unbeständige Preisentwicklung bei Speicherchips. Der Vorstand von Infineon verfolgt hierbei die Strategie, als Kostenführer in guten Zeiten den Ertrag zu maximieren und in weniger guten Zeiten Verluste zu minimieren.

Integriertes Risiken- und Chancen-Management

Um die Chancen zu nutzen, die sich im insgesamt attraktiven Marktumfeld der Halbleiterindustrie bieten, und Unsicherheiten erfolgreich zu überwinden, hat Infineon ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagement eingerichtet, das vom Abschlussprüfer im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft wurde. Ziel des Managements von Infineon ist dabei nicht das Vermeiden, sondern die umfassende Kenntnis aller potentiellen Risiken und ihrer Zusammenhänge. Ein solches Verständnis schafft Handlungsspielräume und erlaubt Managemententscheidungen unter Kenntnis der damit verbundenen Risiken.

Infineon versteht das effiziente und vorausschauende Risiko- und Chancenmanagement als wichtige und wertschaffende Aufgabe. Um Risiken und Chancen beurteilen, überwachen und steuern zu können, nutzt der Konzern eine Vielzahl von Steuerungs- und Kontrollsystemen, die laufend weiterentwickelt werden. Dazu gehören aufeinander abgestimmte Strategie-, Planungs- und Budgetierungsprozesse. Kernstück des Systems bilden Risiko- und Chancenberichte aller Bereiche, die regelmäßig erstellt und in den verschiedenen Leitungsgremien diskutiert werden. Sie bilden eine wesentliche Grundlage für die Entscheidungen des Managements. Begleitet werden diese ferner von strukturierten Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie regelmäßigen Benchmarking-Prozessen.

Vermeidung von Einzelrisiken

Im Rahmen des Risiko- und Chancen-Managements trifft Infineon umfangreiche Vorkehrungen insbesondere bei wesentlichen Einzelrisiken:

Gegen Produktrisiken sichert sich der Konzern durch ein engmaschiges Netz von Qualitätskontrollen ab, die wichtige Lieferanten mit einbeziehen. Alle Standorte sind nach der Norm ISO 9000 beziehungsweise QS-9000 zertifiziert.

Der Konzern schützt sich mit Versicherungen weitgehend gegen Bedrohungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beim Eintritt von Haftungsrisiken oder Schadensfällen.

Steuerliche, wettbewerbs-, patent-, umwelt- und börsenrechtliche Regelungen können Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.

Durch weltweite Geschäftsaktivitäten können Währungsrisiken entstehen, insbesondere in den Kursrelationen des Euro gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen. Diese werden bei Infineon nur teilweise durch Bezüge, Fertigungen oder Finanzierungen in lokalen Währungen ausgeglichen. Der größte Teil der verbleibenden Netto-Positionen wird durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Zu Spekulationszwecken setzt die Gesellschaft derivative Finanzinstrumente jedoch nicht ein.

Aktuelle Beurteilung des Gesamtrisikos

Die aktuelle Überprüfung der Risikosituation hat ergeben, dass im Geschäftsjahr 2000 keine den Fortbestand der Gesellschaft bedrohenden Risiken bestanden haben und auch für die Zukunft nicht zu erkennen sind.

München, im November 2000

DER VORSTAND

Dr. Ulrich Schumacher, Vorsitzender

Peter Bauer

Peter J. Fischl

Dr. Sönke Mehrgardt

Dr. Andreas von Zitzewitz

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Infineon beruhen, die verbunden sind mit der erwarteten künftigen Entwicklung des Halbleitermarktes, der relativen Marktposition und der technologischen und produktionstechnischen Leistungsfähigkeit von Infineon, den erwarteten Erfolgen aus der Forschung und Entwicklung sowie aus Kooperationen, den geplanten Investitionen in den weiteren Ausbau und die Modernisierung der Produktionskapazitäten sowie die weitere Reduzierung der Chipstrukturen und die Einführung einer neuen Fertigungstechnologie in Dresden bzw. den dadurch erwarteten Kosteneinsparungen. Obwohl der Vorstand annimmt, dass die den Prognosen zugrundeliegenden Erwartungen realistisch sind, kann er nicht dafür garantieren, dass diese Erwartungen sich auch als richtig erweisen werden. Die Annahmen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen.

Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören künftige Veränderungen im weltwirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld wie auch Nachfrage-, Preis-, Wechselkurs- und Zinsschwankungen. Besonderen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Infineon können folgende Faktoren haben: die Einführung von Konkurrenzprodukten, Änderungen der Geschäftsstrategie von Wettbewerbern und Kunden, die erfolgreiche Entwicklung und Einführung marktfähiger Produkte sowie neuer Produktionsprozesse durch Infineon und eine mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen am Halbleitermarkt. Ebenso werden die Prognosen beeinflusst durch die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln für den angestrebten gezielten Ausbau des Unternehmens und dessen Fähigkeit, die Wachstumsziele zu erreichen, um die Entwicklung der finanziellen Ergebnisse von Infineon im Geschäftsjahr 2001 fortzusetzen. Eine Aktualisierung der Prognosen durch Infineon ist weder geplant noch übernimmt die Gesellschaft die Verpflichtung dazu.

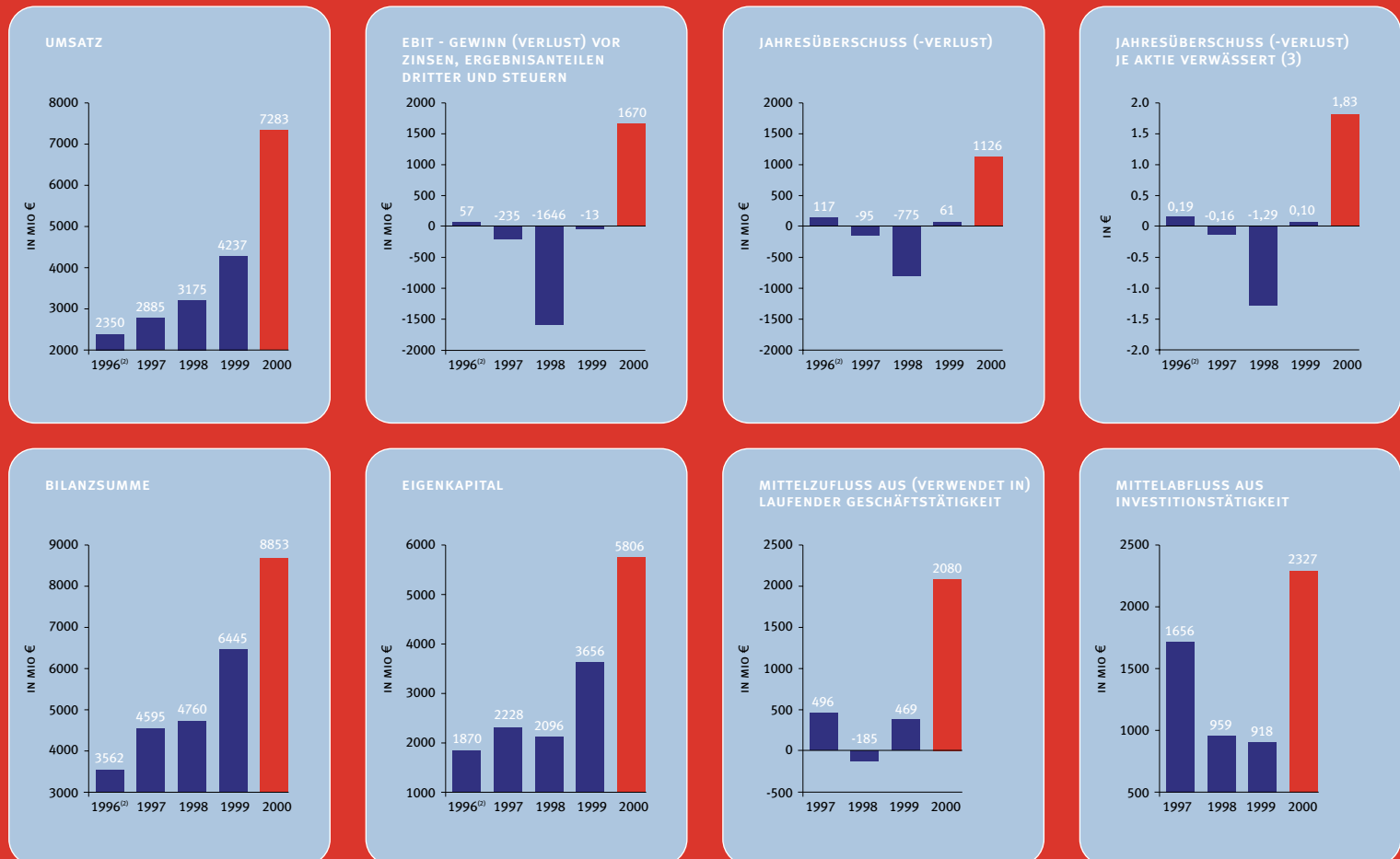
Grafiken und Schaubilder dienen der Veranschaulichung und sind nicht Teil dieses Lageberichts.

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Konzerns mit entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen. Sie übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, die Personalwirtschaft, strategische und produktionsorientierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Gesellschaft verfügt über eigene Fertigungen in Berlin, München und Regensburg.

Die Gesellschaft ist in eine konzernweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsstruktur eingebunden, die Abrechnung konzerninterner Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften erfolgt über die Infineon Technologies AG. Aus diesen Gründen ist der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Der Konzernabschluss der Infineon Technologies AG wurde nach § 292a HGB (Handelsgesetzbuch) unter Anwendung der US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles) Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt. Die US GAAP sind Bilanzierungsvorschriften für Unternehmen, deren Aktien an amerikanischen Börsen gehandelt werden. Damit können neben Investoren vor allem Analysten und Journalisten, aber auch Kunden und Lieferanten die Geschäftsentwicklung von Infineon besser mit der Entwicklung von fast allen bedeutenden internationalen Wettbewerbern vergleichen, die überwiegend nach US GAAP bilanzieren.

Konzern-Finanzdaten⁽¹⁾ Infineon Technologies besteht als rechtlich selbständiges Unternehmen seit April 1999. Davor war das Unternehmen Bestandteil der Siemens AG. Die Konzernabschlüsse von Infineon bis zum 31. März 1999 wurden unter Berücksichtigung von sogenannten Carve-out-Prinzipien erstellt und werden deshalb als Pro-Forma-Konzernabschlüsse bezeichnet.



(1) Zum Ende der Geschäftsjahre 1996 bis 2000 am 30. September. Mit Ausnahme der Grafik 'Jahresüberschuss (-Verlust) je Aktie' sind alle Zahlen in Millionen Euro angegeben.

(2) Ungeprüft (nur Geschäftsjahr 1996).

(3) Die Daten für den Gewinn je Aktie basieren auf der Annahme, dass 600 Mio. Aktien, also die Anzahl der Aktien unmittelbar vor dem Börsengang im März 2000, während der gezeigten Perioden von 1996 bis 1999 im Umlauf waren. Während des Geschäftsjahres 2000 betrug die Zahl der sich durchschnittlich im Umlauf befindlichen gewichteten Aktien 613.862.876 bzw. 615.121.186 Stück auf einer vollständig verwässerten Basis. Zum 30. September 2000 belief sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien auf 625.501.507 Stück.

**KONZERNABSCHLUSS
INFINEON TECHNOLOGIES AG**

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Bestätigungsvermerk	61
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die am 30. September 1998, 1999 und 2000 endenden Geschäftsjahre	62
Konzernbilanz zum 30. September 1999 und 2000	63
Entwicklung des Konzerneigenkapitals zum 30. September 1998, 1999 und 2000	64
Konzernkapitalflussrechnung für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000	65
Erläuterungen zum Konzernabschluss	66
Ergänzende Erläuterungen für den nach US-GAAP aufgestellten Anhang zum Konzernabschluss entsprechend der Anforderungen nach §292a HGB	85

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER

An den Aufsichtsrat und die Aktionäre der Infineon Technologies AG:

Wir haben die Konzernbilanzen zum 30. September 1999 und 2000, die Konzern- Gewinn- und Verlustrechnungen, die Aufstellungen über die Entwicklung des Konzerneigenkapitals sowie die Konzernkapitalflussrechnungen für die am 30. September 1998, 1999 und 2000 beendeten Geschäftsjahre (Konzernrechnungslegung) der Infineon Technologies AG geprüft. Die Konzernrechnungslegung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Konzernrechnungslegung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der deutschen und US-amerikanischen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernrechnungslegung frei von wesentlichen Mängeln ist. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Wertansätze und Angaben in der Konzernrechnungslegung auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Konzernrechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Gestützt auf unsere Prüfung stellt die oben genannte Konzernrechnungslegung nach unserer Überzeugung die Vermögenslage des Infineon-Konzerns zum 30. September 1999 und 2000 sowie die Ertragslage und die Zahlungsströme für die am 30. September 1998, 1999 und 2000 beendeten Geschäftsjahre in allen wesentlichen Belangen angemessen dar und entspricht den US- amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles).

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

München,
21. November 2000

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

für die am 30. September 1998, 1999 und 2000 endenden Geschäftsjahre

		1998	1999	2000
	ANMERKUNG	(IN TAUSEND EURO)	(IN TAUSEND EURO)	(IN TAUSEND EURO)
Umsatzerlöse				
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte		2.321.517	3.163.259	6.071.983
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen		853.783	1.074.034	1.210.615
Umsatzerlöse gesamt		3.175.300	4.237.293	7.282.598
Umsatzkosten		2.727.589	3.010.643	4.110.402
Bruttoergebnis vom Umsatz		447.711	1.226.650	3.172.196
Forschungs- und Entwicklungskosten		637.114	738.590	1.025.378
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten		481.364	550.547	669.828
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	22	816.469	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge), Saldo		8.764	1.893	(1.538)
Betriebsergebnis		(1.496.000)	(64.380)	1.478.528
Zinsergebnis, saldiert mit Zuschüssen		(35.269)	43.383	74.689
Anteiliger Jahresüberschuss (-fehlbetrag) von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften		(151.180)	33.763	101.303
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	10	-	-	53.425
Sonstige Erträge (Saldo)		1.720	17.576	36.252
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		(1.118)	185	(6.143)
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(1.681.847)	30.527	1.738.054
Erträge (Aufwendungen) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	907.159	30.109	(612.469)
KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS (-FEHLBETRAG)		(774.688)	60.636	1.125.585
KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS (-FEHLBETRAG) PRO AKTIE (IN EURO)	5			
UNVERWÄSSERT UND VERWÄSSERT		(1,29)	0,10	1,83

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
Die in Euro ausgewiesenen Beträge sind für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 mit dem Umrechnungskurs vom 1. Januar 1999 von DM in Euro umgerechnet worden (siehe Anmerkung 2).

KONZERNBILANZEN

zum 30. September 1999 und 2000

	ANMERKUNG	1999 (IN TAUSEND EURO)	2000 (IN TAUSEND EURO)
AKTIVA			
Umlaufvermögen			
Zahlungsmittel		29.506	510.814
Wertpapiere des Umlaufvermögens	6	–	497.712
Forderungen gegen Dritte	7	802.220	1.385.818
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17	948.664	439.125
Vorräte	8	676.972	840.814
Aktive kurzfristige latente Steuern	18	54.159	100.407
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände		11.529	60.468
Summe Umlaufvermögen		2.523.050	3.835.158
Sachanlagen	9	3.013.555	4.034.357
Finanzanlagen	10	130.436	432.291
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel		63.529	132.063
Aktive latente Steuern	18	314.342	165.601
Sonstige Vermögensgegenstände	11	400.371	253.405
Summe Aktiva		6.445.283	8.852.875
PASSIVA			
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, sowie kurzfristig fällige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	12	434.701	849.239
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17	527.922	373.385
Rückstellungen	13	243.144	718.781
Passive kurzfristige latente Steuern	18	79.655	74.634
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	14	269.685	299.948
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		2.049.712	2.454.337
Langfristige Finanzverbindlichkeiten, ohne kurzfristig fällige Bestandteile			
Passive latente Steuern	18	190.661	177.445
Sonstige Verbindlichkeiten	15	414.428	286.722
Summe Verbindlichkeiten		2.789.823	3.046.476
Eigenkapital			
Grundkapital	4	1.200.000	1.251.003
Zusätzlich eingezahltes Kapital (Kapitalrücklage)		2.390.161	3.250.715
Gewinnrücklagen		66.607	1.192.192
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	(1.308)	112.489
Summe Eigenkapital		3.655.460	5.806.399
Summe Passiva		6.445.283	8.852.875

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.
Die in Euro ausgewiesenen Beträge sind für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 mit dem Umrechnungskurs vom 1. Januar 1999 von DM in Euro umgerechnet worden (siehe Anmerkung 2).

ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS

zum 30. September 1998, 1999 und 2000 (in Tausend Euro, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien)

	AUSGEBEBENE STÜCKAKTIEN ANZAHL	BETRAG	ZUSÄTZLICH EINGEZAHLTES KAPITAL (KAPITALRÜCKLAGE)	GEWINN- RÜCKLAGEN	EINLAGEN DER SIEMENS AG	KUMULIERTE FREMD- WÄHRUNGS- UMRECHNUNGS- DIFFERENZ	NICHT REALISIERTE GEWINNE (VERLUSTE) AUS WERTPAPIEREN	GESAMT
Konzernbilanz zum 1. Oktober 1997	-	-	-	-	2.227.248	674	50	2.227.972
Konzernjahresfehlbetrag	-	-	-	-	(774.688)	-	-	(774.688)
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	(49.276)	53	(49.223)
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	-	-	(823.911)
Einlagen der Siemens AG	-	-	-	-	691.574	-	-	691.574
Konzernbilanz zum 30. September 1998	-	-	-	-	2.144.134	(48.602)	103	2.095.635
Konzernjahresfehlbetrag bis zum 1. April 1999	-	-	-	-	(5.971)	-	-	(5.971)
Konzernjahresfehlbetrag ab dem 1. April 1999	-	-	-	66.607	-	-	-	66.607
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	49.106	(1.915)	47.191
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	-	-	107.827
Einbehalt von North Tyneside durch die Siemens AG (siehe Anm. 1)	-	-	-	-	293.713	-	-	293.713
Einlagen der Siemens AG zum 31. März 1999	-	-	-	-	1.132.092	-	-	1.132.092
Kapitaleinlagen und Ausgabe von Aktien bei Gründung zum 1. April 1999	600.000.000	1.200.000	2.363.968	-	(3.563.968)	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	26.193	-	-	-	-	26.193
Konzernbilanz zum 30. September 1999	600.000.000	1.200.000	2.390.161	66.607	-	504	(1.812)	3.655.460
Konzernjahresüberschuss	-	-	-	1.125.585	-	-	-	1.125.585
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	105.085	8.712	113.797
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	-	-	-	-	-	-	-	1.239.382
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien	-	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs saldiert mit Kosten des Börsengangs	16.700.000	33.400	528.635	-	-	-	-	562.035
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Zuge einer Privatplatzierung	7.592.430	15.185	243.641	-	-	-	-	258.826
Kauf von Savan	1.209.077	2.418	46.426	-	-	-	-	48.844
Abgrenzung von Personalaufwendungen	-	-	(23.294)	-	-	-	-	(23.294)
Zuschreibung zu Finanzanlagen aufgrund einer Kapitalerhöhung eines assoziierten Unternehmens	-	-	51.212	-	-	-	-	51.212
Einlagen der Siemens AG	-	-	13.934	-	-	-	-	13.934
Konzernbilanz zum 30. September 2000	625.501.507	1.251.003	3.250.715	1.192.192	-	105.589	6.900	5.806.399

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Die in Euro ausgewiesenen Beträge sind für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 mit dem Umrechnungskurs vom 1. Januar 1999 von DM in Euro umgerechnet worden (siehe Anmerkung 2).

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

für die Geschäftsjahre 1998, 1999, 2000

	1998 (IN TAUSEND EURO)	1999 (IN TAUSEND EURO)	2000 (IN TAUSEND EURO)
Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag)	(774.688)	60.636	1.125.585
Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresüberschusses (-fehlbetrages) auf den Mittelzufluss (-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit			
Planmäßige Abschreibungen	578.387	573.069	833.656
Erworbene nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	–	–	26.012
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen	–	–	25.550
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	11.821	1.723	17.410
Gewinn aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	(510)	(521)	(20.238)
Gewinn aus dem Abgang von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	–	(15.319)	(306)
Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	–	–	(53.425)
Verlust (Gewinn) aus dem Abgang von Sachanlagen	1.231	18.041	(1.648)
Anteiliger Fehlbetrag (Überschuss) von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	151.180	(33.763)	(101.303)
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	1.118	(185)	6.143
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	673.905	–	–
Latente Steuern	(961.354)	(73.454)	90.812
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens			
Zunahme von kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(13.566)	(8.401)	(148.024)
gegen Dritte	(21.774)	(284.944)	(535.314)
(Zu-) Abnahme von Vorräten	20.641	(40.529)	(107.887)
(Zu-) Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	11.566	(25.607)	(29.800)
(Ab-) Zunahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten	70.955	73.294	93.995
gegenüber Dritten	(80.488)	61.984	375.393
Zunahme von Rückstellungen	54.087	77.847	467.505
Zunahme von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	59.657	75.668	103.339
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	32.649	9.080	(87.768)
Mittelzufluss (-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(185.183)	468.619	2.079.687
Cash Flow aus Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens	(11.888)	(175.250)	(451.990)
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	10.559	11.296	–
Einzahlungen aus dem Abgang von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	–	18.033	308
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	(171.317)	(133.078)	(302.512)
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	(42.350)	(43.203)	(42.909)
Auszahlungen für Sachanlagen	(763.146)	(652.528)	(1.570.832)
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	18.810	56.462	39.839
Dividenden, erhalten von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	–	–	1.461
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	(959.332)	(918.268)	(2.326.635)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	(33.480)	(48.151)	59.735
Zu- (Ab)nahme der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	954.744	(763.654)	222.167
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	21.275	71.613	13.264
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	(28.950)	(79.534)	(500.100)
Einzahlungen aus Ausgabe von zurückgewährbaren Anteilen an assoziierten Unternehmen	–	–	168.726
Zunahme der zu Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel	–	(63.529)	(67.173)
Einzahlungen von Siemens ins Eigenkapital	228.709	1.322.055	–
Einzahlungen aus Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien	–	–	820.861
Kapitaleinlagen	–	26.193	1.667
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.142.298	464.993	719.147
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel	(1.071)	2.276	9.109
Veränderung der Zahlungsmittel	(3.288)	17.620	481.308
Zahlungsmittel am Periodenanfang	15.174	11.886	29.506
Zahlungsmittel am Periodenende	11.886	29.506	510.814

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Die in Euro ausgewiesenen Beträge sind für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 mit dem Umrechnungskurs vom 1. Januar 1999 von DM in Euro umgerechnet worden (siehe Anmerkung 2).

ERLÄUTERUNGEN ZUM KONZERNABSCHLUSS

1. BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, DER GRÜNDUNG UND DER GRUNDLAGEN DER DARSTELLUNG

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Infineon Technologies Aktiengesellschaft („Infineon“ oder die „Gesellschaft“) entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chip Cards, eingesetzt. Das Leistungsspektrum von Infineon umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Lösungen für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed Signal-Anwendungen. Infineon besitzt Fertigungsstätten und Beteiligungen in Europa, Asien und Nordamerika. Infineon beliefert überwiegend Kunden in Europa, Asien und Nordamerika. Infineon ist eine Tochtergesellschaft der Siemens Aktiengesellschaft („Siemens“). Das Geschäftsjahr von Infineon und deren Tochtergesellschaften endet zum 30. September.

Gründung

Siemens hat im November 1998 ihre Absicht erklärt, einen Teil ihres Halbleitergeschäftes m Zuge eines Börsenganges zu veräußern. Hierzu wurde Infineon als eigenständiges Rechtssubjekt mit Wirkung zum 1. April 1999 gegründet („Gründung“). Im Zuge der Gründung erfolgte die Übertragung des nahezu vollständigen mit dem Halbleitergeschäft verbundenen Vermögens mit allen Beteiligungen, Betrieben und Geschäftsaktivitäten mit Ausnahme des überwiegenden Teils des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Wafer-Fabrik in North Tyneside, Nordengland („North Tyneside“), bestimmter Geschäftsteile in den USA und bestimmter Rechte auf geistiges Eigentum („Eingebrachtes Geschäft“). Bestimmte Vermögensgegenstände von North Tyneside, die auf Infineon übertragen wurden, sind im Konzernabschluss mit ihren historischen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der entsprechenden Abschreibungen bilanziert. Obwohl North Tyneside im Zuge der Gründung rechtlich nicht auf Infineon übertragen wurde, sind die Ergebnisse bis zum 30. November 1998 (Zeitpunkt der Einstellung des operativen Geschäftes von North Tyneside) in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die betreffenden Berichtszeiträume eingegangen, da North Tyneside in der Vergangenheit Bestandteil des Halbleiter-Geschäftes von Siemens war. Infineon hat keine rechtlichen Ansprüche oder Verpflichtungen bezüglich der verbliebenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten von North Tyneside. Entsprechend sind diese Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in der vorliegenden Konzernbilanz ab dem 30. November 1998 nicht mehr enthalten.

Am 13. März 2000 schloss Infineon den Zulassungsprozess mit der Erstnotierung an den Börsen in Frankfurt und New York erfolgreich ab (siehe Anmerkung 4).

Die Geschäftstätigkeit von Infineon wurde bis zum Börsengang im Wesentlichen durch Einlagen von Siemens in das Eigenkapital und Darlehen von Siemens finanziert und in einem geringeren Umfang durch Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten. Die Zinsaufwendungen von Infineon beinhalten Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Siemens-Konzerngesellschaften und Dritten. Entsprechend können künftige Zinsaufwendungen von dem Zinsaufwand abweichen, den Infineon für die Vergangenheit als selbständiges Unternehmen ausgewiesen hätte bzw. ab dem Zeitpunkt der Gründung tatsächlich ausgewiesen hat.

Grundlagen der Darstellung

Der Konzernabschluss wurde nach den in den USA geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung („US-GAAP“) erstellt. Er beinhaltet das von Siemens zum 1. April 1999 eingebrachte Geschäft und wurde bis zu dieser Zeit so aufgestellt, als ob Infineon in der heutigen Form für alle dargestellten Perioden bereits selbständig bestanden hätte. Der hier gezeigte Konzernabschluss für die Berichtszeiträume vor der Gründung spiegelt nicht notwendigerweise die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wider, welche sich

ergeben hätte, wenn Infineon als eigenständige und unabhängige Gesellschaft agiert hätte. Aus dieser Vergangenheitsdarstellung kann deshalb auch nur bedingt auf die zukünftige Geschäftsentwicklung geschlossen werden.

Zum 30. September 2000 wird die Infineon Technologies AG mit ihren Tochtergesellschaften in den Konzernabschluss der Siemens AG einbezogen. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt Infineon die Befreiungsmöglichkeit des §292a HGB in Anspruch. Danach braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie US-GAAP vorgelegt wird. Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vorjahres wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu gewährleisten. Das Konzernergebnis wird von diesen Umgliederungen nicht beeinflusst.

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zugrunde gelegt:

Konsolidierungsgrundsätze

Der vorliegende Konzernabschluss umfasst, jeweils auf konsolidierter Basis, für den Zeitraum vor der Gründung die Infineon zuzurechnenden Geschäftsvorfälle und die eingebrachten Geschäftsaktivitäten sowie für den Zeitraum nach der Gründung Infineon und deren wesentliche Tochtergesellschaften. Gesellschaften, an denen Infineon mit mehr als 20% beteiligt ist, die jedoch nicht unter der einheitlichen Leitung von Infineon stehen („Assoziierte Unternehmen“), werden prinzipiell unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert (siehe Anmerkung 10). Das anteilige Jahresergebnis von einer nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaft mit abweichendem Geschäftsjahr wird zeitversetzt um drei Monate erfasst. Sonstige Beteiligungen („Verbundene Unternehmen“), in denen Infineon einen Eigentümeranteil von weniger als 20% hält, werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. Die Auswirkungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen den konsolidierten Gesellschaften sind in dem Konzernabschluss eliminiert.

Die Infineon Gruppe besteht aus der folgenden Anzahl von Unternehmen:

	KONSOLIDIERTE UNTERNEHMEN	ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN	TOTAL
30. September 1999	22	5	27
Zugänge	4	—	4
30. September 2000	26	5	31

Der Konzernabschluss umfasst darüber hinaus 25 (1999: 9) Tochtergesellschaften und 9 (1999: 4) assoziierte Unternehmen, die nicht konsolidiert und nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanziert werden, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens haben. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition Finanzanlagen. Die Auswirkung dieser Unternehmen auf die Konzernbilanzsumme, die Konzernumsätze und das Konzernergebnis war in den Betrachtungsperioden geringer als 1%.

Berichtswährung

Am 1. Oktober 1999 führte Infineon den Euro als Berichtswährung ein. Der Konzernabschluss wird deshalb in Euro aufgestellt. Für die Umrechnung des zunächst in Deutsche Mark („DM“) erstellten Konzernabschlusses wurde für alle Berichtsjahre vor dem 1. Oktober 1999 der zum 1. Januar 1999 festgelegte Wechselkurs von EUR 1 = DM 1,95583 verwendet. Aufgrund des festen DM/EUR Wechselkurses werden durch die Umrechnung des Konzernabschlusses in Euro die Trendaussagen der in DM erstellten Konzernabschlüsse nicht verändert. Aufgrund von Währungsschwankungen zwischen der DM und anderen Währungen ist jedoch der Infineon Konzernabschluss nicht mit den in Euro aufgestellten Jahresabschlüssen anderer Gesellschaften vergleichbar, die ihre ursprünglichen Abschlüsse in einer anderen Währung als in DM erstellt haben.

Währungsumrechnung

Die Vermögensgegenstände und Schulden ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden grundsätzlich unter Anwendung der Stichtagskursmethode umgerechnet. Posten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung werden dagegen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Geschäftsjahres umgerechnet. Unterschiede aus der Umrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden, die aus zu Vorjahren abweichenden Wechselkursen resultieren, werden innerhalb des Postens „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren (Other Comprehensive Income/Loss)“ im Eigenkapital ausgewiesen. Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten Wechselkurse, basierend auf den amtlichen Wechselkursen der Frankfurter Wertpapierbörse, für die wichtigsten Währungen aufgeführt:

WÄHRUNG	WECHSELKURS ZUM 30. SEPTEMBER		JAHRESDURCH- SCHNITTKURS		
	1999 EUR	2000 EUR	1999 EUR	2000 EUR	
U.S. \$	1 \$ =	0.938	1.1373	0.913	1.0470
Japanische Yen	100 JPY=	0.888	1.0533	0.781	0.9881
Britische Pfund	1 GBP=	1.544	1.6720	1.485	1.6286
Singapur Dollar	1 SGD=	0.552	0.6530	0.541	0.6129

Zahlungsmittel

Bargeld sowie alle Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als liquide Mittel ausgewiesen.

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel beinhalten Geldanlagen, die im Rahmen der Finanzierung als Sicherheit hinterlegt sind sowie Zahlungsmittel, die Infineon als Treuhänder übertragen worden sind.

Wertpapiere

Die Gesellschaft hält frei veräußerbare Wertpapiere („Available-for-sale“-Papiere), die zu dem zuletzt gehandelten Marktpreis vor dem Bilanzstichtag bewertet sind. Kumulierte unrealisierte Gewinne und Verluste, nach Abzug von latenten Steuern sind im Eigenkapital als „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste und nicht nur vorübergehende Wertminderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens werden in der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ erfasst. Im Veräußerungsfall wird für die Ermittlung realisierter Gewinne oder Verluste vor Steuern von individuellen Anschaffungskosten der Wertpapiere ausgegangen.

Vorräte

Die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet, wobei die Herstellungskosten vorwiegend zu Durchschnittswerten ermittelt werden. Die Herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren Material- und Lohnkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Kosten für Ersatzteile, laufende Instandhaltung und Reparaturen werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder degressiven Methode ermittelt. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben. Die Herstellungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegenstände enthalten aktivierte Finanzierungskosten, die über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben werden. Für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000 waren die von Infineon aktivierten Zinsen nicht wesentlich. Die den Abschreibungen zugrunde gelegten Nutzungsdauern betragen bei

JAHRE

Gebäuden	20-25
Technischen Anlagen und Maschinen	3-10
Sonstigen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-10

Leasing

Infineon ist Leasingnehmer von Sachanlagen. Alle Leasinggeschäfte, bei denen Infineon in der Position des Leasingnehmers als wirtschaftlicher Eigentümer zu sehen ist, werden gemäß Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 13, „Rechnungslegung für Leasing“, als Finanzierungsleasing behandelt und bei Infineon als Sachanlagen bilanziert. Alle anderen Leasinggeschäfte werden als Operating Leases behandelt. Die an Dritte vermieteten technischen Anlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (grundsätzlich 5-10 Jahre) bilanziert.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände bestehen überwiegend aus erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, wie Lizenzen und erworbenem technologischem Know how, die zu Anschaffungskosten bilanziert werden. Weiterhin werden Firmenwerte aufgrund des Erwerbs von Geschäftsbetrieben ausgewiesen, wenn der Kaufpreis die Verkehrswerte der erworbenen Vermögensgegenstände übersteigt. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Infineon überprüft Anlagegüter, einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände, auf die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen, sobald Ereignisse oder Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Dabei wird der Restbuchwert mit dem langfristigen Nutzungswert verglichen, der sich aus dem Marktwert bzw. den erwarteten künftigen abgezinsten Einnahmeüberschüssen, die diesem Vermögensgegenstand zuzuordnen sind, ergibt. Eine außerplanmäßige Abschreibung wird nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als Differenz aus Buchwert und Marktwert oder dem Barwert künftiger Einnahmeüberschüsse ermittelt.

Finanzinstrumente

Infineon ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgesetzt. Zur Sicherung gegen Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Derivative Finanzinstrumente, die bestimmten Transaktionen zugeordnet werden können, werden gemeinsam mit dem Grundgeschäft bewertet. Soweit sich die derivativen Finanzinstrumente auf das operative Geschäft beziehen, erfolgt der Ausweis im Wesentlichen unter den Umsatzkosten, bei solchen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen, unter sonstige betriebliche Erträge oder Aufwendungen. Derivative Finanzinstrumente sind mit ihrem Marktwert unter den sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen oder den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Infineon hält keine derivativen Finanzinstrumente zum Handel oder zu spekulativen Zwecken.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse werden abzüglich von Rabatten und Nachlässen aus Preissicherungsklauseln ausgewiesen, sobald die Lieferungen oder Leistungen erbracht sind und der Gefahrenübergang erfolgt ist. Bei Lieferungen an Siemens Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte sowie an Siemens als Endkunden erfolgt die Umsatzrealisierung zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Bei Verkäufen an Siemens Vertriebsorganisationen wird der Umsatz abzüglich eines Abschlages in Höhe der Provision der Vertriebsorganisation ausgewiesen. Diese Abschläge werden als Abzüge vom Umsatz und nicht als Vertriebsaufwand dargestellt.

Umsatzrealisierung – Lizenzen und Know-how-Überlassung

Lizenzentnahmen und Erträge aus der Know-how-Überlassung werden realisiert, sofern der Zahlungseingang erfolgt und die Leistung erbracht ist. Einmalzahlungen werden abgegrenzt und über den Zeitraum der Leistungserbringung vereinnahmt.

Vereinbarungen über eine Leistung aus mehreren Bestandteilen, für die separate Marktpreise nicht existieren, werden in zusammengefasster Form über die entsprechenden Perioden realisiert.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Steuerfreie Zuwendungen der öffentlichen Hand werden abgegrenzt und periodenkongruent zu den korrespondierenden Aufwendungen vereinnahmt. Zu versteuernde Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens verringern die Anschaffungskosten der entsprechenden Vermögensgegenstände. Andere Zuschüsse werden mit den entsprechenden Aufwendungen verrechnet (siehe Anmerkungen 15 und 20).

Produktbezogene Aufwendungen

Ausgaben für Produktmarketing und Werbung sowie für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden im Zeitpunkt des Anfalls als Aufwand erfasst. Gewährleistungsrückstellungen werden ab dem Zeitpunkt der Umsatzrealisation gebildet. Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei Anfall in voller Höhe als Aufwand gebucht.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden nach der Verbindlichkeiten-Methode ermittelt. Aktive und passive latente Steuern werden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als Rückstellungen bilanziert, um die künftige steuerliche Wirkung aus zeitlichen Unterschieden zwischen dem bilanziellen Wertansatz von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten sowie dem steuerlich beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern wird von den erwarteten Steuersätzen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Realisierung ausgegangen. Wirkungen aus den Änderungen von Steuersätzen werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung berücksichtigt. Die Bemessung der latenten Steuern erfolgt in Deutschland unter Zugrundelegung des Steuersatzes für einbehaltene Gewinne.

Aktioptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert Vergütungen in Form von Aktienoptionen auf der Grundlage der inneren-Wert-Methode entsprechend der Accounting Principle Board („APB“) Opinion 25, „Accounting for Stock issued to employees“ und hat das Wahlrecht zur Erläuterung dieser Aktioptionspläne gemäß SFAS Nr. 123, „Accounting for Stock based compensation“ wahrgenommen.

Kapitalerhöhungen von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen

Gewinne oder Verluste aus der Durchführung von Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen führen entsprechend der Veränderung der Anteilshöhe zu sonstigen Erträgen oder Aufwendungen entsprechend der Regelungen der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) Staff Accounting Bulletin („SAB“) Topic 5:H, „Accounting for Sales of Stock by a Subsidiary“.

Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert Schätzungen und Annahmen vom Management. Diese haben Einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. Die sich tatsächlich ergebenden Beträge können von den Beträgen, die sich aus Schätzungen und Annahmen ergeben, abweichen.

Aktuelle Verlautbarungen zur Bilanzierung

Der Financial Accounting Standards Board („FSAB“) veröffentlichte SFAS 133, „Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften“ (SFAS 133), erweitert durch SFAS 137 und SFAS 138, die ab dem 1. Oktober 2000 durch die Gesellschaft angewendet werden. SFAS 133 und die Erweiterungsregelungen beinhalten Aussagen zur Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten einschließlich solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von Sicherungsgeschäften. Ansatz und Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten in der Bilanz erfolgen zum Marktwert.

Unterschiede aus der Marktbewertung sind im Konzernergebnis oder im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren („Other Comprehensive Income/Loss)“ auszuweisen, abhängig davon, ob das Instrument Bestandteil eines Sicherungsgeschäftes ist und welche Art von Sicherungsgeschäft vorliegt. Die Bewertung der Fremdwährungs-Termin- und Optionsverträge erfolgt derzeit zum Stichtagskurs mit entsprechender Wirkung auf das Konzernergebnis. Die Anwendung von SFAS 133 wird somit keinen Einfluss auf die Bilanzierung dieser Instrumente haben. Die Marktbewertung von derivativen Finanzinstrumenten und Sicherungsgeschäften wird in Anmerkung 27 erläutert.

Am 31. März 2000 hat der FASB die FASB-Interpretation Nr. 44 „Bilanzierung bestimmter Sachverhalte mit Vergütung in Aktien“ veröffentlicht, die die APB Opinion Nr. 25 ergänzt. Diese Interpretation klärt die Anwendung der APB Opinion Nr. 25 für bestimmte Fallgestaltungen. Die Regelung ist für zukünftige Sachverhalte ab dem 1. Juli 2000 anzuwenden. Die Anwendung dieser Vorschrift hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Im Dezember 1999 hat die SEC den Staff Accounting Bulletin (SAB) Nr. 101, „Umsatzrealisation in Abschlüssen“, veröffentlicht. SAB 101 regelt Realisierung, Ausweis und Erläuterungen zu Umsatzerlösen in Abschlüssen, die bei der SEC einzureichen sind. Anschließend veröffentlichte die SEC SAB 101A und SAB 101B, welche die Anwendung von SAB 101 für die Gesellschaft auf das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2001 verschieben. Durch die Anwendung von SAB 101 werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwartet.

3. AKQUISITIONEN

In 1997 gründeten Infineon und Motorola Inc. („Motorola“) das Joint Venture White Oak Semiconductor („White Oak“). Infineon hielt 50,1% der Anteile und besaß die gleichen Stimmrechte wie Motorola. Die Beteiligung wurde nach der Equity-Methode bilanziert, weil keine einheitliche Leitung von Infineon ausgeübt worden ist. Am 30. September 1999 erhielt Infineon unter anderem aufgrund einer Wandlungsvereinbarung mit Motorola beherrschenden Einfluss über White Oak und eine Option zum Kauf der restlichen 49,9% der von Motorola gehaltenen Anteile. Von diesem Zeitpunkt an wird daher diese Beteiligung vollkonsolidiert.

Im April 2000 hat die Gesellschaft ihre Option zum Kauf der restlichen Anteile an White Oak, die bislang von Motorola gehalten wurden, ausgeübt. Somit hält Infineon 100% der Anteile an White Oak. Der Kaufpreis in Höhe von EUR 176.445 führte zu entsprechenden Anschaffungskosten. Die Gesellschaft beauftragte einen sachverständigen Dritten mit der Bewertung der Vermögensgegenstände. Aufgrund dieser Bewertung erhöhte Infineon den Wertansatz der Sachanlagen von White Oak um EUR 24.567, im Einzelnen für Grund und Boden um EUR 2.772, für Gebäude um EUR 7.334 und Anlagen um EUR 14.461. Der die Minderheitenanteile übersteigende Teil des Kaufpreises in Höhe von EUR 111.300 wurde als Firmenwert bilanziert und wird über 10 Jahre linear abgeschrieben.

Im April 2000 erwarb Infineon Vermögensgegenstände der Savan Communications, Ltd. („Savan“) zu einem Barpreis von EUR 75.252, die als Anschaffungskosten bilanziert wurden. Savan entwickelt und vertreibt Produkte, die die VDSL Technologie nutzen. Diese Technologie ermöglicht die Breitband-Datenübertragung über existierende Kupfer-Leitungen. Zusätzlich zahlte Infineon über einen Treuhänder EUR 7.215 in bar und gewährte 1.209.077 Aktien und 252.968 Optionen im Wert von insgesamt EUR 48.844, die als abgegrenzte Vergütungen bilanziert wurden. Diese abgegrenzten Vergütungen werden als Forschungs- und Entwicklungskosten gemäß den zugrundeliegenden Arbeitsverträgen linear über einen Zeitraum von 2-3 Jahren verrechnet.

Im Eigenkapital wird die Kapitalrücklage zum 30. September 2000 in Höhe der abgegrenzten Vergütungen vermindert ausgewiesen. Infineon hat einen sachverständigen Dritten mit der Bewertung der erworbenen Vermögensgegenstände von Savan beauftragt. Als Ergebnis dieser Bewertung wurden EUR 26.012 noch nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten (in-process research and development) zugeordnet und im Berichtsjahr als Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen erfasst, da noch keine fertigungsreifen Produkte vorlagen

und eine alternative zukünftige Nutzung nicht gegeben ist. Die erworbenen, noch nicht abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte wurden entsprechend anerkannter Methoden für die Hochtechnologie-Kommunikationsindustrie und einschlägiger Richtlinien der SEC bewertet. Die übrigen Kaufpreisbestandteile werden als Firmenwert und immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die linear bis zu fünf Jahren abgeschrieben werden.

Auf die Darstellung von Pro-forma-Finanzdaten wurde verzichtet, da die Akquisition keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat.

4. GRUNDKAPITAL

Infineon hatte am 30. September 2000 625.501.507 auf den Namen lautende Stückaktien, die einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,00 pro Aktie besitzen.

Genehmigtes und bedingtes Kapital

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Insgesamt bestehen drei Genehmigte Kapitalien (Genehmigtes Kapital I bis III), die bis zum 31. März 2004 durch Ausgabe neuer Aktien ausgeübt werden können.

- Das Genehmigte Kapital I ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 120.000 durch Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. In bestimmten Fällen kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden.
- Das Genehmigte Kapital II ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 120.000 durch Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage zum Zwecke der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
- Das Genehmigte Kapital III ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 237.582 durch Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Gemäß Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 96.000 bedingt erhöht („Bedingtes Kapital I“). Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 48 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung jeweils ab dem Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe und nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten unter diesem Aktienoptionsplan von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen (siehe Anmerkung 26). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Gemäß Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 50.000 durch Ausgabe von bis zu 25 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Ermächtigung bis zum 30. November 2004 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft begeben werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Kapitalmaßnahmen

Die anfängliche Eigenkapitalausstattung bei der Gründung von Infineon erfolgte durch die Ausgabe von 200.000.000 auf den Namen lautender Stückaktien und einem Nennkapital von EUR 400.000. Die Hauptversammlung der Gesellschaft bevollmächtigte am 8. Dezember 1999 den Vorstand, weitere 200.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 400.000 auszugeben. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln. Am 9. Februar 2000 hat die Hauptversammlung der Gesellschaft dem Vorstand die Ausgabe weiterer 200.000.000 auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 400.000 genehmigt. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln. Am 26. Januar 2000 und am 14. Februar 2000 wurden die

Kapitalerhöhungen in das Handelsregister eingetragen und rückwirkend zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft im Konzernabschluss dargestellt. Demzufolge beziehen sich alle Aussagen bezüglich der Anzahl der auf den Namen lautenden Stückaktien und der Informationen je Aktie bis zum Börsengang auf die genehmigten und ausgegebenen 6000.000.000 Aktien.

Am 13. März 2000 hat Infineon die Erstplatzierung von 16.700.000 auf den Namen lautende Stückaktien, die an der Frankfurter Börse gehandelt bzw. entsprechender American Depository Shares, die an der New Yorker Börse gehandelt werden, erfolgreich abgeschlossen. Der Kapitalzufluss nach Abzug von Emissionskosten daraus betrug EUR 562.035.

Im Rahmen einer Privatplatzierung hat die Gesellschaft im März 2000 7.592.430 auf den Namen lautende Stückaktien an die Intel Corporation („Intel“) ausgegeben und daraus EUR 258.826 Erlöst. Gemäß den Regelungen dieser Beteiligungsvereinbarung hat Intel sich verpflichtet, nur im begrenztem Umfang Aktien in einer bestimmten Periode zu veräußern.

Infineon hat am 25. April 2000 den Geschäftsbetrieb von Savan gegen Gewährung von 1.209.077 Aktien aus dem genehmigten Kapital III erworben (siehe Anmerkung 3).

Nach dem deutschen Aktiengesetz beruht der Betrag, der zur Dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfügung steht, auf dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft, Infineon Technologies AG, der nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches ermittelt wird. Für das Berichtsjahr hat der Vorstand eine Ausschüttung von EUR 406.576 als Dividende an die Aktionäre vorgeschlagen, die unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre steht.

Aus der am 13. Oktober 1999 von der Infineon-Beteiligungsgesellschaft proMOS Technologies Inc., Taiwan, durchgeführten Platzierung von 150.000.000 jungen Aktien ergab sich ein Verwässerungseffekt für Infineon. Infineons Anteil am Grundkapital verringerte sich auf 33,6%, wohingegen Infineons wertmäßiger Anteil am Eigenkapital um EUR 51.212 stieg. Gemäß SEC Staff Accounting Bulletin („SAB“) Topic 5:H, „Accounting for Sales of Stock by a Subsidiary“ hat Infineon den Betrag direkt in das Eigenkapital eingestellt, da zu diesem Zeitpunkt die Realisierung dieses Gewinns noch nicht hinreichend gesichert erschien.

5. ERGEBNIS JE AKTIE

SFAS 128 „Gewinne je Aktie“, fordert die Darstellung des Ergebnisses (Gewinn/Verlust) je Aktie sowie des verwässerten Ergebnisses je Aktie („EPS“). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Ergebnis, geteilt durch den gewogenen Mittelwert der während des Jahres ausstehenden Aktien. Bei dem verwässerten Ergebnis je Aktie wird der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die Anzahl der zusätzlichen Stückaktien erhöht, die ausstünden, falls potenziell verwässernde Stückaktien ausgegeben worden wären.

Ermittlung des Ergebnisses je Aktie sowie des verwässerten Ergebnisses je Aktie für die Jahre 1998, 1999 und 2000:

	1998	1999	2000
Zähler:			
Konzernjahresüberschuss (-fehlbetrag)	(774.688)	60.636	1.125.585
Nenner:			
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien - unverwässert	600.000.000	600.000.000	613.862.876
Verwässerungseffekt durch Aktienoptionen	-	-	1.258.310
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien - verwässert	600.000.000	600.000.000	615.121.186
Gewinn (Verlust) je Aktie (in Euro):			
Unverwässert	(1.29)	0.10	1.83
Verwässert	(1.29)	0.10	1.83

6. WERTPAPIERE

Die Wertpapiere setzten sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	30. SEPTEMBER 1999				30. SEPTEMBER 2000			
	ANSCHAFFUNGS- KOSTEN	MARKT- WERT	UNREALISIERTE GEWINNE	UNREALISIERTE VERLUSTE	ANSCHAFFUNGS- KOSTEN	MARKT- WERT	UNREALISIERTE GEWINNE	UNREALISIERTE VERLUSTE
Deutsche Staatsanleihen	32.246	31.744	-	(502)	6.327	5.933	-	(394)
Ausländische Staatsanleihen	65.400	64.599	873	(1.674)	21.002	21.033	867	(836)
Variabel verzinsliche Anleihen	-	-	-	-	451.407	452.699	1.292	-
Sonstige Gläubigerpapiere	15.387	15.387	-	-	2.144	2.144	-	-
Summe Gläubigerpapiere	113.033	111.730	873	(2.176)	480.880	481.809	2.159	(1.230)
Anteilsbriefe	62.702	60.306	1.187	(3.583)	15.012	27.042	13.212	(1.182)
Summe Wertpapiere	175.735	172.036	2.060	(5.759)	495.892	508.851	15.371	(2.412)
Ausgewiesen als:								
Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	485.601	497.712	14.523	(2.412)
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anmerkung 11)	175.735	172.036	2.060	(5.759)	10.291	11.139	848	-
Summe Wertpapiere	175.735	172.036	2.060	(5.759)	495.892	508.851	15.371	(2.412)

Die realisierten Gewinne aus Wertpapieren betragen EUR 510 in 1998, EUR 521 in 1999 und EUR 20.238 in 2000.

Die Gläubigerpapiere zum 30. September 2000 werden vertragsgemäß wie folgt fällig:

	ANSCHAFFUNGSKOSTEN	MARKTWERT
Innerhalb eines Jahres	10.742	11.506
Zwischen ein und fünf Jahren	451.616	452.923
Nach fünf Jahren	18.522	17.380
	480.880	481.809

Die tatsächlichen Fälligkeiten können aufgrund von Veräußerungs- oder Rückzahlungsrechten abweichen.

7. FORDERUNGEN GEGEN DRITTE

Die Forderungen gegen Dritte setzten sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.004	1.180.229
Steuerforderungen	152.872	196.417
Sonstige Vermögensgegenstände	42.043	40.613
Forderungen, brutto	824.919	1.417.259
Wertberichtigungen	(22.699)	(31.441)
	802.220	1.385.818

Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt:

	1999	2000
Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahres	21.454	22.699
Zuführung zu Wertberichtigungen	1.012	17.410
Inanspruchnahme von Wertberichtigungen	(478)	(10.382)
Fremdwährungseffekte	711	1.714
Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahres	22.699	31.441

8. VORRÄTE

Die Vorräte setzten sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.459	84.485
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	381.995	417.022
Fertige Erzeugnisse und Waren	257.518	339.307
Vorräte Gesamt	676.972	840.814

9. SACHANLAGEN

Eine Zusammenfassung der Sachanlagen sowie der Zu- und Abgänge zum 30. September 2000 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKS- GLEICHE RECHTE UND BAUTEN	TECHNISCHE ANLAGEN UND MASCHINEN	ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTS- AUSSTATTUNG	GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU	GESAMT
Anschaffungskosten					
30. September 1999	746.605	3.444.448	1.254.528	209.531	5.655.112
Zugänge	32.128	527.067	235.314	801.091	1.595.600
Abgänge	(13.449)	(126.811)	(70.786)	—	(211.046)
Umbuchungen	6.499	149.829	46.155	(202.483)	—
Fremdwährungseffekte	57.203	183.161	54.358	22.766	317.488
30. September 2000	828.986	4.177.694	1.519.569	830.905	7.357.154
Kumulierte Abschreibungen					
30. September 1999	(240.618)	(1.599.931)	(801.008)	—	(2.641.557)
Zugänge	(47.408)	(501.786)	(231.249)	—	(780.443)
Abgänge	3.686	100.381	66.259	—	170.326
Fremdwährungseffekte	(7.057)	(39.989)	(24.077)	—	(71.123)
September 30, 2000	(291.397)	(2.041.325)	(990.075)	—	(3.322.797)
Buchwert 30. September 1999	505.987	1.844.517	453.520	209.531	3.013.555
Buchwert 30. September 2000	537.589	2.136.369	529.494	830.905	4.034.357

Die Gesellschaft ist Leasinggeber von technischen Anlagen und Maschinen (siehe Anmerkung 17), deren Restbuchwerte hierfür betragen zum 30. September 1999 und 2000 jeweils EUR 223.451 und EUR 220.912 bei korrespondierenden kumulierten Abschreibungen in Höhe von jeweils EUR 118.960 und EUR 141.285.

10. FINANZANLAGEN

Die Finanzanlagen haben sich in dem am 30. September 2000 endenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	ASSOZIIERTE UNTERNEHMEN	BETEILIGUNGEN	GESAMT
Stand 30. September 1999	107.656	22.780	130.436
Zugänge	25.684	59.780	85.464
Anteilige Jahresergebnisse assoziierten Unternehmen	101.303	—	101.303
Dividenden und sonstige Kapitalrückführungen	(19.074)	—	(19.074)
Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen	104.637	—	104.637
Sonstige	—	(10.052)	(10.052)
Fremdwährungseffekte	38.338	1.239	39.577
Stand 30. September 2000	358.544	73.747	432.291

Investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit dem Ziel, das Zukunftspotenzial von Infineon bei geistigen Eigentumsrechten zu stärken.

Die folgenden assoziierten Unternehmen wurden zum 30. September 2000 nach der Equity-Methode bilanziert.

NAMEN DER ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN	ANTEILE
ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan („ProMOS“)	33,0%
Semiconductor 300 GmbH & Co. KG, Dresden („SC300“)	50,1%
ALTIS Semiconductor, Frankreich („ALTIS“)	50,1%
OSRAM Unternehmensverwaltungs GmbH und OSRAM Opto Semiconductor GmbH & Co. OHG, Regensburg (zusammen „OSRAM Opto“)	49,0%

Infineon hat diese Beteiligungen nach der Equity-Methode bilanziert, weil keine einheitliche Leitung von Infineon ausgeübt worden ist. Die oben aufgeführten Gesellschaften sind vorwiegend mit Forschung, Entwicklung, Entwurf und Fertigung von Halbleiterprodukten, integrierten Schaltkreisen und damit im Zusammenhang stehenden Produkten befasst.

ProMOS, eine taiwanische börsennotierte Gesellschaft, ist im Mehrheitsbesitz von Mosel Vitelic, Inc. und Infineon. Diese Beteiligung wird abzüglich abgegrenzter Erträge aus Lizenzen und Know-how-Überlassungsverträgen bilanziert (siehe Anmerkung 21). Am 13. Oktober 1999 führte ProMOS einen Börsengang mit der Ausgabe von 150.000.000 jungen Aktien durch. Daraus ergab sich ein Verwässerungseffekt für Infineon. Der Anteil am Grundkapital verringerte sich auf 33,6%, während der wertmäßige Anteil am Eigenkapital um EUR 51.212 stieg. Am 22. Mai 2000 genehmigten die Aktionäre von ProMOS ein Mitarbeiterbonusprogramm, das die Ausgabe von 50.683.800 ProMOS-Gratisaktien vorsieht. Im Ergebnis dieser Kapitalerhöhung wurde der Anteil von Infineon nochmals auf 33,0% verwässert. Der wertmäßige Anteil am Eigenkapital erhöhte sich um EUR 53.425. Im Zusammenhang mit einem Börsengang von ProMOS in 1999 verkaufte Infineon 0,8% seiner Anteile. Daraus ergab sich ein Veräußerungsgewinn von EUR 15.319, der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen Erträgen im Geschäftsjahr 1999 ausgewiesen wurde.

Infineon und Motorola gründeten in 1998 das Joint Venture Semiconductor 300 („SC300“), an dem Motorola einen Anteil von 49,9% hält (siehe Anmerkung 30). Am 4. April 2000 schlossen Infineon sowie eine im Besitz der öffentlichen Hand befindliche Gesellschaft und ein Anlagenbauer Verträge mit dem Zweck, eine 300mm Wafer-Fabrik in Deutschland zu errichten („FoF“). Infineon hat einen Vertrag mit der Anlagenbaugesellschaft über die Errichtung der Fabrik unterzeichnet. In Zusammenhang mit der Gründung der FoF brachte Infineon ihren Anteil von 50,1% an der SC300 sowie Barmittel in Höhe von EUR 94.603, die Partner brachten Barmittel in Höhe von EUR 168.726 für einen rückgewährbaren Anteil an dem Joint Venture ein, wie nachfolgend beschrieben.

Der FoF-Vertrag gibt jedem der anderen Partner das Recht, seine Anteile an der FoF erstmals zum 30. September 2005 und zu jeweils drei Jahre später liegenden Zeitpunkten zu verkaufen. Infineon ist berechtigt, die Anteile, beginnend mit dem am

31. März 2004, jeweils alle drei Jahre von den Partnern zu erwerben. Ferner haben die Partner unter bestimmten Bedingungen das Recht ihre Anteile an Infineon zu veräußern, wie z.B. Kapitalerhöhungen, denen sie nicht zustimmen, dem Eintritt neuer Gesellschafter, deutliche Überschreitung der Planungen und wenn Infineon die Kontrolle über die Gesellschaft abgibt. Bei Ausübung ihrer Optionen ist den Partnern ihre ursprüngliche Einlage zzgl. einer jährlichen Verzinsung zwischen 11% und 15% zu zahlen. Daraus folgend sind diese rückgewährbaren Anteile als langfristige Verbindlichkeiten in der Konzernbilanz ausgewiesen (siehe Anmerkung 15). Der Tageswert der Verbindlichkeit ist um den Zinsanteil erhöht, der zu zahlen wäre, wenn die Beteiligung zurückgekauft würde, so dass die bilanzierte Verbindlichkeit dem Rückkaufwert entspricht.

Die Gesellschaft hat eine Rückbürgschaft zugunsten der im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Partnergesellschaft für gewährte Garantien zugunsten des Joint Ventures gegeben und wird dem Joint Venture das bestehende Darlehen von EUR 92.000 zu Marktkonditionen verlängern.

Entsprechend der Hinweise aus Emerging Issues Task Force Issue No. 00-4 und anderer einschlägiger Literatur hat die Gesellschaft die FoF seit ihrer Gründung in den Konzernabschluss einbezogen und ihre Aufwendungen und Erträge (im Wesentlichen Planungs- und Entwicklungskosten) in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

ALTIS, ein Joint Venture von IBM und Infineon, wurde mit Wirkung zum 12. Juli 1999 gegründet. Beide Gesellschafter besitzen gleiche Stimmrechte. Entsprechend dem ALTIS-Gesellschaftsvertrag leistete Infineon am 31. Dezember 1999 eine Einlage von EUR 24.800 gegen Gewährung von 2.480.000 Aktien, so dass der Anteil der Gesellschaft an ALTIS Semiconductor weiterhin 50,1% beträgt.

OSRAM Opto ist ein Joint Venture von Infineon und OSRAM, einem Siemens Bereich. OSRAM Opto steht unter der einheitlichen Leitung von Siemens. Für die zusammengefasst dargestellten Finanzdaten wird die Gesellschaft so berücksichtigt, als ob sie in allen Berichtsperioden in ihren jetzigen Form mit den derzeitigen Eigentumsverhältnissen bestanden hätte.

Die zusammengefassten Finanzdaten der assoziierten Unternehmen für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000 stellen sich wie folgt dar:

	1998	1999 ⁽¹⁾	2000
Umsatzerlöse	428.325	1.136.143	1.684.472
Bruttoergebnis vom Umsatz	24.652	279.808	515.192
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	(283.121)	91.558	291.157
		1999	2000
Umlaufvermögen		447.461	955.568
Anlagevermögen		1.143.293	1.887.828
Kurzfristige Verbindlichkeiten		(514.789)	(973.144)
Langfristige Verbindlichkeiten		(569.941)	(332.008)
Eigenkapital		506.024	1.538.244

⁽¹⁾ Einschließlich Umsatzerlöse, Bruttoergebnis vom Umsatz und Jahresüberschuss (-fehlbetrag) von White Oak in Höhe von jeweils EUR 385.339, EUR 35.085 und EUR (17.946).

11. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Immaterielle Vermögensgegenstände	60.494	221.759
Geleistete Anzahlungen (Anmerkung 24)	78.543	—
Wechselforderungen	48.728	5.902
Wertpapiere des Anlagevermögens (Anmerkung 6 und 19)	172.036	11.139
Sonstige	40.570	14.605
	400.371	253.405

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2000 wie folgt zusammen:

	FIRMENWERT	SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	GESAMT
Anschaftungskosten			
30. September 1999	5.197	193.475	198.672
Zugänge	126.824	79.296	206.120
Fremdwährungseffekte	6.951	1.044	7.995
30. September 2000	138.972	273.815	412.787
Kummulierte Abschreibungen			
30. September 1999	(2.329)	(135.849)	(138.178)
Zugänge	(8.225)	(43.139)	(51.364)
Fremdwährungseffekte	(790)	(696)	(1.486)
30. September 2000	(11.344)	(179.684)	(191.028)
Buchwert 30. September 1999	2.868	57.626	60.494
Buchwert 30. September 2000	127.628	94.131	221.759

12. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DRITTEN

Die Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.945	766.439
Steuerverbindlichkeiten	54.617	80.803
Sonstige	1.139	1.997
	434.701	849.239

13. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Steuern	29.755	342.047
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	87.119	121.247
Gewährleistungen und Lizenzen	51.001	141.949
Sonstige	75.269	113.538
	243.144	718.781

14. SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	113.600	183.463
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten	—	63.728
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	20.262	12.682
Übrige	135.823	40.075
	269.685	299.948

15. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Pensionsrückstellungen (Anmerkung 19)	147.541	41.034
Abgegrenzte Investitionszulagen	72.893	21.802
Abgegrenzte Erträge aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen (Anmerkung 21)	138.045	13.643
Rückgewährbare Einlagen (Anmerkung 10)	—	175.715
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	24.756	—
Sonstige	31.193	34.528
	414.428	286.722

Die angegebenen Verbindlichkeiten mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen haben eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahren.

16. FINANZVERBINDLICHKEITEN

Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Durchschnittzinssatz 4,0%	48.642	111.150
Verbindlichkeiten gegenüber Siemens, Durchschnittzinssatz 5,4%	422.027	—
Kurzfristige Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	23.936	27.200
	494.605	138.350
Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
Unbesicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittzinssatz 2,6%, fällig 2001-2007	28.113	31.224
Zinsfreie Darlehen, fällig 2000-2004	52.645	41.834
Sonstige Darlehen, Durchschnittzinssatz 4,0%, fällig 2000 – 2003	22.671	16.602
Darlehen der öffentlichen Hand, Zinssatz 4,3%, fällig 2027	31.593	38.312
	135.022	127.972

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen hauptsächlich aus Ausleihungen im Rahmen von kurzfristigen Darlehensvereinbarungen. Finanzverbindlichkeiten gegenüber Siemens im Vorjahr betrafen von White Oak aufgenommene Darlehen. Diese Finanzverbindlichkeiten wurden am 30. März 2000 aus Mittelfrüßen durch den Börsengang zurückgezahlt. Das zinsfreie Darlehen (fällig in 2000 bis 2004) betrifft Ausleihungen, bei denen die öffentliche Hand die gesamte Zinslast trägt. Darüber hinaus übernimmt die öffentliche Hand 75% der Darlehensrückzahlungen, falls Infineon bestimmte Bedingungen erfüllt. Da ungewiss ist, ob Infineon diese Bedingungen erfüllen wird, wird dieses Darlehen bis zum Eintritt der auflösenden Bedingungen voll passiviert. Bei Erfüllung der Bedingungen wird das Darlehen um den Beitrag der öffentlichen Hand reduziert.

Ein Beteiligungsunternehmen der Infineon AG hatte zum 30. September 1999 ein Bankdarlehen in Höhe von EUR 792.502, das durch eine hinterlegte Bareinlage der Obergesellschaft in gleicher Höhe, mit gleichen Zins- und Fälligkeitsbedingungen bei dem selben Kreditinstitut besichert war. Dabei war die Nutzung der Einlage auf die Höhe des Restwertes des Darlehens beschränkt. Dieses Darlehen sowie die hinterlegte Bareinlage

wurden in Übereinstimmung mit der FASB Interpretation Nr. 39, „Saldierung von Beträgen bestimmter Verträge“ miteinander verrechnet und haben einen Nullausweis zur Folge. Infineon erhielt für dieses Darlehen Zinszuschüsse der öffentlichen Hand. Diese Zinszuschüsse wurden abgegrenzt und von den Zinsaufwendungen in dem Berichtszeitraum abgesetzt, in welchem die zugrunde liegenden Zinsaufwendungen für das Bankdarlehen bilanziert wurden. Am 29. September 2000 erfolgte die Rückzahlung des Bankdarlehens und die Auflösung der hinterlegten Bareinlage. Entsprechend wurde im Geschäftsjahr der abgegrenzte Betrag in Höhe von EUR 62.161 realisiert und mit den Zinsaufwendungen verrechnet.

Im März 2000 hat die Gesellschaft mit einem Bankenkonsortium eine revolvingende Mehrwährungskreditlinie über EUR 750.000 vereinbart. Die Kreditlinie ist in zwei gleich hohe Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von vier Jahren, die zweite hat eine verlängerbare Laufzeit von 364 Tagen. Die Tranchen können u.a. in EUR oder U.S. Dollar gezogen werden. Die variable Verzinsung orientiert sich an einem variablen Referenzsatz zuzüglich einer Marge. Diese Marge wird bestimmt von der Höhe der Inanspruchnahme der Kreditlinie sowie dem Niveau der Finanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („Senior Debt Ratio“). Für diese Kreditlinie wurden verschiedene Verpflichtungen und Bedingungen vereinbart, u.a. die Einhaltung eines „Minimum tangible net worth“, einer bestimmten „Senior debt ratio“ und eines bestimmten Zinsdeckungsgrades. Zum 30. September 2000 wurde die Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Darüber hinaus hatte die Gesellschaft zum 30. September 2000 nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von insgesamt EUR 307.842.

Von den als langfristig aufgenommenen Finanzverbindlichkeiten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fällig: in 2001 EUR 27.200, in 2002 EUR 26.038, in 2003 EUR 28.363, in 2004 EUR 16.675, in 2005 13.496 und in den Folgejahren EUR 43.400.

17. VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Infineon unterhält übliche Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen des Siemens-Konzerns und zu den sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (im folgenden als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet). Infineon bezieht bestimmte Vorprodukte, insbesondere Chipsätze von verbundenen Unternehmen. Zugleich verkauft Infineon auch einen Teil der Produktion an verbundenen Unternehmen. Diese Käufe und Verkäufe an verbundene Unternehmen orientieren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an Herstellungskosten zzgl. einer Gewinnmarge.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	63.265	104.409
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	24.740	62.393
Finanzforderungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	678.808	49.295
Finanzforderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	176.107	216.178
Forderungen gegen Arbeitnehmer	5.744	6.850
	948.664	439.125

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1999	2000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	45.504	92.055
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	109.116	265.032
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns	337.813	7.594
Finanzverbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen	35.489	8.704
	527.922	373.385

Bei den Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wird wie folgt unterschieden: (1) Positionen, bei denen entweder von oder an Siemens-Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, an denen Infineon Geschäftsanteile hält, geschuldet wird und (2) nach dem zugrundeliegenden Geschäftsvorfall. Die als Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren aus dem Verkauf bzw. Kauf von Produkten. Finanzforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten die geschuldeten Beträge aus Darlehen sowie die aufgelaufenen Zinsen zu Interbankensätzen. Am 1. Oktober 1999 wurden die Verrechnungskonten mit Siemens ausgeglichen. Bei der Saldierung der Finanzforderungen in Höhe von EUR 678.808 und Finanzverbindlichkeiten in Höhe von EUR 337.813 ergab sich hieraus eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes um EUR 340.995.

Darstellung des Geschäftsverkehrs mit verbundenen Unternehmen für die zum 30. September 1998, 1999 und 2000 endenden Geschäftsjahre:

	1998	1999	2000
Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	794.413	963.251	1.089.022
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	59.370	110.783	121.593
Bezüge von verbundenen Unternehmen			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	343.911	260.107	424.324
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	410.199	841.631	1.183.378
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	16.667	21.788	14.437
Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen	32.644	15.510	21.396

Die Umsätze mit Unternehmen des Siemens-Konzerns beinhalten Verkäufe an Siemens Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte, die sich in den Geschäftsjahren 1998, 1999 und 2000 auf jeweils EUR 267.998, EUR 366.730 und EUR 326.356 beliefen, für die Siemens Vertriebsorganisationen eine Spanne von 7% bis 9% erhalten. Infineon least an das Gemeinschaftsunternehmen ALTIS technische Anlagen und Maschinen (siehe Anmerkung 9). Aus den unkündbaren Leasingverträgen erwartet die Gesellschaft Leasingzahlungen für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 von jeweils EUR 31.900, für 2003 EUR 23.800 und für 2004 EUR 15.500.

Vor der Gründung von Infineon hat Siemens Dienstleistungen für Infineon erbracht und die Aufwendungen erfasst. Die Kosten solcher Dienstleistungen in den Bereichen Verwaltung, Datenverarbeitung, Personal, Recht, Steuern, Versicherungen, Finanzen und Rechnungswesen sind bei der Aufstellung der Finanzdaten von Infineon berücksichtigt worden. Für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 betragen die Verrechnungen hierfür jeweils EUR 41.767 und EUR 37.509. Den Verrechnungen lagen Dienstleistungsverträge zugrunde, die zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen wurden.

Die Berechnungsmethoden der Verrechnungsbeträge führen nach Ansicht des Managements zu verursachungsgerechten Leistungsentgelten, die auf erwarteten Nutzungszeiten, Mitarbeiterzahlen, Statistiken zu den jeweiligen Geschäftsvorfällen sowie sonstigen Daten beruhen. Nach Einschätzung des Managements entsprechen die Aufwendungen annähernd denen, die auch bei Infineon als selbständig operierende Gesellschaft angefallen wären.

Im Zuge der Gründung hat Infineon einen Dienstleistungsvertrag mit Siemens abgeschlossen, um weiterhin bestimmte Verwaltungsdienstleistungen zu beziehen. Die anfängliche Laufzeit dieses Vertrages beträgt zwei Jahre und führt zu Zahlungen von Infineon in 1999 in Höhe von EUR 1.023 und in 2000 in Höhe von EUR 1.176. Zusätzlich wurden mit Gesellschaften des Siemens-Konzerns Vereinbarungen abgeschlossen, um Kommunikationsdienstleistungen, Umzugsdienste, Informationstechnologie, Logistik und ähnliche Dienstleistungen zu beziehen, die nach Umfang der jeweiligen Inanspruchnahme zu marktüblichen Konditionen berechnet werden.

18. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der Gewinn (Verlust) vor Steuern und vor Abzug der auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile verteilt sich in den Geschäftsjahren 1998, 1999 und 2000 wie folgt auf die Regionen:

	1998	1999	2000
Deutschland	(1.676.639)	(111.849)	1.297.902
Ausland	(4.090)	142.191	446.295
	(1.680.729)	30.342	1.744.197

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ermitteln sich für die zum 30. September 1998, 1999 und 2000 endenden Geschäftsjahre wie folgt:

	1998	1999	2000
Laufender Steueraufwand			
Deutschland	6.993	10.668	448.496
Ausland	13.892	25.125	73.161
	20.885	35.793	521.657
Latente Steuern			
Deutschland	(898.023)	(66.968)	109.642
Ausland	(30.021)	1.066	(18.830)
	(928.044)	(65.902)	90.812
Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(907.159)	(30.109)	612.469

Das deutsche Körperschaftsteuerrecht besteuert einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne mit unterschiedlichen Steuersätzen. Entsprechend den für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000 gültigen Regelungen werden einbehaltene Gewinne mit einem Körperschaftsteuersatz für 1998 von 45%, für 1999 und 2000 von 40% zzgl. eines Solidaritätszuschlages von jeweils 5,5% auf die Körperschaftsteuerschuld besteuert. Insgesamt beträgt die Steuerbelastung damit für die Geschäftsjahre 1998 47,5%, 1999 und 2000 jeweils 42,2% zzgl. der bei der für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer abzugsfähigen Gewerbesteuerbelastung von 9,5% für 1998 und 9,8% jeweils für 1999 und 2000.

Bei Ausschüttung eines Bilanzgewinns an die Aktionäre wird die Ausschüttungsbelastung mit Körperschaftsteuer in Höhe von 30% zzgl. eines Solidaritätszuschlages von 5,5% hergestellt, so dass sich für 1998, 1999 und 2000 im Ausschüttungsfall eine Gesamtbelastung von 31,65% ergibt. Die Verringerung der Steuerbelastung für Infineon erfolgt durch Rückerstattung zuvor gezahlter Steuern (Körperschaftsteuerminderung zur Herstellung der Ausschüttungsbelastung).

Die nachfolgende Abstimmung der Erträge aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zum 30. September 1998, 1999 und 2000 erfolgte unter Zugrundelegung einer Gesamtsteuerbelastung der deutschen Körperschaftsteuerquote für 1998 in Höhe von 57%, für 1999 und 2000 in Höhe von 52% wie folgt:

	1998	1999	2000
Erwarteter Aufwand (Ertrag) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(958.015)	15.778	906.982
Herstellung der Ausschüttungsbelastung	—	—	(58.100)
Steuerfreie Erträge	(7.868)	(3.242)	(3.699)
Differenz aus abweichenden Steuersätzen im Ausland	6.466	(65.726)	(149.908)
Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen	85	3.172	721
Nicht berücksichtigungsfähige Verluste (Erträge)	47.051	(18.546)	(74.933)
Veränderung des Steuersatzes	—	12.654	—
Veränderung der Wertberichtigung	5.589	18.282	(27.834)
Sonstige	(467)	7.519	19.240
Tatsächlicher Aufwand (Ertrag) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(907.159)	(30.109)	612.469

Die nachstehende Aufstellung zeigt die aktiven und passiven latenten Steuern zum 30. September 1999 und 2000:

	1999	2000
Immaterielle Vermögensgegenstände	33.400	7.370
Sachanlagen	13.297	22.188
Beteiligungen	35.387	35.387
Forderungen	5.779	6.960
Sonstige Vermögensgegenstände	4.119	16.918
Vorräte	16.526	65.901
Jahresfehlbetrag und Verlustvortrag	145.173	99.395
Pensionsrückstellungen	11.050	26.896
Sonstige Verbindlichkeiten	26.540	13.959
Rückstellungen	8.137	9.898
Passive Rechnungsabgrenzung	204.213	105.092
Bruttobetrag der aktiven latenten Steuern	503.621	409.964
Wertberichtigungen	(29.410)	(1.576)
Aktive latente Steuern	474.211	408.388
Sachanlagen	296.159	275.401
Finanzanlagen	3.299	31.836
Vorräte	23.966	16.737
Forderungen	21.145	6.362
Sonstige Vermögensgegenstände	3.099	3.207
Sonstige Verbindlichkeiten	6.353	9.905
Rückstellungen	22.005	51.011
Passive latente Steuern	376.026	394.459
Aktive latente Steuern, Saldo	98.185	13.929

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden in den Konzernbilanzen zum 30. September 1999 und 2000 wie folgt ausgewiesen:

	1999	2000
Aktive latente Steuern		
kurzfristig fällig	54.159	100.407
langfristig fällig	314.342	165.601
Passive latente Steuern		
kurzfristig fällig	(79.655)	(74.634)
langfristig fällig	(190.661)	(177.445)
	98.185	13.929

Infineon hat bei der Aufstellung des vorliegenden Konzernabschlusses die steuerlichen Ansprüche und Verpflichtungen so ermittelt, als ob Infineon ein selbständiges Steuersubjekt gewesen wäre. Zum 30. September 1998 und 1999 weist Infineon Erträge aus latenten Steuern in Höhe von EUR 928.044 und EUR 65.902 aus. Diese Erträge wurden in einen Umfang berücksichtigt, bei dem es eher wahrscheinlich ist als nicht, dass diese künftig realisiert werden. Diese Betrachtungen schließen – entsprechend dem deutschen Steuerrecht – die Möglichkeit ein, entstandene steuerliche Verluste vorzutragen und diese dabei unbegrenzt auf Basis der Steuerplanungen und der erwarteten künftigen steuerbaren Einkommen gegen in der Zukunft zu versteuernde Gewinne zu verrechnen.

Infineon weist für das Geschäftsjahr 1998 sowie für den Zeitraum vom 1. Oktober 1998 bis 31. März 1999 nach deutschem Recht steuerliche Verluste in Höhe von EUR 1.607.056 und EUR 358.865 aus. Diese steuerlichen Verluste stellen weder steuerliche Verlustvorträge dar, noch haben sie zum 30. September 1998 und 1999 die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern zur Folge, da diese Verluste zu einer Zeit angefallen sind, als die Geschäftstätigkeit von Infineon in Deutschland ein Geschäftsbereich von Siemens war. Deshalb wurden diese steuerlichen Verlustvorträge von Siemens genutzt. Insoweit werden die darauf entfallenden latenten Steuererträge (in den Geschäftsjahren 1998 EUR 907.556, 1999 EUR 180.832) nicht als Vermögensposten von Infineon ausgewiesen sondern im Eigenkapital verrechnet.

Zum 30. September 1998, 1999 und 2000 hatten Infineon und ihre Tochtergesellschaften steuerliche Verlustvorträge in Höhe von jeweils EUR 47.945, EUR 177.743 und EUR 46.289 sowie Vorträge von Steuerforderungen in Höhe von jeweils EUR 62.806, EUR 57.449 und EUR 82.152. Diese steuerlichen Verlustvorträge und Steuerforderungen resultieren aus der Geschäftstätigkeit in Deutschland sowie im Ausland und sind grundsätzlich insoweit nur durch die Gesellschaft nutzbar, bei welcher die steuerlichen Verluste oder die Steuerforderungen entstanden sind, und nach derzeitigem Stand der Gesetzgebung zeitlich unbeschränkt nutzbar.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern vermindert, da sich die Erwartungen des Managements bezüglich der Realisierbarkeit steuerrechtlicher Verlustvorträge in Auslandsgesellschaften verändert haben.

Infineon hat zum 30. September 1998, 1999 und 2000 auf kumulierte einbehaltene Gewinne ausländischer Gesellschaften keine zusätzlichen Ertrag- oder Quellensteuern berechnet, da diese Gewinne in den Auslandsgesellschaften nicht zur Ausschüttung vorgesehen sind. Eine betragsmäßige Schätzung der nicht berücksichtigten passiven latenten Steuern auf diese einbehaltene Gewinne ist nicht zweckmäßig.

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000 wurden im Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und im Eigenkapital unter der Position „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Gesellschaftern resultieren“ erfasst. Die im Eigenkapital verrechneten Beträge für unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren beliefen sich in den Jahren 1998, 1999 und 2000 auf EUR (53), EUR 1.965 und EUR (7.945).

Im Oktober 2000 hat die Bundesregierung Änderungen steuerrechtlicher Regelungen verabschiedet. Neben anderen Änderungen wird der Körperschaftsteuersatz der bisher mit 40% für einbehaltene Gewinne und mit 30% auf ausgeschüttete Gewinne berechnet

wurde, auf einen einheitlichen Satz von 25% verringert. Für Infineon wird die Gesetzesänderung erstmals in dem am 30. September 2002 endenden Geschäftsjahr wirksam. Gemäß SFAS Nr. 109 „Bilanzierung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ wird Infineon die Auswirkungen der Änderungen steuerrechtlicher Regelungen bei der Ermittlung der latenten Steuern erstmals im Geschäftsjahr 2001 berücksichtigen. Das Management erwartet, dass die Berücksichtigung der Änderungen steuerrechtlicher Regelungen, die zum 30. September 2001 erfolgen wird, bezogen auf die Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern zum 30. September 2000 eine Minderung der Steueraufwendungen in Höhe von ca. EUR 23.534 nach sich ziehen würde.

19. PENSIONSVERPFLICHTUNGEN

Infineon hat einer Reihe ihrer Mitarbeiter Pensionszusagen gewährt. Die Pensionszusagen richten sich im Wesentlichen nach der Betriebszugehörigkeit. Ein Teil der Altersversorgungspläne bezieht sich auf das Einkommen im letzten oder in den letzten fünf Jahren der Betriebszugehörigkeit, andere, feste Versorgungspläne, sind vom durchschnittlichen Einkommen und der Position abhängig.

Die Daten zu den Pensionsplänen von Infineon sind für die deutschen Versorgungspläne („Inland“) und die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 30. September 1998, 1999 und 2000 in der folgenden Tabelle dargestellt:

	1998		1999		2000	
	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND
Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO)						
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Beginn des Geschäftsjahres	(143.534)	(37.567)	(159.498)	(42.216)	(147.681)	(19.495)
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	(8.539)	(2.566)	(9.109)	(1.191)	(10.443)	(5.840)
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	(8.612)	(2.167)	(9.570)	(802)	(9.018)	(3.181)
Versicherungstechnische Gewinne oder Verluste	(83)	34	(4.766)	–	(3.911)	(867)
Akquisitionsbedingte Zugänge	–	–	–	–	(338)	(614)
Übertragung von Pensionsverpflichtungen	–	–	33.001	24.714	14	421
Gezahlte Versorgungsleistungen	1.270	56	2.261	–	1.315	8
Fremdwährungseffekte	–	(6)	–	–	–	(4.992)
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Ende des Geschäftsjahres	(159.498)	(42.216)	(147.681)	(19.495)	(170.062)	(34.560)
Entwicklung des Zeitwertes des Planvermögens						
Zeitwert zu Beginn des Geschäftsjahres	–	4.622	–	5.116	–	5.640
Einlagen	–	–	–	–	154.696	3
Rendite auf das Planvermögen	–	494	–	524	–	2.144
Fremdwährungseffekte	–	–	–	–	–	1.560
Zeitwert am Ende des Geschäftsjahres	–	5.116	–	5.640	154.696	9.347
Finanzierungsstatus des Planvermögens						
Finanzierungsstatus des Planvermögens	(159.498)	(37.100)	(147.681)	(13.855)	(15.366)	(25.213)
Noch nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasster versicherungsmathematischer Gewinn	–	4.006	4.766	4.004	8.676	5.513
Noch nicht bilanzierte(s) Verpflichtungen (Vermögen) aus Übergang auf SFAS 87	6.944	1.343	5.208	(140)	3.472	(119)
Noch nicht zu bilanzierender Aufwand für die in Vorjahren erworbenen Versorgungsansprüche	–	181	–	157	–	169
Pensionsverpflichtungen	(152.554)	(31.570)	(137.707)	(9.834)	(3.218)	(19.650)

Die in der Bilanz zum 30. September ausgewiesenen Verpflichtungen setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	1998		1999		2000	
	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen	–	–	–	–	3.674	–
Als Sicherheitsleistung hinterlegte Zahlungsmittel	–	–	–	–	14.492	–
Pensionsverbindlichkeiten	(152.554)	(31.570)	(137.707)	(9.834)	(21.384)	(19.650)
Pensionsverpflichtungen	(152.554)	(31.570)	(137.707)	(9.834)	(3.218)	(19.650)

Der Ermittlung der versicherungsmathematischen Werte der wesentlichen

Versorgungspläne lagen folgende Annahmen zugrunde:

	1998		1999		2000	
	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND
Abzinsungsfaktor	6,0%	6,0%-7,5%	6,0%	7,5%	6,5%	7,8%
Personalkostensteigerungsrate	2,5%	2,0%-4,5%	2,5%	4,5%	3,5% - 3,8%	5,0%
Erwartete Rendite auf das Planvermögen		8,5%		8,5%		8,5%

Die Pensionsaufwendungen in den Geschäftsjahren 1998, 1999 und 2000 beinhalten:

	1998		1999		2000	
	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND	INLAND	AUSLAND
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	(8.539)	(2.566)	(9.109)	(1.191)	(10.443)	(5.840)
Zinsaufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	(8.612)	(2.167)	(9.570)	(802)	(9.018)	(3.181)
Ertrag aus Planvermögen	—	494	—	524	—	667
Amortisation von in Vorjahren erworbenen Versorgungsansprüchen	—	(24)	—	(24)	—	82
Amortisation von noch nicht realisierten Gewinnen	(83)	(133)	—	(127)	—	67
Amortisation des Unterschiedsbetrags bei Übergang auf SFAS 87	(1.736)	(334)	(1.736)	47	(1.737)	(203)
Sonstige	—	8	—	—	—	—
Aufwendungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen	(18.970)	(4.722)	(20.415)	(1.573)	(21.198)	(8.408)

Bei der Gründung von Infineon haben eine Reihe von Mitarbeitern ihr Recht ausgeübt, in dem Versorgungsplan von Siemens zu verbleiben. Als Ergebnis dieser Entscheidung reduzierten sich die Anwartschaftsbarwerte um EUR 33.001. Sie werden als Übertragung von Pensionsverbindlichkeiten dargestellt. Dabei wurde weder ein Gewinn noch ein Verlust ausgewiesen.

Vor 1999 hat Infineon Finanzanlagen erworben, um bestimmte ausländische Pensionsverpflichtungen abzusichern. Am 30. September 1998 wurden Wertpapiere mit einem Marktwert von EUR 11.500 gehalten. Im März 1999 löste Infineon diese Pensionsverpflichtungen mit EUR 18.573 ab. Daraus resultierte ein Ertrag in Höhe von EUR 4.388.

Im Juni 1999 leistete Infineon zur Deckung der Pensionsverpflichtungen gegenüber Mitarbeitern in Deutschland Einzahlungen in einen Investmentfonds in Höhe von EUR 165.699. Da diese Anlage nicht als Planvermögen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87 „Bilanzierung von Arbeitgeberbeiträgen zu Pensionen“ fiel, war sie unter den sonstigen langfristigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Am 25. September 2000 gründete die Gesellschaft den Infineon Technologies Pension Trust („Pension Trust“) zum Zwecke der Finanzierung zukünftiger Pensionszahlungen für Mitarbeiter in Deutschland. Die Gesellschaft leistete eine Einlage in Höhe von EUR 154.696 in Form von Zahlungsmitteln und Wertpapieren, die Gläubiger- bzw. Eigentümerrechte verbriefen. Die Einlage fällt als Planvermögen des Pension Trust zur Finanzierung dieser Pensionsverpflichtungen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87 und reduziert insoweit die Pensionsrückstellungen der Gesellschaft (siehe Anmerkung 15).

20. ZUWENDUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND

Infineon hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen öffentlichen Stellen Fördermittel u.a. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildungsmaßnahmen und Zinszuschüsse erhalten. Die in den vorliegenden Konzernabschlüssen enthaltenen Zuwendungen setzen sich zum 30. September 1998, 1999 und 2000 wie folgt zusammen:

	1998	1999	2000
In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind enthalten			
Zinszuschüsse	41.421	41.523	62.385
Forschungs- und Entwicklungszuschüsse	41.721	33.067	41.172
Sonstige Zuwendungen	13.466	17.789	11.090
	96.608	92.379	114.647
Investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der Sachanlagen abgesetzt wurden	29.154	642	123

21. LIZENZEN UND KNOW-HOW-ÜBERLASSUNGSVERTRÄGE

In den Geschäftsjahren 1998, 1999 und 2000 weist Infineon Umsätze aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von jeweils EUR 106.188, EUR 46.343 und EUR 175.759 in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung aus. Weiterhin erhielt Infineon Zahlungen in Höhe von EUR 171.681 von ProMOS, die mit dem Beteiligungsbuchwert von ProMOS verrechnet wurden (siehe Anmerkung 10).

Im März 2000 schloss Infineon einen neuen Lizenzvertrag mit ProMOS und passte den bestehenden Vertrag mit MVI, dem Mehrheitsgesellschafter von ProMOS, an. Im Rahmen dieser Verträge wurden Lizenzgebühren von \$108 Millionen neu terminiert, die über die Laufzeit der neuen Verträge realisiert werden. In Verbindung mit den veränderten vertraglichen Regelungen wurden in der Vergangenheit zugeflossene und abgegrenzte Lizenzgebühren in Höhe von EUR 138.045 als Umsatzerlöse realisiert, da Infineon alle Verpflichtungen erfüllt hatte und die Realisierung sichergestellt war.

Zum 30. September 1999 und 2000 weist Infineon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen MVI aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von EUR 39.005 aus. Die Forderungen sind durch Pfandrechte von Infineon an ProMOS-Aktien, die sich im Eigentum von MVI befinden, gesichert.

22. UMSTRUKTURIERUNGSMASSNAHMEN

Im Juli 1998 begann Siemens ein Umstrukturierungsprogramm, das die Schließung von North Tyneside (siehe Anmerkung 1) einschloss. Die Entscheidung zur Stilllegung von North Tyneside trug folgenden Sachverhalt Rechnung:

- Branchenweite Überkapazitäten bei den Hauptprodukten des Unternehmens;
- damit verbundener dramatischer Preisverfall von „Dynamic Random Access Memory“ („DRAM“) Produkten („Speicherchips“) sowie
- hohe Unsicherheit bei Prognosen über eine Änderung der zu diesem Zeitpunkt ungünstigen Marktbedingungen bei DRAM.

Das Umstrukturierungsprogramm sah die vollständige Stilllegung der Produktion von North Tyneside, den vollständigen Abbau der 1.100 Mitarbeiter sowie die Veräußerung der nicht mehr benötigten Anlagen und Maschinen vor. Die Grundausstattung sollte in einem betriebsbereiten Zustand erhalten werden, um die Fabrik verkaufen zu können. Die Produktion wurde im November 1998 eingestellt. Die gleichzeitig begonnenen Stilllegungsarbeiten wurden im März 1999 abgeschlossen.

Gemäß der SEC SAB Topic 1:B „Zuordnung von Aufwendungen und damit verbundene Angabepflichten in den Jahresabschlüssen von Tochtergesellschaften, Geschäftsfeldern oder kleineren Geschäftseinheiten anderer Gesellschaften“ sind die Erträge und Aufwendungen von North Tyneside einschließlich der im Zusammenhang mit der Schließung anfallenden Umstrukturierungsaufwendungen bis zum 30. November 1998 (Zeitpunkt der Einstellung des operativen Geschäfts) in die Konzern – Gewinn- und Verlustrechnung eingegangen.

Im Geschäftsjahr 1998 wies Infineon hinsichtlich der Stilllegung von North Tyneside Aufwendungen vor Steuern in Höhe von EUR 816.469 aus. Darin sind in Höhe von EUR 673.905 Abschreibungen der Sachanlagen auf den niedrigeren beizulegenden Wert enthalten. Diese betrafen mehrheitlich Fertigungsgebäude und -einrichtungen, die Gegenstand von Finanzierungsleasingvereinbarungen waren. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von EUR 673.905 betreffen Gebäude in Höhe von EUR 386.331 und technische Anlagen in Höhe von EUR 287.574. Der Buchwert der zum Verkauf bestimmten Anlagen betrug am 30. September 1998 EUR 88.423.

Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurde von den voraussichtlichen Veräußerungserlösen einzelner Fertigungseinrichtungen sowie der restlichen Fabrik als Ganzes ausgegangen. Die Gebäude wurden voll abgeschrieben, da Siemens keinen weiteren Nutzen ziehen konnte und in der näheren Zukunft auch keine weitere Verwertungsmöglichkeit für diese spezielle Fabrik sah.

Weiter enthielt der Aufwand EUR 39.797 Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung von Mietverhältnissen, EUR 27.686 im Zusammenhang mit Rückzahlungen von Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie EUR 75.081 betreffend Kosten für die Schließung der Betriebsstätte.

Wie bereits in Anmerkung 1 erläutert, verblieben alle North Tyneside betreffenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten einschließlich der unten beschriebenen Rückstellungen bei einer Siemens-Gesellschaft. Infineon hat keine Rechte oder Verpflichtungen aus den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten North Tyneside's.

23. ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

Die Materialaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	1998	1999	2000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.605.527	1.701.610	2.046.727
Aufwendungen für bezogene Leistungen	633.025	656.895	1.022.698
	2.238.552	2.358.505	3.069.425

Die Personalaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	1998	1999	2000
Löhne und Gehälter	823.068	910.713	1.263.165
Soziale Abgaben	131.341	139.478	183.668
Aufwendungen für Altersversorgung	23.692	21.988	29.606
	978.101	1.072.179	1.476.439

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach Regionen für die Geschäftsjahre ist in folgender Übersicht dargestellt:

	1998	1999	2000
Deutschland	11.237	12.352	13.522
Übriges Europa	3.164	3.191	3.081
USA	811	1.753	2.707
Asien / Pazifik	6.586	7.158	7.786
Übrige	63	87	114
	21.861	24.541	27.210

24. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

	1998	1999	2000
Auszahlungen für			
Zinsen	77.652	68.743	90.138
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.898	5.995	211.060
Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungsaktivitäten			
Einlagen von Siemens	799.088	3.516.375	12.267
Latente Steuererträge, die von (an) Siemens übertragen wurden	(907.556)	(153.565)	—
Betriebs- und Geschäftsausstattung die an assoziierte Unternehmen übertragen wurde	—	47.700	—

Die von Siemens im Geschäftsjahr 1998 geleisteten Einlagen in Höhe von insgesamt EUR 799.088 stehen im Zusammenhang mit Forderungen wegen Verlusten aus der Schließung von North Tyneside (siehe Anmerkung 22). Auf diesen Betrag entfallen Steuererträge in Höhe von EUR 455.484, welche von Siemens genutzt wurden. Latente Steuererträge, die an Siemens übertragen wurden, stellen die in der Zeit vor der Gründung von Infineon entstandenen steuerlichen Verluste dar, die von Siemens genutzt wurden.

Der Fehlbetrag von North Tyneside in Höhe von EUR 10.237 bis zum 30. November 1998 wurde in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt und in der Konzernbilanz durch eine nicht zahlungswirksame Verrechnung im Eigenkapital mit Siemens ausgeglichen.

Wie in Anmerkung 3 erläutert, wurde White Oak, welches vorher als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode bilanziert wurde, zum 30. September 1999 voll konsolidiert. Zu diesem Bilanzstichtag wurde folgende Positionen in der Konzernbilanz berücksichtigt:

- Umlaufvermögen mit EUR 105.217,
- Anlagevermögen mit EUR 924.033,
- Kurzfristige Verbindlichkeiten mit EUR 946.607,
- Langfristige Verbindlichkeiten mit EUR 31.672 und
- Eigenkapital mit EUR 50.971.

In 1999 vereinbarte die Gesellschaft mit Motorola eine Call Option und leistete hierfür eine Anzahlung in Höhe von EUR 78.543. Zur Erfüllung der Call Option verzichtete Infineon zudem auf eine Forderung an Motorola in Höhe von EUR 35.606.

25. ÄNDERUNGEN IM EIGENKAPITAL, DIE NICHT AUS TRANSAKTIONEN MIT AKTIONÄREN RESULTIEREN

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, haben sich für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000 wie folgt entwickelt:

	1998			1999			2000		
	VOR STEUERN	STEUEREFFEKT	NACH STEUERN	VOR STEUERN	STEUEREFFEKT	NACH STEUERN	VOR STEUERN	STEUEREFFEKT	NACH STEUERN
Unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Wertpapieren									
Unrealisierte Gewinne (Verluste) aus gehaltenen Wertpapieren	182	(79)	103	(3.698)	1.886	(1.812)	12.959	(6.059)	6.900
Umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen (Gewinnen) Verlusten	(76)	26	(50)	(182)	79	(103)	3.698	(1.886)	1.812
Nicht realisierte Gewinne (Verluste)	106	(53)	53	(3.880)	1.965	(1.915)	16.657	(7.945)	8.712
Unterschiede aus Fremdwährungseffekten	(49.276)	–	(49.276)	49.106	–	49.106	105.085	–	105.085
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	(49.170)	(53)	(49.223)	45.226	1.965	47.191	121.742	(7.945)	113.797
Sonstige kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren									
– zu Beginn des Geschäftsjahres	752	(28)	724	(48.418)	(81)	(48.499)	(3.192)	1.884	(1.308)
Sonstige kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren									
– zum Ende des Geschäftsjahres	(48.418)	(81)	(48.499)	(3.192)	1.884	(1.308)	118.550	(6.061)	112.489

26. AKTIENOPTIONSPÄNE

Aktienoptionsplan mit fester Ausübungshürde

Im März 2000 hat die Gesellschaft einen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive Plan) verabschiedet, wonach nicht übertragbare Rechte zum künftigen Erwerb von Aktien gewährt werden. Danach können über einen Zeitraum von fünf Jahren Aktienoptionen

- für bis zu 2,25 Millionen Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands,
- für bis zu 6 Millionen Aktien der Gesellschaft an Mitglieder der Geschäftsführungen von Tochtergesellschaften und
- für bis zu 39,75 Millionen Aktien der Gesellschaft an andere teilnahmeberechtigte Mitarbeiter ausgegeben werden.

Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 120% des durchschnittlichen Aktienpreises während fünf Handelstagen vor dem Ausgabebetrag der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs im Xetra-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an mindestens einem Handelstag während der jeweiligen Laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat.

Nach den Regelungen des Aktienoptionsplans wird der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Konzernabschlusses über die Zahl der dem Vorstand zu gewährenden Optionen befinden. Der Vorstand wird im gleichen Zeitraum die Zahl der den Mitarbeitern zu gewährenden Optionen festlegen. Zur Börseneinführung konnten bis zu 7,2 Millionen Optionsrechte abweichend von den vorstehenden Dreimonatszeiträumen im Rahmen einer Sondertranche ausgegeben werden.

Für Berichterstattungszwecke wurde der Gesamtwert einer Option mittels des Optionsbewertungsmodells nach Black-Scholes ermittelt. Für 2000 wurden folgende Berechnungsgrundlagen unterstellt: Dividende 0%, erwartete Volatilität 45%, Zinssatz einer risikofreien Anleihe 5,46% und erwartete Laufzeit 4,5 Jahre.

Entwicklung des Aktienoptionsplans in der Berichtsperiode und Status zum 30. September 2000:

	SEPTEMBER 30, 2000	
	AKTIEN	DURCHSCHNITTLICHER AUSÜBUNGSPREIS
Ausstehende Optionen zu Beginn des Geschäftsjahres	–	–
Gewährte Optionen	5.556.268	EUR 42.15
Ausgeübte Optionen	–	–
Verfallene Optionen	(86.800)	EUR 42.00
Ausstehende Optionen zum Ende des Geschäftsjahres	5.469.468	EUR 42.15

Der durchschnittliche Gesamtwert einer in der Berichtsperiode gewährten Option betrug EUR 14.81.

Die folgende Tabelle fasst Informationen über die ausstehenden Aktienoptionen zum 30. September 2000 zusammen:

SPANNE DER AUSÜBUNGSPREISE	AUSSTEHENDE OPTIONEN			AUSGEÜBTE OPTIONEN	
	ANZAHL DER AUSSTEHENDEN OPTIONEN ZUM 30.9.2000	DURCHSCHNITTLICHE RESTLAUFZEIT	DURCHSCHNITTLICHER AUSÜBUNGSPREIS	ANZAHL DER AUSÜBUNGEN ZUM 30.9.2000	DURCHSCHNITTLICHER AUSÜBUNGSPREIS
EUR 42,00	5.451.468	6,45 Jahre	EUR 42,00	—	EUR 42,00
EUR 90,85	18.000	6,84 Jahre	EUR 90,85	—	EUR 90,85

Wie in Anmerkung 2 erläutert, bilanziert die Gesellschaft Aktienoptionspläne gemäß der APB Opinion 25 „Accounting for Stock Issued to Employees“ und damit im Zusammenhang stehenden Regelungen zur Bilanzierung von Aktienoptionsplänen. Dementsprechend wurden im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsplan keine Aufwendungen erfasst. Während Personalaufwendungen auf der Grundlage des Gesamtwerts nach SFAS Nr. 123 „Accounting for Stock-Based Compensation“ berücksichtigt worden, so hätte sich der Konzernjahresüberschuss und das Ergebnis je Aktie wie in den folgenden Pro-Forma-Angaben verringert:

	2000
Konzernjahresüberschuss	
Ist	1.125.585
Pro-Forma	1.115.763
Unverwässertes und Verwässertes Ergebnis je Aktie	
Ist	1,83
Pro-Forma	1,81

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Zur Börseneinführung am 13. März 2000 konnten Mitarbeiter eine bevorrechtigte Zuteilung von Aktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms erwerben. Von Mitarbeitern wurden 7.540.448 Aktien mit einem durchschnittlichen Abschlag von 5% gegenüber dem Ausgabekurs erworben. In diesem Zusammenhang sind im abgelaufenen Geschäftsjahr Personalaufwendungen in Höhe von EUR 2.992 entstanden.

27. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Infineon schließt Fremdwährungs-Termingeschäfte ab. Ziel dieser Transaktionen ist die Verringerung der Marktrisiken aus Veränderungen von Währungsrelationen für die in Fremdwährung lautenden Zahlungsströme. Derivative Finanzinstrumente werden bei Infineon nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt.

Die Nominal- und Marktwerte der von Infineon zum 30. September 1999 und 2000 erworbenen bzw. veräußerten Fremdwährungs-Termingeschäfte sind im Folgenden dargestellt:

	1999		2000	
	NOMINAL-WERT	MARKT-WERT	NOMINAL-WERT	MARKT-WERT
Forward Verträge Verkauf				
US \$	87.054	1.123	1.114.330	(6.078)
Singapur Dollar	—	—	79.254	(3.015)
Britische Pfund	—	—	4.140	4
Forward Verträge Kauf				
US \$	187	—	107.425	1.314
Japanische Yen	11.190	(34)	32.050	597
Singapur Dollar	40.573	(934)	—	—
Britische Pfund	—	—	3.250	6
Sonstige	1.577	102	146.772	(865)
Option Verträge Verkauf				
US \$	—	—	450.000	—
Option Verträge Kauf				
US \$	—	—	470.219	(39.402)

Zum 30. September 1999 und 2000 stimmen die Buchwerte und Marktwerte der Forward- bzw. Optionsverträge überein.

Die Gewinne (Verluste) aus Fremdwährungssicherungen und Fremdwährungssicherungsgeschäften betragen 1998 EUR (85.620), 1999 EUR 41.613 und 2000 EUR 183.589. Diese wurden überwiegend als Umsatzkosten ausgewiesen.

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder der DCF-Methode ermittelt. Der Marktwert der unbesicherten Darlehen und der verzinslichen Bankverbindlichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die Verzinsung den derzeit marktüblichen Zinsen entspricht. Der Marktwert des zinslosen Darlehens ist nicht aussagefähig, da dessen Übertragbarkeit beschränkt ist. Die Marktwerte der Zahlungsmittel, Forderungen gegen Dritte, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie der übrigen derivativen Finanzinstrumente entsprechen aufgrund ihrer kurzfristigen Fälligkeiten annähernd deren Buchwerten.

28. RISIKEN

Die Finanzrisiken von Infineon resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Währungssicherungsgeschäften. Das Kreditrisiko bei Forderungen ist aufgrund der großen Anzahl sowie wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. Ferner bestehen Richtlinien zur Kreditgewährung und -überwachung. Bis zum 30. September 1999 wurden die meisten Währungssicherungsgeschäfte mit der Siemens Financial Services abgeschlossen. Seit dem 1. Oktober 1999 wird das Kreditrisiko in Bezug auf Fremdwährungsderivate durch Transaktionen mit verschiedenen Banken und Festlegung von Kreditlinien begrenzt. Ein wesentlicher Teil der Forderungen und Umsätze aus Lieferungen und Leistungen wird mit verbundenen Unternehmen realisiert.

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit hat Infineon anhaltend hohe Aufwendungen für Prozeßtechnologien sowie Forschung und Entwicklung. Falls die Ergebnisse aus diesen Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich verschlechtern, könnten Teile der erwarteten Rückflüsse aus diesen Investitionen ausbleiben.

Ein Teil der durch Siemens auf Infineon übertragenen gewerblichen Schutzrechte ist verfügungsbeschränkt. Infineon darf diese Rechte nur innerhalb ihres derzeitigen Arbeitsgebietes nutzen bzw. nur mit Zustimmung von Siemens zur Nutzung weiter übertragen. Siemens hat sich das Recht vorbehalten, solche für Infineon teilweise auch wesentlichen Rechte, an Dritte zu lizenzieren. Ferner ist es Siemens nicht verboten, auf den Arbeitsgebieten von Infineon als Konkurrent tätig zu werden.

Solange Infineon unter der einheitlichen Leitung von Siemens steht, kann Infineon Patentaustauschverträge, Technologielizenzen und Einkaufsvereinbarungen von Siemens nutzen. Sobald der Anteil von Siemens an Infineon unter 50% sinkt, verliert Infineon das Recht, an diesen Vereinbarungen zu partizipieren. Infineon hat bereits erfolgreich Ersatzverträge abgeschlossen und verhandelt derzeit über weitere Ersatzverträge sowie Neuverträge mit Dritten.

Siemens hat am 10. August 2000 eine garantierte Umtauschanleihe (Exchangeable Note) auf vier Prozent der Infineon-Aktien ausgegeben. Die Anleihe mit einem Nominalvolumen von EUR 2.500.000 (entspricht 4% des Grundkapitals der Gesellschaft) ist in Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100 geteilt. Die mit 1% p.a. verzinsten Wertpapiere haben eine Laufzeit bis zum 10. August 2005. Jeder Inhaber einer Teilschuldverschreibung hat bei Eintritt bestimmter Bedingungen das Recht diese Teilschuldverschreibung erstmals ab 10. August 2001 in 1.000 Infineon-Aktien umzutauschen.

29. FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Am 7. und 8. August 2000 hat Rambus Inc. („Rambus“) Klagen gegen die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und Deutschland erhoben. Der Kläger behauptet, dass die Gesellschaft gegen Patentrechte des Klägers in Verbindung mit den SDRAM und DDR DRAM Produkten verstoßen hat. Das SDRAM Produkt ist für das Infineon-Speichergeschäft von erheblicher Bedeutung. Ein Fertigungsverbot von SDRAM und DDR DRAM Produkten würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage insbesondere des Unternehmensbereichs Speicherprodukte negativ beeinflussen, da die Produktlinien SDRAM und DDRAM, die wesentlich zum Speichergeschäft beitragen, aufgegeben werden oder ein Lizenzabkommen geschlossen werden müsste, das erhebliche Lizenzzahlungen für produzierte und künftig zu produzierende Produkte auslösen würde. Da der Vorgang derzeit erst untersucht wird, kann die Gesellschaft noch keine Aussagen über die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Ausganges oder eines möglichen Obsiegens treffen. Die ersten Anhörungen zu dieser Angelegenheit sind in Deutschland für Dezember 2000 und in den USA für 2001 vorgesehen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass, sofern das Verfahren endgültig eröffnet wird, wesentliche Prozess- und Verfahrenskosten auftreten können, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in wesentlichem Umfang negativ beeinflussen können.

Ein Infineon-Kunde hat Infineon informiert, dass er von Rambus eine Mitteilung dahingehend erhalten hat, dass eine in den Kundenprodukten eingebaute Infineon-Komponente ein Rambus-Patent verletze. Der Kunde fordert von Infineon Schadenersatz für mögliche Schäden aus Rambus-Forderungen. Da der Kunde mögliche Schäden noch nicht beziffert hat, kann die Gesellschaft derzeit noch keine Angaben über mögliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage machen, falls die Rambus-Ansprüche gegen den Kunden Bestand haben sollten.

Im März 2000 unterrichtete Bosch Telekom GmbH („Bosch“) Infineon über einen Anspruch wegen eines Programmierfehlers in einem der mobilen Kommunikations-Produkte. Der Anspruch bezieht sich auf Schäden, die Bosch angeblich seinen Kunden ersetzen muss. Bosch beziffert diesen Schaden auf ungefähr EUR 20.000. Infineon geht davon aus, dass dieser Anspruch keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wird.

Im Oktober 1999 unterrichtete die Deutsche Telekom AG („DT“) Infineon über eine mögliche vertragliche Inanspruchnahme aus Gewährleistungsverpflichtungen in Bezug auf Chiplieferungen für Telefonkarten in den Jahren 1993 bis 1997. Der Anspruch bezieht sich auf einen von der DT vermeintlich erlittenen Schaden, der bei unrechtmäßigen Versuchen entstand, bereits benutzte Telefonkarten wieder aufzuladen. Der DT soll hieraus ein Verlust in Höhe von ca. EUR 90.000 entstanden sein, welcher den erlittenen Schaden ebenso wie die Aufwendungen für Abwehrmaßnahmen umfasst. Derzeit strebt die DT Verhandlungen mit Infineon und Siemens über einen Vergleich hierfür an. Infineon geht davon aus, dass dieser Anspruch keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wird.

Am 8. März 2000 hat Hyundai Electronics eine auf Unterlassung und nicht näher spezifizierten Schadenersatz gerichtete Klage gegen die Gesellschaft aus der behaupteten Verletzung von fünf DRAM bezogenen Patenten erhoben. Die Gesellschaft hat Gegenklagen eingereicht, und ist der Auffassung, dass Hyundais Klage ohne Erfolg bleiben wird. Infineon führt derzeit Gespräche zur Beilegung des Streits, über den Ausgang können jedoch keine Aussagen getroffen werden. Falls die Auseinandersetzung bis zu einer gerichtlichen Entscheidung geführt wird, erwartet die Gesellschaft keinen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Im Rahmen der Gründung von Infineon verblieben bei Siemens bestimmte Betriebsstätten in den USA sowie die damit zusammenhängenden Umweltaftlasten. Für das von Siemens bei der Gründung von Infineon eingebrachte Geschäft wurden in der Vergangenheit einige dieser Betriebsstätten genutzt. Aufgrund der US-amerikanischen Rechtsprechung könnte Infineon für die Beseitigung von Umweltaftlasten in Anspruch genommen werden, obwohl diese Betriebsstätten bei Siemens verblieben sind. Siemens hat gegenüber bestimmten nicht zum Konzern gehörigen Gesellschaften sowie Behörden Garantien abgegeben. Alle beteiligten Parteien sehen die Verantwortung für die betreffenden Standorte bei Siemens. Bislang wurden keine Ansprüche gegen Infineon

geltend gemacht. Die Höhe eventueller Ansprüche aus der Beseitigung von Altlasten, sofern solche bestehen, wurde nicht ermittelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihr Risiko zur Entsorgung der Altlasten der bei Siemens verbliebenen Betriebsstätten in den USA begrenzt ist, sofern ein solches tatsächlich bestehen sollte.

Gegen Infineon laufen verschiedene andere Rechtsstreite und Verfahren im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit. Diese betreffen Produkte und Leistungen, Patente und andere Sachverhalte. Hierfür werden Rückstellungen gebildet, sobald die mögliche Verpflichtung dem Grunde nach wahrscheinlich und in der Höhe hinreichend genau bestimmbar ist. Das Management der Gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass aus dem Ausgang der anhängigen Verfahren kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Zukunft liegenden Verfahrensabschlüsse die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich negativ beeinflussen können.

Seit 1994 hat Infineon Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von insgesamt ca. EUR 487.123 für den Bau und die Finanzierung von bestimmten Produktionsstätten erhalten. Diese Beträge werden bei Erreichen definierter Meilensteine vereinnahmt sowie in den Fällen, in denen die Erfüllung der Anforderungen nach geplanten und zugesagten Investitionen, Arbeitsplätzen sowie anderen Faktoren hinreichend sichergestellt werden kann. Infineon ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollten jedoch die Anforderungen an ein Gesamtprojekt nicht erfüllt werden, können Teile der Zuwendungen zurückgefordert werden.

Infineon ist mit verschiedenen Zulieferern Vereinbarungen eingegangen, die der Gesellschaft Kapazitäten zur Produktion und zum Testen von Halbleiterprodukten garantieren. Diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Vertragslaufzeit von ein oder zwei Jahren und beinhalten jeweils Mindestabnahmemengen und Preiszusagen. Zusätzlich hat sich Infineon gegenüber ProMOS und ALTIS vertraglich verpflichtet, 38% bzw. 50% der Jahresproduktion zu Marktpreisen abzunehmen. Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entsprechend dem üblichen Geschäftsverlauf als Aufwendungen erfasst. Um der Nachfrage nach Ihren Produkten entsprechen zu können, überprüft Infineon regelmäßig den voraussichtlichen Einkaufsbedarf. Die Einkaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtlichen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die Marktpreise unter die Vertragspreise fallen.

Im März 2000 hat Infineon mit Intel eine Investitionsvereinbarung sowie eine Geschäfts- und Speicherlieferungsvereinbarung abgeschlossen. In der Geschäftsvereinbarung hat die Gesellschaft mit Intel vereinbart, dass in der geplanten 300mm Wafer-Fabrik bis zum 1. April 2003 mit der Installation der Fertigungsanlagen begonnen werden kann und Intel eine bestimmte Abnahmemenge zugesichert wird. Ist dies nicht der Fall, kann Intel verschiedene Ansprüche geltend machen. Dazu zählt der Anspruch auf ursprünglich Infineon zustehende Anteile am Produktionsausstoß der Fabrik. Zusätzlich wären in diesem Fall \$50 Millionen an Intel zahlen, wenn nach dem 1. April 2003 der Infineon-Börsenkurs unter einen bestimmten Wert fällt.

Im Zuge der Gründung von Infineon hat die Gesellschaft Siemens Rückbürgschaften gewährt für Garantien die Siemens für Finanzierungen von Infineongesellschaften gegeben hatte. Am 30. September 2000 war Infineon unter anderem folgende wesentliche Verpflichtungen eingegangen:

- eine Zahlungsgarantie in Höhe von EUR 313.400 zugunsten von Kreditinstituten im Zuge einer Rückhaftungserklärung im Zusammenhang mit gewährten Zuschüssen für die Fertigungsstätte in Dresden,
- eine Zahlungsgarantie in Höhe von \$168 Millionen für ProMOS Technologies und
- eine Zahlungsgarantie in Höhe von EUR 22.672 zugunsten der Leasinggeber im Rahmen einer Leasingfinanzierung für die Fertigungsstätte in Malacca, Malaysia.

Infineon hat mit dem Bau einer neuen Fertigungshalle an einem bestehenden Standort begonnen, um die Produktionskapazität für die 300mm Technologie zu erhöhen. Die Fertigungshalle ist mit mehr als EUR 1.000.000 veranschlagt. Am 30. September 2000 betragen die vertraglichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit diesem Bau EUR 88.450.

Die gesamten Aufwendungen für das Operating Lease betragen in 1998 EUR 122.927, 1999 EUR 128.692 und 2000 EUR 131.348. Die zukünftigen Mindestleasingraten für unkündbare Operating Lease-Verträge mit Laufzeiten oder Restlaufzeiten von über einem Jahr betragen jeweils zum 30. September 2001 EUR 77.973, 2002 EUR 66.517, 2003 EUR 47.297, 2004 EUR 40.362, 2005 EUR 40.723 und für die Folgejahre EUR 36.916.

30. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Am 2. Oktober 2000 schloss Infineon eine Vereinbarung über den Erwerb der Anteile an der Ardent Technologies Inc., einem Hersteller von hochintergrierten Schaltungen in breitbandigen Switching-Systemen für lokale Unternehmensnetzwerke (LAN), zu einem Preis von \$42 Millionen. Die Transaktion steht unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Kartellamtes.

Am 23. Oktober 2000 hat Infineon eine Vereinbarung über den Verkauf des Image- und Video-Geschäfts, ein Teil des Geschäftsbereichs Drahtgebundene Kommunikation, abgeschlossen (siehe Anmerkung 31). In diesem Geschäft wurden Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 1998 von EUR 140.346, in 1999 von EUR 122.845 und in 2000 von EUR 138.974 erwirtschaftet. Die negativen Ergebnisse vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile und Steuern beliefen sich im Geschäftsjahr 1998 auf EUR 25.207, in 1999 auf EUR 13.095 und in 2000 auf EUR 15.985. Infineon geht davon aus, dass der Verkauf keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wird.

Am 24. Oktober 2000 übte die Gesellschaft die Option zum Erwerb der ausstehenden Anteile von Motorola an der SC300 in Höhe von EUR 7.655 aus (siehe Anmerkung 10).

31. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Infineon berichtet über ihre Geschäftsbereiche und nach Regionen gemäß den Regelungen SFAS Nr. 131 „Angaben zu den Segmenten eines Unternehmens und damit in Zusammenhang stehende Informationen“.

Infineon ist schwerpunktmäßig in vier Geschäftsbereichen tätig, von denen drei anwendungsorientiert sind: Automobil- und Industrieelektronik, Drahtgebundene Kommunikation (früher Kommunikation und Multimedia) und Mobile Kommunikation sowie ein Geschäftsbereich, Speicherprodukte, produktorientiert ist. Ferner entsprechen die Bereiche Sicherheits- und Chipkartensysteme und das OSRAM Opto Joint Venture der Definition gemäß SFAS Nr. 131 für ein Segment, erreichen aber nicht die Berichterstattungskriterien gemäß SFAS Nr. 131. Deshalb wurden zu Berichterstattungszwecken beide Bereiche unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ zusammengefasst.

Am 1. Juli 2000 hat die Gesellschaft ihre interne Management-Berichterstattung für einzelne Geschäftsbereiche umgestellt. Das Geschäft mit Chips für Computerperipherie, das bisher unter Drahtgebundene Kommunikation ausgewiesen wurde, wird nun unter Speicherbausteine gezeigt. Das Geschäft mit Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, bisher unter Mobile Kommunikation ausgewiesen, wird ab diesem Zeitpunkt unter Drahtgebundene Kommunikation gezeigt. Die Vorjahreszahlen wurden an die neue Berichtsstruktur angepasst.

Jedes dieser Segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, der direkt dem „Chief Operating Officer“ und dem Finanzvorstand berichtet. Diese tragen gemeinsam die Entscheidungsverantwortung für das laufende Geschäft. Sie entscheiden gemeinsam über die Ressourcenzuordnung auf die Geschäftsbereiche und beurteilen deren Erfolg anhand der Kennzahlen Umsatzerlöse sowie Ergebnis vor Zinsen und auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile und Steuern. Das Betriebsvermögen von Infineon wird den Geschäftsbereichen nicht in einer regelmäßigen Berichterstattung zugerechnet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für die Geschäftsbereiche entsprechen grundsätzlich den bereits erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen von Infineon. Das Anlagevermögen wird für Management-Berichterstattungszwecke in den einzelnen Geschäftsbereichen nicht im Einzelnen identifiziert und diesen demzufolge nicht zugerechnet. Infineon ordnet den einzelnen Geschäftsbereichen die Abschreibungen nach Maßgabe des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf Basis von Standardkosten zu, so dass das Ergebnis vor Zinsen und auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile und Steuern je Geschäftsbereich ermittelt werden kann.

Informationen zu den Geschäftsbereichen:

Automobil- und Industrieelektronik

Der Geschäftsbereich Automobil- und Industrieelektronik entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen zur Verwendung in der Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen.

Drahtgebundene Kommunikation

Der Geschäftsbereich Drahtgebundene Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systeme für ein breites Anwendungsspektrum von Breitbandkommunikationsanwendungen und Anwendungen mit geringen Übertragungsraten.

Mobile Kommunikation

Der Geschäftsbereich Mobile Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und komplette Systemlösungen für ein breites Spektrum von drahtlosen Anwendungen, darunter Mobilfunktelefonsysteme, schnurlose Telefone und Geräte, die im Rahmen von globalen Ortungssystemen („GPS“) eingesetzt werden.

Speicherprodukte

Der Geschäftsbereich Speicherprodukte entwirft, entwickelt und fertigt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Gehäusen und Konfigurationen, Architekturen und mit verschiedenen Leistungsparametern für den standardmäßigen Einsatz in Speicheranwendungen.

Sonstige Geschäftsbereiche

Der Bereich Sicherheits- und Chipkartensysteme entwickelt und fertigt Sicherheitskontrollbausteine, Sicherheitsspeicherbausteine sowie andere Halbleiter und Systemlösungen für Einsatzgebiete mit speziellen Sicherheitsanforderungen, z.B. bei Banken, in der Telekommunikation, für Zugangskontrollsysteme und Identifizierungssysteme sowie andere sicherheitssensible Anwendungen. In dem Gemeinschaftsunternehmen OSRAM Opto erfolgt die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung optoelektronischer Geräte und Anwenderlösungen, z.B. für die Automobilindustrie und industrielle Anwendungen.

Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Segmentdaten für die Geschäftsjahre 1998, 1999 und 2000:

GESCHÄFTSJAHR 1998	AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK	DRAHTGEBUNDENE KOMMUNIKATION	MOBILE KOMMUNIKATION	SPEICHER-PRODUKTE	SONSTIGE GESCHÄFTSBEREICHE	ÜBRIGES UND ÜBERLEITUNG	GESAMT
Umsatzerlöse	606.012	741.827	685.830	669.063	401.153	71.415	3.175.300
Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern	41.187	48.651	121.114	(976.921)	5.478	(884.969)	(1.645.460)
Abschreibungen	82.318	50.565	75.491	296.738	35.790	37.485	578.387
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen	-	-	-	-	-	(673.905)	(673.905)
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	439	-	-	(168.628)	17.009	-	(151.180)
Vorräte	91.692	58.455	59.124	233.502	20.463	119.521	582.757
GESCHÄFTSJAHR 1999	AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK	DRAHTGEBUNDENE KOMMUNIKATION	MOBILE KOMMUNIKATION	SPEICHER-PRODUKTE	SONSTIGE GESCHÄFTSBEREICHE	ÜBRIGES UND ÜBERLEITUNG	GESAMT
Umsatzerlöse	665.405	720.136	864.993	1.405.885	501.653	79.221	4.237.293
Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern	22.778	41.143	181.897	(237.854)	35.021	(56.026)	(13.041)
Abschreibungen	100.469	75.123	82.052	267.249	41.568	6.608	573.069
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	1.059	1.880	997	22.041	7.786	-	33.763
Vorräte	82.625	28.172	78.075	303.502	19.838	164.760	676.972
GESCHÄFTSJAHR 2000	AUTOMOBIL- UND INDUSTRIELEKTRONIK	DRAHTGEBUNDENE KOMMUNIKATION	MOBILE KOMMUNIKATION	SPEICHER-PRODUKTE	SONSTIGE GESCHÄFTSBEREICHE	ÜBRIGES UND ÜBERLEITUNG	GESAMT
Umsatzerlöse	880.151	940.443	1.221.140	3.473.306	668.346	99.212	7.282.598
Ergebnis vor Zinsen, vor Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile und Steuern	69.294	78.172	261.289	1.336.393	54.152	(129.792)	1.669.508
Abschreibungen	117.225	90.319	135.221	389.127	102.287	(523)	833.656
Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften	-	-	-	81.616	9.027	10.660	101.303
Vorräte	129.650	81.709	118.311	358.594	44.446	108.104	840.814

Zwischen den Geschäftsbereichen werden aufgrund ihrer spezifischen Anwendungen und der produktbezogenen Eigenarten keine Umsätze getätigt. Dementsprechend resultieren die Umsatzerlöse der Geschäftsbereiche aus Umsätzen mit Dritten.

Die Vorprodukte und unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Front-end Fabriken sowie die unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Back-end Fabriken stehen nicht unter der Kontrolle und Verantwortung der zuständigen Bereichsleiter, sondern unter der des Fabrikmanagements, welches für die Umsetzung des Produktionsplans, nach Mengen und Einheiten verantwortlich ist. Deshalb werden diese Vorräte in der Spalte „Übriges und Überleitung“ ausgewiesen und nicht unter den einzelnen Geschäftsbereichen. Lediglich die Vorprodukte der Back-end Fabriken (Chipbestände) und Fertigprodukte sind den Geschäftsbereichen zugeordnet und in den Segmentinformationen, welche an die verantwortlichen Vorstände berichtet werden, enthalten.

Unter Übriges und Überleitung sind den Segmenten nicht zugeordnete Themen wie bestimmte Kosten der Konzernzentrale, anfänglich zentral geführte Konzernprojekte, Währungsgewinne und -verluste aus konzerninterner Finanzierung und bestimmte strategische Geschäfts- und Technologie-Initiativen ausgewiesen. Wenn mit Abschluss von Patentverfahren der tatsächliche Aufwand Segmenten zugerechnet wird, können diese Beträge von den ursprünglich unter Übriges und Überleitung gebildeten Rückstellungsbeträgen abweichen. Die Umstrukturierungsaufwendungen, die in Anmerkung 22 erläutert sind, wurden keinem Geschäftsbereich sondern unter Übriges und Überleitung ausgewiesen.

Es folgt eine Übersicht zu der Geschäftstätigkeit nach Regionen für die Geschäftsjahre 1998 und 1999 und 2000:

	DEUTSCHLAND	ÜBRIGES EUROPA	USA	ASIEN/PAZIFIK	ANDERE	GESAMT
Geschäftsjahr 1998						
Umsatzerlöse	1.077.483	783.280	626.075	649.311	39.151	3.175.300
Langfristig gebundenes Vermögen	1.299.596	642.794	106.860	231.891	72.684	2.353.825
Geschäftsjahr 1999						
Umsatzerlöse	1.241.375	1.203.106	826.824	899.320	66.668	4.237.293
Langfristig gebundenes Vermögen	1.686.514	651.188	1.031.691	128.867	46.101	3.544.361
Geschäftsjahr 2000						
Umsatzerlöse	1.611.862	1.646.557	1.814.448	2.099.834	109.897	7.282.598
Langfristig gebundenes Vermögen	2.296.904	789.427	1.312.191	310.414	11.117	4.720.053

Der Ausweis des Umsatzes (mit Dritten) richtet sich nach dem Sitz des Rechnungsempfängers. Zwischen den Geschäftsbereichen entstehen keine Umsätze. Die langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind den Regionen zugeordnet, in denen sie sich befinden.

Mit Ausnahme von Verkäufen an Siemens, die in Anmerkung 17 erläutert sind, entfielen in den Geschäftsjahren 1999 und 2000 auf keinen Einzelkunden mehr als 10% der Gesamtumsatzerlöse. Die Umsatzerlöse mit Siemens resultieren insbesondere aus den Geschäftsbereichen Automobil- und Industrieelektronik und Mobile Kommunikation.

ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN FÜR DEN NACH US-GAAP AUFGESTELLTEN ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS ENTSPRECHEND DER ANFORDERUNGEN NACH §292A HGB

Die Gesellschaft hat für das zum 30. September 2000 beendete Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsgesetzbuch aufgestellt. Sie hat sich dabei gemäß den handelsrechtlichen Regelungen dafür entschieden, über den Konzernabschluss auf der Grundlage der international anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze („US-GAAP“) zu berichten. Die Berichterstattung nach dem deutschen Handelsrecht umfasst neben dem Konzernabschluss nach US-GAAP zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht, die in diesem Geschäftsbericht dargestellt sind. Der Konzernabschluss nach deutschem Handelsrecht und der Konzernlagebericht unterliegen deutschen Prüfungsvorschriften. Die KPMG Deutsche Treuhand - Gesellschaft AG hat hierzu den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den von der Infineon Technologies AG, München, aufgestellten Konzernabschluss, bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung des Konzerneigenkapitals, Konzernkapitalflussrechnung und Konzernanhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2000 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den US-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der US-Generally Accepted Auditing Standards (US-GAAS) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für

die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den US-GAAP ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres. Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2000 aufgestellten Konzernlagebericht erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Infineon Technologies AG, München, zusammengefasst ist, insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2000 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen. Die Prüfung des für die Befreiung von der handelsrechtlichen Konzernrechnungslegungspflicht erforderlichen Einklangs der Konzernrechnungslegung mit der 7. EG-Richtlinie haben wir auf der Grundlage der Auslegung der Richtlinie durch den Kontaktausschuss für Richtlinien der Rechnungslegung der Europäischen Kommission vorgenommen.

München, den 21. November 2000

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Berger
Wirtschaftsprüfer

Wolfs
Wirtschaftsprüfer

WESENTLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEUTSCHER UND US-RECHNUNGSLEGUNG

Vorbemerkung

Die Infineon Technologies AG muss als deutsches Mutterunternehmen grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufstellen. §292a HGB befreit jedoch von dieser Pflicht, wenn ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und offengelegt wird (wie z.B. US-GAAP). Die Infineon Technologies AG stellt den Konzernabschluss nach US-GAAP auf. Im Folgenden werden die von den deutschen Rechnungslegungsvorschriften abweichenden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden erläutert.

Grundsätzliche Unterschiede

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach dem deutschen HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen für die Investoren legt, ist die HGB-Rechnungslegung von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips geprägt. Weiterhin sind Gesellschaften mit einer Börsennotierung in den USA verpflichtet, den Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) zu entsprechen.

Grundlagen der Aufstellung von Pro-Forma-Konzernabschlüssen

Nach US-GAAP sind in Konzernabschlüssen, die für Zeiträume vor der Gründung der Muttergesellschaft Infineon Technologies AG aufgestellt werden, die Finanzdaten aller mit dem Halbleitergeschäft im Zusammenhang stehenden und von Siemens auf Infineon übertragenen Geschäftsaktivitäten enthalten. Diese „Pro-Forma-Konzernabschlüsse“ unterstellen, dass Infineon in der heutigen Struktur als selbständiges juristisches Subjekt bereits in allen dargestellten Berichtsperioden bestanden hat. Dies beinhaltet auch Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten, Vermögensgegenständen und Schulden der Fertigungsstätte in North Tyneside, die nicht von Siemens an Infineon übertragen wurde. Nach HGB werden in Pro-Forma-Konzernabschlüsse nur solche Gesellschaften einbezogen, die direkt oder indirekt von der aufstellenden Muttergesellschaft beherrscht werden.

Gliederungsvorschriften

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Bilanzgliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke ist für Kapitalgesellschaften grundsätzlich in §266 HGB definiert. Die Gliederung orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erfolgt nach HGB und US-GAAP grundsätzlich nach gleichen Grundsätzen, sofern die Leistung erbracht und die Einzahlung erfolgt ist. Unterschiede können bezüglich des Zeitpunkts der Vereinnahmung auftreten, wenn die leistende Gesellschaft weitere finanzielle Verpflichtungen gegenüber der leistungsempfangenden Gesellschaft übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht hinreichend objektivierbar sind.

Marktgängige Wertpapiere

Marktgängige Wertpapiere, die Anteils- oder Gläubigerrechte verbriefen, sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten.

Die von Infineon gehaltenen Wertpapiere sind nach US-GAAP als available-for-sale securities zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Wertsteigerungen oder Wertminderungen dieser Wertpapiere werden, nach Berücksichtigung latenter Steuern, ergebnisneutral im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst.

Vorräte

Die Vorräte sind nach HGB ebenso wie nach US-GAAP mit den Herstellungskosten zu bewerten.

Die Herstellungskosten nach US-GAAP werden als produktionsbezogene Vollkosten definiert, bei denen neben den Material- und Lohneinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung die Material- und Fertigungsgemeinkosten zwingend einzubeziehen sind. Zudem sind Verwaltungskosten zu berücksichtigen sofern sie in eindeutigen Zusammenhang mit der Erzeugung der zu bewertenden Produkte stehen. Nach HGB brauchen von den oben genannten Kosten Teile der indirekten Kosten wie z.B. Verwaltungskosten nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen werden.

Nicht abgeschlossene Entwicklungen geistiger Eigentumsrechte bei Beteiligungserwerben

Aufwendungen, die bei erworbenen Unternehmen für nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

Derivative Finanzinstrumente

Nach dem HGB werden derivative Finanzinstrumente grundsätzlich nicht bilanziert. Dies bedeutet, dass Wertsteigerungen nicht zu berücksichtigen sind. Für Wertminderungen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen Rückstellungen zu bilden. Nach SFAS 133 und 138, die Infineon ab Oktober 2000 anwenden wird, sind derivative Finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert anzusetzen. Die Marktwertänderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung oder unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst. Dies ist einerseits abhängig davon, ob die derivativen Finanzinstrumente Bestandteil eines Sicherungsgeschäftes sind und andererseits von der Art des Sicherungsgeschäftes.

Latente Steuern

Der wesentlichste Unterschied in der Bilanzierung latenter Steuern zwischen HGB und US-GAAP ist, dass nach den Vorschriften des HGB keine latente Steuern auf Verluste aktiviert werden dürfen. Nach US-GAAP sind latente Steuern auf Verluste (inklusive Verlustvorräte) zu berücksichtigen. Auf aktive latente Steuern, deren Realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind Wertberichtigungen vorzunehmen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Nach US-GAAP sind Pensionsrückstellungen unter Berücksichtigung für die Zukunft zu erwartender Entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren zu bewerten. Diese Methode ist auch nach dem HGB zulässig.

Auf Grund der Übertragung der treuhänderischen Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pension-Trust Verein wurden nach US-GAAP die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei Infineon bilanziert. Nach HGB sind die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Übertragung auf den Pension-Trust Verein weiterhin bei Infineon zu bilanzieren.

Aktionsoptionsprogramm

Für die gewährten Aktienoptionen werden nach HGB Rückstellungen gebildet, sofern der Marktwert zum Bilanzstichtag über dem Ausübungspreis für die Optionsrechte liegt. Nach US-GAAP bilanziert Infineon die gewährten Aktienoptionen nach der Methode des inneren Wertes entsprechend „APB Opinion 25: Bilanzierung von Aktienoptionen für Mitarbeiter“, die nicht zu einer Aufwandserfassung führt, sofern der Marktwert der Aktie im Zeitpunkt der Ausgabe der Option nicht deren Ausübungspreis übersteigt.

Kosten des Börsengangs

Nach HGB wurden Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit dem Börsengang als Aufwendungen erfasst. Nach US-GAAP wurden diese Aufwendungen mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Rückstellungen

Nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen Aufwandsrückstellungen in bestimmten Fällen auch ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gebildet werden. Nach US-GAAP sind Rückstellungen nur bei gegenüber Dritten bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für eng eingegrenzte Tatbestände zu bilden.

Fremdwährungsumrechnung

Nach HGB werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit dem Währungskurs im Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorfalles bzw. jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wobei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Nach US-GAAP erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten zum Fremdwährungskurs des Bilanzstichtages, wobei die daraus ermittelten, nicht realisierten Gewinne und Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.

Zuwendungen der öffentlichen Hand

Nach HGB dürfen Investitionszulagen und Zinszuschüsse im Geschäftsjahr des Zuflusses erfolgswirksam vereinnahmt werden. Nach US-GAAP wurden diese Zuwendungen abgegrenzt und über den Zeitraum der Verrechnung der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen erfolgswirksam vereinnahmt.

Anteiliges Jahresergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Nach HGB dürfen die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Unternehmen, basierend auf den nach den jeweiligen landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ergebnissen, vereinnahmt werden. Unter US-GAAP werden die nach US-GAAP ermittelten Ergebnisse der assoziierten Unternehmen anteilig vereinnahmt.

Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerung durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen

Nach HGB dürfen Wertsteigerungen des anteiligen Eigenkapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen erfolgswirksam erfasst werden. Nach US-GAAP und SEC Rechnungslegungsvorschriften hängt eine solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der Erfüllung weiterer Kriterien neben der Durchführung der Kapitalerhöhung ab. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die Werterhöhung des anteiligen Eigenkapitals erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen.

Anwendung von Befreiungsvorschriften

Nach §264a HGB haben offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften bei denen keiner der Gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter ist, einen Jahresabschluss nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Infineon Technologies AG hat die in §264b HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

- COMNEON GmbH & Co. OHG, Nürnberg und die
- Infineon Technologies Image & Video GmbH & Co. KG, München

in Anspruch genommen, da diese Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen sind.

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betragen für das Geschäftsjahr 2000 EUR 28.383 Sie setzten sich aus festen Gehaltsbestandteilen EUR 1.100, einer erfolgsabhängigen Vergütung EUR 13.778, sowie dem Gegenwert eingeräumter Aktienoptionen EUR 13.505 zusammen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2000 zusammen eine Vergütung in Höhe von insgesamt EUR 457.

Als Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon Technologie AG waren im Geschäftsjahr folgende Herren bestellt:

DER VORSTAND DER INFINEON TECHNOLOGIES AG

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.09.2000).

**Dr. Ulrich Schumacher
Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer**

Vorsitzender des Board of Directors
- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA

Vorsitzender des Aufsichtsrates
- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich

externe Mandate
Mitglied des Aufsichtsrates
- Deutsche Bahn AG, Berlin

**Peter Bauer
Mitglied des Vorstands und Chief Sales and Marketing Officer**

Mitglied des Board of Directors
- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan
(Stellvertreter des Vorsitzenden)
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA
- Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel
- Infineon Technologies U.K. Ltd., Bracknell, Großbritannien

**Peter J. Fischl
Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer**

Mitglied des Board of Directors
- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur
- Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan
- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA

Mitglied des Aufsichtsrates
- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich

Mitglied des Vorstandes
- Infineon Pension-Trust e. V., München

Mitglied der Gesellschafterdelegation
- Osram Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG, Regensburg

Dr. Sönke Mehrgardt**Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer****Dr. Andreas von Zitzewitz****Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer**

Vorsitzender der Gesellschafterdelegation

- Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden
- Eupec GmbH & Co. KG, Warstein-Belecke

Mitglied des Board of Directors

- Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur
- White Oak Semiconductor Limited Partnership, Wilmington, Delaware, USA
- Infineon Technologies Fabrico de Semicondutores Portugal S.A., Vila do Condo, Portugal
- ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan

Präsident

(in Vertretung der Infineon Technologies AG)

- Infineon Technologies France S.A.S., Saint-Denis, Frankreich
- Infineon Technologies Holding France S.A.S., Saint-Denis, Frankreich

externe Mandate

Mitglied des Aufsichtsrates

- Steag Hamatech AG, Sternenfels

DER AUFSICHTSRAT DER INFINEON TECHNOLOGIES AG

Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30.09.2000).

Dr. Eng. h.c. Volker Jung**Vorsitzender****Mitglied des Vorstands der Siemens AG**

Konzernmandate

- Siemens A.E., Athen, Griechenland (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Siemens Ltd., Johannesburg, RSA (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, München (Vorsitzender des Beirats)
- Siemens Information and Communication Networks, Inc., Boca Raton, Florida, USA (Member of the Board)

Aufsichtsrat

- Direkt Anlage Bank AG, München
- Epcos AG, München (Vorsitz)
- MAN AG, München
- Messe München GmbH, München

Alfred Eibl ***stellv. Vorsitzender****Mitglied des Betriebsrats, Betrieb München Balan-/St.-Martin-Straße****Dr. h.c. Martin Kohlhaussen****stellv. Vorsitzender (seit 1. November 1999)****Sprecher des Vorstands der Commerzbank AG**

Konzernmandate

- RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG, Frankfurt am Main (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Commerzbank International S.A. (CISAL), Luxemburg (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats)
- Commerzbank (South East Asia) Ltd., Singapur (Chairman of the Board of Directors – non executive)

Aufsichtsrat

- Bayer AG, Leverkusen
- Bertelsmann AG, Gütersloh
- Heraeus Holding GmbH, Hanau
- Hochtief AG, Essen
- KarstadtQuelle AG, Essen
- Schering AG, Berlin
- Linde AG, Frankfurt am Main

weitere externe Mandate

- Assicurazioni Generali S.P.A., Triest, Italien (Verwaltungsrat)
- DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Shareholder Committee)

Ender Beyhan ***Mitglied des Betriebsrats, Betrieb München Perlach****Johann Dechant *****Mitglied des Betriebsrats, Betrieb Regensburg West****Dr. Joachim Faber****(seit 1. November 1999)****Mitglied des Vorstands der Allianz AG**

Konzernmandate

- Allianz Vermögensbank, Augsburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Universal-Leasing-GmbH, München (stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Allianz Asset Management GmbH, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Allianz Capital Partners, München (Aufsichtsrat)
- Allianz Risk Transfer, Zürich, Schweiz (stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- IRC International Reinsurance Company S.A., Luxemburg (Verwaltungsrat)
- RASBANK S.p.A., Mailand, Italien (Verwaltungsrat)

* Arbeitnehmervertreter

Aufsichtsrat

- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt am Main
- Berliner Wasser AG, Berlin
- Lloyd Adriatico S.p.A., Triest, Italien
- Società Metallurgica Italiana S.p.A., Florenz, Italien
- Mercur Assistance AG Holding, München
- Karlsruher Rendite GmbH, Karlsruhe

Heinz Hawreliuk *

Leiter der Abteilung Unternehmensmitbestimmung der IG Metall

Aufsichtsrat

- Siemens AG, München
- DaimlerChrysler Aerospace AG, München
- DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt Holding AG, München
- Eurocopter Deutschland GmbH, Donauwörth
- Spezialtechnik Dresden GmbH, Dresden

Charles Herlinger

(bis 31. Oktober 1999)

Leiter der Hauptabteilung Bilanzierung, Controlling und Steuern der Siemens AG

Klaus Luschtinetz *

Vorsitzender des Betriebsrats, Betrieb

München Balan-/St.-Martin-Straße

weiteres Mandat

- Siemens Betriebskrankenkasse, München
(Verwaltungsrat)

Karl-Heinz Midunsky

(bis 31. Oktober 1999)

**Leiter der Hauptabteilung Finanzierung,
Gesellschaften und Versicherungen der Siemens AG**

Konzernmandate

- RISICOM Rückversicherung AG, Grünwald
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Siemens Financial Services, München
(Aufsichtsrat)
- Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH, München (Aufsichtsrat)
- BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (Aufsichtsrat)
- OSRAM GmbH, München
(Aufsichtsrat)
- Siemens Building Technologies, Zürich, Schweiz (Verwaltungsrat)

Aufsichtsrat

- Gerling Speziale KreditversicherungsAG, Köln
- Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover

Prof. Dr. rer. pol. Michael Mirow

(bis 31. Oktober 1999)

**Leiter der Hauptabteilung
Unternehmensstrategie der Siemens AG**

Heinz-Joachim Neubürger

Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Konzernmandate

- Siemens Financial Services GmbH, München
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH, München
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- TELA Versicherungs AG, München
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Siemens Corporation, New York, USA
(Vice Chairman of the Board of Directors)
- Siemens Immobilien Management GmbH & Co. OHG, München
(Vorsitzender des Beirats)
- Siemens Ltd. China (SLC), Beijing, VR China
(Member of the Board)
- Siemens Western Finance N.V., Willemstad, Curacao
(Managing Director)

Aufsichtsrat

- Allianz Versicherungs-AG, München
- Bayerische Handelsbank AG, München

Stefan Radloff *

**Senior Vice President, Accounting and
Financial Reporting der Infineon Technologies AG**

Dr. Eberhard Rauch

(seit 1. November 1999)

Mitglied des Vorstands der HypoVereinsbank AG

Konzernmandate

- DAB Direkt Anlage Bank GmbH, München
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Norisbank AG, Nürnberg
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Planet Home AG, München
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Bank Przemyslowo-Handlowy SA, Krakau, Polen
(Aufsichtsrat)
- Vereinsbank Victoria Bauspar AG, München
(Aufsichtsrat)
- HVB Informations-Verarbeitungs-GmbH, München
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)

Aufsichtsrat

- Kennametal Hertel AG, Fürth
(Vorsitz)
- Koenig & Bauer AG, Würzburg

weitere externe Mandate

- Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH, Bamberg
(Verwaltungsrat)
- Clearstream International S.A., Luxemburg
(Member of the Board of Directors)

* Arbeitnehmervertreter

Univ.-Prof. Dr.- Ing. Ingolf Ruge
(seit 1. November 1999)
Ordinarius Technische Universität München

Aufsichtsrat
- Schneider Technologies AG, Türkheim

Dr. jur. Albrecht E.H. Schäfer
(bis 31. Oktober 1999)
Justitiar der Siemens AG

Konzernmandate
- RISICOM Rückversicherung AG, Grünwald
(Aufsichtsrat)
- Siemens Financial Services GmbH, München
(Aufsichtsrat)
- Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn
(Aufsichtsrat)

Aufsichtsrat
- Epcos AG, München

Gerd Schmidt *
Vorsitzender des Betriebsrats,
Betrieb Regensburg West

Sibylle Wankel *
Tarifabteilung der IG Metall, Bezirksleitung Bayern

Aufsichtsrat
- Compaq Computer GmbH, Dornach

Prof. Dr. phil. Claus Weyrich
Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Konzernmandate
- Siemens Corporate Research, Princeton, USA
(Chairman of the Board)
- Siemens Venture Capital GmbH, München
(Board Member)

Dr.-Ing. Klaus Wucherer
Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Konzernmandate
- Eviop-Tempo, Griechenland
(Verwaltungsrat)
- Siemens France S.A., Frankreich
(Verwaltungsrat)
- Simko Ticaret, Türkei
(Verwaltungsrat)
- Siemens Ltd., China
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Siemens E&A, USA
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Yaskawa Siemens Automation & Drives/YSAD, Japan
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)

* Arbeitnehmervertreter

**WESENTLICHE TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND ASSOZIIERTE
UNTERNEHMEN DER INFINEON TECHNOLOGIES AG
FÜR DAS ZUM 30. SEPTEMBER 2000 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR**

NAME UND SITZ DER GESELLSCHAFT	ANTEIL AM KAPITAL
EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter GmbH & Co. KG, Warstein-Belecke	100%
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	100%
Infineon Technologies - Fabrico de Semicondutores Portugal S.A., Vila do Conde, Portugal	100%
Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis, Frankreich	100%
Infineon Technologies Holding B.V., Rotterdam, Niederlande	100%
Infineon Technologies U.K. Ltd., Bracknell, Großbritannien	100%
Infineon Technologies Villach AG, Villach, Österreich	100%
Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA	100%
White Oak Semiconductor Limited Partnership, Wilmington, Delaware, USA	100%
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur	100%
Infineon Technologies (Integrated Circuits) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100%
Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan	100%
OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG, Regensburg	49,0%
Semiconductor 300 GmbH & Co. KG, Dresden	50,1%
ALTIS Semiconductor S.N.C, Essonnes, Frankreich	50,1%
ProMOS Technologies Inc., Hsinchu, Taiwan	33,0%

Die vollständige Anteilsbesitzliste ist beim Handelsregister München unter der Nummer HRB 126 492 hinterlegt.

Glossar

3G Kurz für 'dritte Generation'. Wird für Mobiltelefonverbindungen verwendet, die den heutigen Standard hinsichtlich Geschwindigkeit, Kapazität und technischer Ausgereiftheit des Datentransports bei weitem übertreffen.

ADSL 'Asymmetric Digital Subscriber Line' (asymmetrische digitale Anschlussleitung). Die häufigste Form der digitalen Anschlussleitung (siehe Definition DSL).

ADSs 'American Depositary Shares' (hinterlegte US-Aktienzertifikate). Instrument für ausländische Unternehmen, die ihre Aktien an amerikanischen Börsen zum Handel zulassen wollen.

ASIC 'Application Specific Integrated Circuit' (anwendungsspezifische integrierte Schaltung). Ein meist sehr komplexer Chip, der speziell für einen Kunden oder einen bestimmten Verwendungszweck entwickelt wurde.

Backend Die letzte Phase bei der Halbleiterfertigung. Hier werden die Chips den letzten Prüfungen unterzogen, montiert und verpackt.

Basisband Frequenzbereich eines Signals, bevor es in einen anderen – höheren bzw. für die Übertragung geeigneteren – Frequenzbereich transformiert wird.

Biometrik System, bei dem zur Identitätsfeststellung biologische Parameter (z.B. Fingerabdrücke) verwendet werden.

Bit 'Basic indisoluble information unit', d.h. kleinste Informationseinheit auf einem Rechner, die einen von zwei Werten annehmen kann (z.B. ja/nein).

Bluetooth Norm für die drahtlose Übertragung von Daten über kurze Strecken, die drahtlose Verbindungen z.B. zwischen Bürogeräten ermöglicht.

Byte 'By eight' oder 'binary term'. Häufig verwendete Maßeinheit, die 8 Bit entspricht.

CMOS 'Complementary Metal-Oxide Semiconductor' (komplementärer Metalloxid-Halbleiter). Bei der Herstellung von Chips verwendete Technologie. Ein CMOS-Chip verbraucht relativ wenig Energie und ermöglicht einen hohen Integrationsgrad.

Controller 'Steuereinheit', d.h. ein elektronisches System zur Steuerung der Operationen bzw. Arbeitsvorgänge eines größeren Systems.

DDR 'Double Data Rate' (doppelte Datenrate). Technologie zur Beschleunigung des Datendurchsatzes eines Chips.

DECT 'Digital Enhanced Cordless Telecommunication' (digitale schnurlose Telekommunikation). Eine Norm für die drahtlose Übertragung von Sprache und Daten zwischen einer Basisstation und bis zu acht Geräten. DECT-Telefone werden sowohl privat als auch in Büros genutzt.

DRAM 'Dynamic Random Access Memory' (dynamischer Direktzugriffsspeicher). Die gebräuchlichste Chipart für die Speicherung von Informationen.

DSL 'Digital Subscriber Line' (digitale Anschlussleitung). Eine Technologiefamilie, die die Leistung vorhandener Telefon-Kupferleitungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Kapazität und Reichweite der Datenübertragung entscheidend erhöht.

DSP 'Digitaler Signalprozessor'. Speziell für die Ausführung komplexer und zeitkritischer Operationen geschaffener Mikroprozessor.

Dual-Mode-Gerät Gerät, das nach zwei Übertragungsnormen arbeiten kann (z.B. Mobiltelefon mit GSM- und UMTS-Kompatibilität).

DWD 'Danish Wireless Design'; eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Infineon mit Sitz in Aalborg, Dänemark.

Ebit 'Earnings before interests, minority interests and taxes', d.h. das Ergebnis (also Gewinn oder Verlust) vor Zinsen, Ergebnisanteilen Dritter und Steuern.

EDA 'Electronic Design Automation' (elektronische Automatisierung der Konstruktion bzw. Entwicklung).

EDGE 'Enhanced Data Rate for Global/GSM Evolution'. Norm, welche eine Übertragung über die vorhandene GSM-Infrastruktur mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kilobit je Sekunde ermöglicht. Nachfolger von GSM und Vorläufer von UMTS.

EEPROM 'Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory' (elektronisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher). Ein Nur-Lese-Speicherchip, der elektronisch (anstatt mit UV-Licht) wiederholt gelöscht und erneut programmiert werden kann.

embedded DRAM Ein Chip, der Speicher-, Logik- und Analogkomponenten umfasst.

Ethernet Eine Form des System-on-Chip oder System-ICs. Gebräuchlichstes Protokoll für die Übertragung von Daten in einem lokalen Netzwerk (LAN).

EUV LLC 'Extreme Ultraviolet Limited Liability Corporation'. Das Konsortium, das derzeit moderne Photolithographie-Technologien entwickelt.

F+E 'Forschung und Entwicklung'

Foundry/Foundries Siliziumwerk/e, die auf Bestellung Chips für andere Unternehmen herstellen.

Frontend Fertigungsstätte für die Chipproduktion.

FTSE 'Financial Times Security Exchange'. Ein wichtiger Aktienindex in England, vergleichbar zum DAX in Deutschland.

GaAs 'Galliumarsenid'. Ein Halbleiter, der für die Fertigung von optoelektronischen und Hochfrequenz-Bauelementen verwendet wird.

Gb 'Gigabit'. Circa eine Milliarde Bits.

GPRS 'General Packet Radio Service' (allgemeiner Paketfunkdienst). Mobiler Kommunikationsstandard, der die mobile Kommunikation mit Internetfähigkeiten ausstattet. GPRS ermöglicht gegenüber GSM etwa 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und –kapazitäten.

GSM 'Global System for Mobile Communications' (Globales-Mobil-Kommunikationssystem). Eine in 159 Ländern verwendete aktuelle Norm für die Mobilkommunikation.

GWb 'Geschäftswertbeitrag'. Maßstab für die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens oder Geschäftsbereiches.

I&V 'Image und Video', ehemaliges Geschäftsfeld von Infineon.

IC 'Integrated Circuit' (integrierte Schaltung). Technische Bezeichnung für einen Chip.

ID 'Identification' (Identifizierung einer Person, z.B. beim Zugang zu einem Bankautomaten u.ä.).

IGBT 'Insulated Gate Bipolar Transistor'. Ein diskreter Leistungstransistor.

Inc. 'Incorporated'. Abkürzung für Incorporated Company (Aktiengesellschaft).

IPO 'Initial Public Offering' (der erste Börsengang eines Unternehmens).

ISDN 'Integrated Services Digital Network' (dienste-integrierendes Digitalnetz). Digitale Technologie, die eine schnelle Übertragung von Sprache und Daten ermöglicht.

ISO 9000 Internationale Norm für betriebliche Qualität.

IT 'Informationstechnologie'.

LAN 'Local Area Network' (lokales Netzwerk).

Logik Bezeichnung für Chips, die Informationen verarbeiten.

Mb 'Megabit'.

MEDEA Europäische Gruppierung für die gemeinsame Forschung im Bereich moderne Halbleitertechnologien.

Mikrocontroller Ein Mikroprozessor mit Speicher und Schnittstellen, der als integriertes oder eingebettetes System dient.

Mikroprozessor Auch als 'Central Processing Unit' (CPU) bezeichnet. Ein komplexer Chip, der die Befehle auf einem Rechner oder in einem anderen digitalen Gerät ausführt.

Mio. Million/Millionen

mm 'Millimeter'

Mrd. Milliarde/Milliarden

NOPAT 'Net Operating Profit After Taxes' (operativer Nettogewinn nach Steuern).

OEM 'Original Equipment Manufacturer' (Hersteller von Originalgeräten). Herstellerfirma, die Geräte oder anderes Zubehör an Kunden liefert, die diese dann unter der eigenen Marke weiterverkaufen.

Optische Netzwerke Netzwerke, die Lichtwellen als Hauptträger für den Datentransport nutzen.

PAROLI 'Parallel optical link' (parallele optische Verbindung). Proprietäre Module, die Datenübertragungsverbindungen über Glasfaserleitungen zur Verfügung stellen.

PBX 'Private branch exchange' (Nebenstellenanlage).

PC 'Personal Computer'.

PDA 'Personal Digital Assistant' (elektronischer Organisier).

PIN 'Personal Identification Number'. Zahl zur Überprüfung der Identität eines Benutzers.

QS 9000 Version der ISO 9000 (siehe oben), die von den vier großen amerikanischen Autoherstellern entwickelt wurde.

SDH/SONET 'Synchronous Digital Hierarchy'/'Synchronous Optical Network' (synchrone digitale Hierarchie / synchrones optisches Netzwerk). Internationale und amerikanische Norm für die synchrone Datenübertragung über optische Verbindungen.

SDRAM 'Synchronous Dynamic Random Access Memory' (synchrone DRAM – s.o.). Technologie, die eine entscheidende Beschleunigung des Datenaustauschs zwischen Speicherchips ermöglicht.

SHDSL 'Symmetric High-Data Rate Digital Subscriber Line' (symmetrische hochschnelle digitale Anschlussleitung). Siehe Definition von DSL.

SIM-Karte Mit Hilfe dieser 'Subscriber Identification Module'-Karte können sich die Nutzer von Mobiltelefonen 'ausweisen' und erhalten damit Zugang zu den angebotenen Dienste.

SLIC 'Subscriber Line Interface Circuit'. Eine Schaltung der Telefongesellschaft, mit der die Telefonkunden verbunden werden.

Smart Card 'Intelligente Karte', d.h. Karte mit einem integrierten Chip, auf dem persönliche Daten des Benutzers und andere Anwendungen gespeichert sind. Sie ermöglichen den Zugang zu elektronischen Netzwerken.

SoC Ein 'System-on-a-Chip' ist ein System-IC, bei denen Speicher, Logik- und Analogfunktionen auf einem einzigen Chip integriert sind.

SOX 'Philadelphia Semiconductor Stocks Index'

Speicher Gemeinsame Bezeichnung für Systemspeicher (Memory) und Massenspeicher (Festplatten etc.).

STOXX Indexfamilie für europäische Aktien.

TAN 'Transaktionsnummer' für die Überprüfung von elektronischen Transaktionen.

TM 'Trademark' (Warenzeichen oder Marke).

Transceiver Gerät, das Signale sowohl senden als auch empfangen kann. Zusammenziehung von engl. Transmitter (Sender) und Receiver (Empfänger).

Transistor Zusammenziehung von engl. Transmitter und Resistor (Widerstand). Dieses Grundelement der modernen Elektronik besteht aus einem Halbleiter, der ein Signal verstärkt oder einen Stromkreis öffnet oder schließt.

TSMC 'Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation'.

US GAAP 'United States Generally Accepted Accounting Principles'

UMC 'United Microelectronics Corporation'.

UMTS 'Universal Mobile Telecommunication Systems' (Universale-Mobil-Telekommunikationssysteme). Diese Systeme werden ein zentraler Bestandteil von Mobilkommunikationsnetzen der dritten Generation sein.

VDSL 'Very high bit-rate Digital Subscriber Line' (digitale Anschlussleitung mit sehr hoher Übertragungsrate). Ermöglicht sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten über kurze Entfernungen.

WAN 'Wide Area Network'.

WAP 'Wireless Application Protocol' (Protokoll für drahtlose Kommunikations-Anwendungen). Ermöglicht den Zugang zum Internet über Mobiltelefone.

W-CDMA 'Wideband-Code Division Multiple Access'. Eine hauptsächlich in den USA eingesetzte drahtlose Kommunikationstechnologie der dritten Generation.

WDCT 'Worldwide Digital Cordless Telecommunications'. Eine von Siemens entwickelte Technologie als Ersatz für DECT (siehe dort), die die drahtlose Kommunikation trotz sehr hoher Kapazität ermöglicht.

WSTS 'World Semiconductor Trade Statistics'.

xDSL DSL-Familie (siehe dort) in all ihren Ausprägungen (das 'x' steht als Platzhalter für die einzelnen Technologien).

ZKA Der 'Zentrale Kreditausschuss'. Dachorganisation der deutschen Finanzinstitute.

Aktionärsinformation

INFINEON TECHNOLOGIES AG

Gegründet	1999
Hauptsitz	St.-Martin-Straße 53, D-81669 München Telefon +49 (0)89 234-0
Geschäftsjahr	1. Oktober bis 30. September
Abschlussprüfer	KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin und Frankfurt am Main
Infineon an der Börse	Am 13. März 2000 hat unser Unternehmen erfolgreich seinen Börsengang in Deutschland und den USA abgeschlossen. Seitdem ist die Infineon-Aktie mit der Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) 623100 unter dem Kürzel 'IFX' im amtlichen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) notiert und wird in Deutschland auf Xetra und an den Börsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gehandelt. Optionsscheine auf die Infineon-Aktie werden an der deutsch-schweizerischen Terminbörse Eurex und an anderen Börsen gehandelt. In Form von American Depositary Shares (ADSs) – ein ADS entspricht einer Aktie – wird die Infineon-Aktie außerdem an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt. ADS-Depotstelle ist die Morgan Guaranty Trust Company (60 Wall Street, NY 10260 New York, USA). Am 30. September 2000 hatte Infineon 625.501.507 ausstehende Aktien.
Kontakt für Anleger und Analysten	Investor.Relations@infineon.com Telefon/-fax +49 (0)89 234-26655/-718484
Kontakt für Journalisten	Media.Relations@infineon.com Telefon/-fax +49 (0)89 234-26555/-28482
Besuchen Sie uns unter	www.infineon.com

WICHTIGE TERMINE 2001*

Mittwoch, 31. Januar	Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2001
Freitag, 6. April, 10 Uhr	Hauptversammlung 2001 in Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle (Mercedesstr. 69)
Montag, 9. April	Dividendenzahlung (nach Zustimmung der Hauptversammlung)
Freitag, 27. April	Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2001
Donnerstag, 26. Juli	Veröffentlichung des Berichts über das 3. Quartal 2001
Mittwoch, 14. November	Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das 4. Quartal 2001 und das Geschäftsjahr 2001

* vorläufig

IMPRESSUM

Herausgeber	Infineon Technologies AG, München
Verantwortlich	Guy Wolff Corporate & Investor Communications
Projektmanagement	Achim Schneider Investor Relations & Finanzkommunikation
Redaktion	Silja Binner, François Eksteen, Annett Giese, Matthias Giese, Cornelia Groethuysen, Robert Hawliczek, Kathrin Liebe, Christoph Liedtke, Leonhard Mayr, Achim Schneider, Terry Swartzberg
Fachliche Beratung	AIOS Corporate Finance GmbH, Berlin PricewaterhouseCoopers GmbH, München
Gestaltung	The Partners, London
Beratung	J. Walter Thompson, Frankfurt
Fotos	Audi AG, Martin Barraud, Peter Dazeley, Infineon, Wolfgang Oberle, Privat, Pete Seaward, Marcus Lyon
Druck	Westerham Press, England

Die folgenden Bezeichnungen sind **INGETRAGENE NAMEN, MARKENNAMEN UND/ODER MARKENZEICHEN** der Infineon Technologies AG: Infineon und das Infineon Technologies-Logo, 10BaseS, AliDD, AUDO, BlueMoon, CoolMOS, CoolSET, HITFET, Infineon FingerTIP, M-GOLD, OptiMOS, PAROLI, PROFET, SMARTI, Socrates und TriCore. Das BLUETOOTH-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet. Alle anderen in diesem Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Wenn Sie **ZUSÄTZLICHE EXEMPLARE** dieses Geschäftsberichts 2000 in deutscher oder englischer Sprache bestellen möchten, oder wenn Sie diesen Bericht und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns doch im Internet unter <http://www.infineon.com/boerse>. Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzel Exemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

FÜR INTERNE BESTELLUNGEN

LZF Fürth-Bislohe	
Per Intranet	http://c4bs.spls.de
Per Fax	+49 (0)911 654 4271
Bestellnummer	(deutsch) B192-H7795 (englisch) B192-H7795-X-X-7600